

# 晶彩科技股份有限公司

## 九十七年度年報



中華民國九十八年五月二十二日刊印  
查詢本年報之網址：<http://newmops.twse.com.tw>  
公司網址：<http://www.favite.com>

一、發言人、代理發言人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱：

	發言人	代理發言人
姓名	蔡顯章	高金祥
職稱	總經理	行政管理處協理
聯絡電話	(03) 554-5988	(03) 554-5988
電子郵件信箱	herbert@favite.com	kevin@favite.com

二、總公司、分公司及工廠之地址及電話：

總公司及工廠：地址：新竹縣竹北市沿河街 78 巷 19 號

電話：(03) 554-5988

竹北泰和廠：地址：新竹縣竹北市泰和路 176 號

電話：(03) 656-0300

分公司及工廠：地址：台中市西屯區科雅路 26 號 1 樓

電話：(04) 256-51158

台南辦公室：地址：台南縣永康市興工路 16 號

電話：(06) 232-7704

三、股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話：

名稱：永豐金證券股份有限公司股務代理部

地址：台北市中正區博愛路 17 號 3 樓

網址：<http://www.sinopac.com.tw>

電話：(02) 2381-6388

四、最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話：

會計師姓名：張字信、郭士華會計師

事務所名稱：安侯建業會計師事務所

地址：台北市信義路 5 段 7 號 68 樓

網址：<http://www.kpmg.com.tw>

電話：(02) 8101-6666

五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方式：無

六、公司網址：<http://www.favite.com>

# 目 錄

## 壹、致股東報告書

一、九十七年度營業報告書-----	5
二、九十八年度營業計劃概要-----	6

## 貳、公司簡介

一、設立日期-----	8
二、公司沿革-----	8

## 參、公司治理報告

一、組織系統-----	10
二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料-----	12
三、公司治理運作情形-----	21
四、會計師公費資訊-----	26
五、更換會計師資訊-----	27
六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業情形-----	28
七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形-----	29
八、持股比例占前十大股東間互為財務會計準則公報第六號關係人關係之資訊-----	29
九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例-----	30

## 肆、募資情形

一、資本及股份-----	31
二、公司債辦理情形-----	35
三、特別股辦理情形-----	35
四、海外存託憑證辦理情形-----	35
五、員工認股權憑證辦理情形-----	36
六、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形-----	36
七、資金運用計劃執行情形-----	36

## 伍、營運概況

一、業務內容-----	38
-------------	----

二、市場及產銷概況-----	62
三、從業員工-----	71
四、環保支出資訊-----	72
五、勞資關係-----	73
六、重要契約-----	74

## 陸、財務概況

一、最近五年度簡明資產負債表、損益表、簽證會計師姓名及查核意見-----	75
二、最近五年度財務分析-----	77
三、最近年度財務報告之監察人審查報告-----	79
四、最近年度財務報表-----	80
五、最近年度經會計師查核簽證之母子公司合併財務報表-----	126
六、公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止，如有發生財務週轉困難情事， 對公司財務狀況之影響-----	126

## 柒、財務狀況及經營結果之檢討分析與風險事項

一、財務狀況-----	127
二、經營結果-----	128
三、現金流量-----	128
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響-----	129
五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫-----	129
六、最近年度及截至年報刊印日止風險事項之分析評估-----	130
七、其他重要事項-----	132

## 捌、特別記載事項

一、關係企業相關資料-----	133
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形-----	133
三、最近年度及截至年報刊印日止子公司持有或處分本公司股票情形-----	133
四、其他必要補充說明事項-----	133
五、最近年度及截至年報刊印日止，發生證券交易法第三十六條第二項第二款所定對股 東權益或證券價格有重大影響之事項-----	133

# 壹、致股東報告書

晶彩科技股份有限公司

九十七年度營業報告書

以下係針對本公司九十七年度的營業成果及九十八年度的營運展望說明如下：

## 一、九十七年度營業成果

### (一)九十七年度營業計劃實施成果

本公司九十七年度營業收入達 13.3 億元，遠較九十六年度的 8.2 億元，大幅成長 61.61%；且稅後獲益約達 3.1 億元，純益率 22.98%，在在均突破歷史新高。而整體獲益能有大幅成長的現象，主係因不斷突破的技術更新及愈臻成熟穩定的產品品質，持續受到客戶的肯定及親睞，使本公司在檢測、量測及修補等精密機械產品的銷售業務上，得以於去年度同時拓展至國內兩大面板廠，故雖遭逢去年底全球金融風暴影響，使第四季營收有所下滑，然就全年的銷售實績而言，我們也因配合兩大面板廠的擴廠進度，得有大幅成長之表現；而現前本公司也躍居台灣 8.5 代廠 Array 檢測設備 in-line 銷售實績及市佔率第一的專業廠商。

(二)預算執行情形：本公司九十七年度因未對外公開財務預測，故不適用。

### (三)財務收支及獲利能力分析

1)各項財務及獲利比例如下：

項目 \ 年度		97 年	96 年
財務結構 (%)	負債占資產比率	47.02	43.04
	長期資金占固定資產比率	335.93	284.82
償債能力 (%)	流動比率	208.63	212.80
	速動比率	154.27	163.98
	利息保障倍數	19.70	18.93
經營能力	應收款項週轉率(次)	1.76	1.65
	平均收現日數	207	221
	存貨週轉率(次)	2.48	2.83
	平均銷貨日數	147	129
	固定資產週轉率(次)	3.38	2.87
	總資產週轉率(次)	0.71	0.67
獲利能力	資產報酬率(%)	16.79	10.73

	股東權益報酬率(%)		29.78	16.99
占實收資本 比率(%)	營業(損)益		48.51	39.59
	稅前(損)益		45.70	35.88
	純益率(%)		22.98	15.31
	每股盈餘(元)		5.35	3.02

2)分析說明如下：

本公司九十七年度無論營收或稅後淨利等，均較九十六年度有大幅度的成長趨勢，且在帳款回收正常的情況下，使得去年整體性的財務收支比率及獲利能力比率，概均呈現正向成長的優異表現；惟美中不足者，在於去年第四季受到全球景氣風暴波及，部分客戶機台延交，致期末庫存稍有堆積，使存貨週轉率、流動比率及速動比率下滑，另負債佔資產比例亦稍有上升。然由於本公司因仍保有高水平的現金部位，且因產品品質穩定，後續帳款之回收安全無虞，是故，尚不致有重大影響。

#### (四)研究發展狀況

九十七年度本公司產品研發的發展方向，主要仍聚焦於平面顯示器產業所需檢測、量測及修補設備的開發；且基於成本的管控，並提升關鍵零組件開發能力，本公司也積極研製相關高單價光源模組，而其效能不但更甚以往，且大幅降低了原物料成本。而憑藉著累積多年豐厚的技術及經驗，去年度所開發的產品仍不斷推陳出新，並順應兩大面板廠6代廠、7.5代廠、8.5代廠擴廠之所需，其主要開發產品如下：

- 1)薄膜電晶體(TFT Array)段：Inline 及 offline 薄膜電晶體高解析度自動光學檢測機、線上自動化 MURA 檢查機及膜厚、穿透率量測機等。
- 2)彩色濾光片(Color Filter)段：彩色濾光片自動光學檢測機、線上自動光學阻色度、膜厚、光學密度(OD)量測機、自動缺陷測高機等設備。

#### 二、九十八年度營業計劃

為避免業務發展因產業集中及客戶集中所帶來可能的負面效益，本公司除現行面板產業相關檢測設備的開發外，正持續以既有優勢技術技能，積極開發未來世代極具發展潛能的系列產品，包含：

##### (一)精密機械產業相關：

面板次世代機台設備開發、TFT LCD 雷射修補機、電子紙光學檢測機、太陽能暨半導體產業所需之自動化光學檢測機等。

(二)RFID 產業相關：

由於無線射頻辨識技術(RFID)本具無線讀取、感應靈敏、讀取範圍寬廣及資料儲存量大等功能特性，加上其應用面極其廣泛，能遍及各產業工商行號之應用，故自美國零售業者沃爾瑪(Wal-Mart)要求前一百大供應商逐步導入 RFID 標籤的同時，此項產品技術即開始備受市場關注，其未來發展潛力無窮。

本公司因掌握此該產品發展的關鍵技術，並擁有優良的技術團隊，目前已持續重點開發的產品項目，包含高頻及超高頻 RFID 標籤、超高頻 RFID 讀取器(含固定式及移動式型態)、超高頻 RFID 遙控器及 RFID Inlay & Tag 之封裝製造設備。

期許以此多樣化的產業產品開發計畫，更強化技術開發優勢，以擴大公司營運規模及範圍，並藉以爭取市場的利基，提升產業競爭能力，創造最大的經濟價值，為股東帶來最佳化的獲益。

董事長：陳永華

總經理：蔡顯章

會計主管：高金祥

## 貳、公司簡介

### 一、設立日期

本公司設立於中華民國八十九年三月十日。

### 二、公司沿革

年 月	重 要 紀 事
民國89年3月	公司正式成立，並落籍於工研院育成中心，實收資本額新台幣壹佰萬元整。
民國89年5月	現金增資，增資後實收資本額新台幣伍仟萬元正。
民國90年6月	「自動化晶圓檢測機」榮獲經濟部工業局九十年「科技研究發展專案鼓勵新興中小企業開發新技術計畫」補助。
民國91年4月	現金增資，增資後實收資本額新台幣伍仟捌佰萬元正。
民國91年12月	開發出High Density Interconnect彩色24bit印刷電路板終檢用檢測機。
民國92年1月	現金增資，增資後實收資本額新台幣壹億元正。
民國92年2月	遷廠至竹北市台元科技園區。
民國92年8月	「PDP玻璃基板自動光學檢測機」榮獲經濟部工業局九十二年度「主導性新產品開發計畫」補助。
民國92年10月	通過ISO 9001認證。
民國93年3月	現金增資，增資後實收資本額新台幣壹億伍仟萬元正。
民國93年5月	取得ISO 9001：2000品質認證
民國93年11月	現金增資，增資後實收資本額新台幣貳億元正。
民國94年6月	購置竹北市泰和路廠房。
民國94年8月	現金增資，增資後實收資本額新台幣貳億伍仟萬元正。
民國94年11月	「7.5代廠薄膜電晶體(TFT)面板自動光學缺陷檢測設備」榮獲經濟部工業局九十四年度「主導性新產品開發計畫」補助。
民國95年2月	榮獲奇美科技頒發「2005年最佳服務獎」之殊榮。
民國95年4月	成立台南辦公室，就近服務台南科學園區客戶。
民國95年6月	現金增資，增資後實收資本額新台幣參億元正。
民國95年8月	購置竹北市台元段土地，規劃擴建廠房及產能。
民國95年11月	現金增資，增資後實收資本額新台幣參億捌仟萬元正。
民國95年12月	核准辦理登錄興櫃市場買賣股票。
民國96年1月	榮獲經濟部「整合液晶滴入製程設備開發研發聯盟先期研究推動計畫」補助。
民國96年2月	榮獲奇美科技頒發「2006年最佳品質獎」及「2006年最佳夥伴獎」之殊榮。
民國96年3月	獲經濟部工業局審核通過取得「建構研發環境專案貸款」之借款額度。
民國96年6月	榮獲勤業眾信頒發「2006年台灣高科技 Fast 50」之殊榮。
民國96年7月	獲得經濟部工業局科技事業核准函。
民國96年9月	通過臺灣證券交易所董事會核准上市案。
民國96年10月	遷廠至竹北市沿河街。

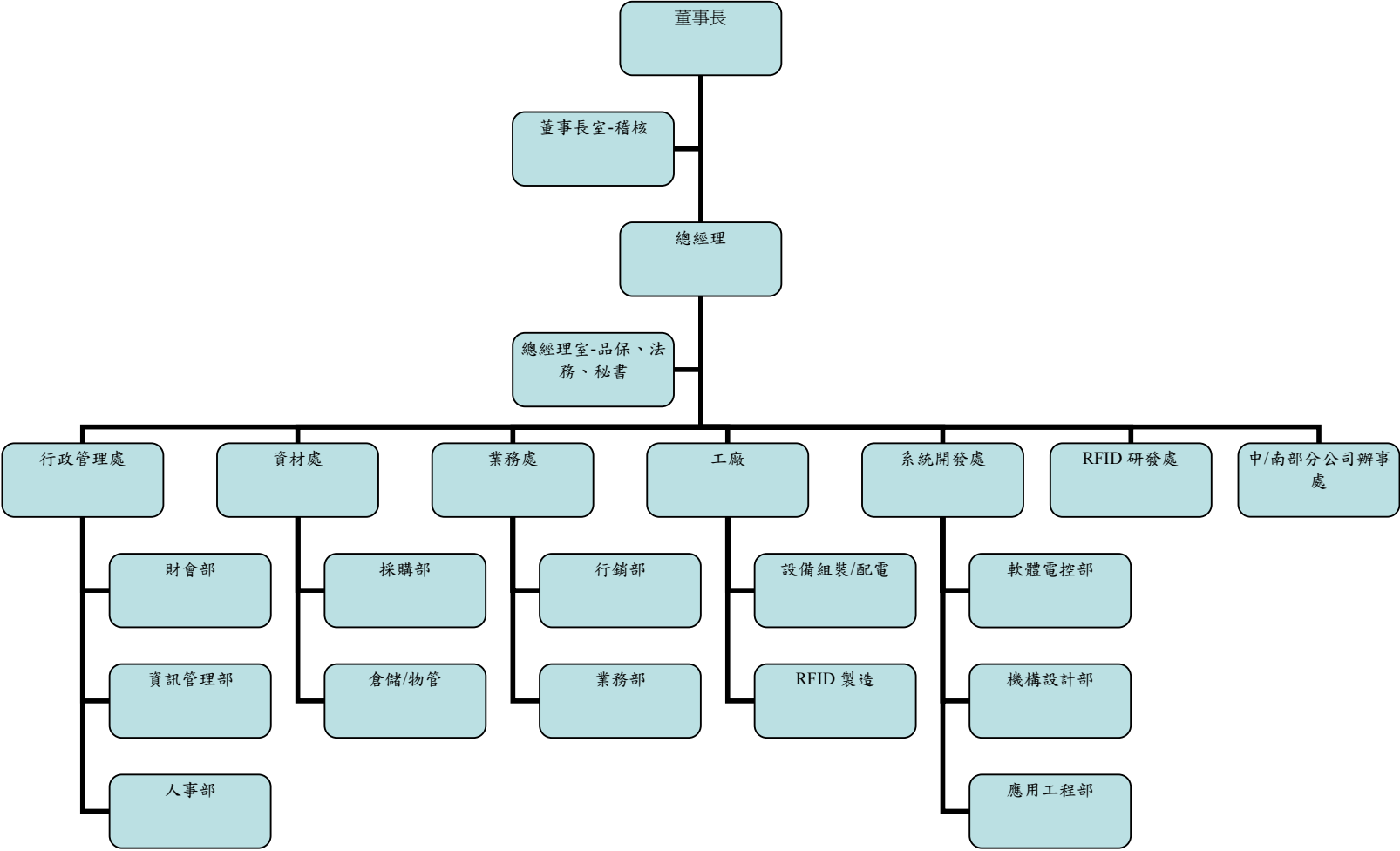


民國97年1月	現金增資，增資後實收資本額新台幣伍億捌仟玖佰參拾肆萬捌仟元正。
民國97年1月	股票正式掛牌上市買賣。
民國97年2月	榮獲奇美科技頒發「2007年最佳品質獎」之殊榮。
民國97年6月	榮獲勤業眾信頒發「2007年台灣高科技 Fast 50」之殊榮。

# 參、公司治理報告

## 一、組織系統

### (一)公司之組織結構



(二) 各主要部門所營業務

部門	業務職掌
總經理室	<p>秉承股東會及董事會之決議，綜理本公司業務。</p> <p>監督並控制本公司日常之營業及運作。</p> <p>執行各部門之協調、溝通等相關事宜。</p>
董事長室-- 稽核	<p>檢查評估內部控制制度之妥當性，監督其有效運作。</p> <p>負責全公司業務、財務、營運狀況之稽核、異常分析及適時提供改善建議方案。</p> <p>檢查保護公司資產安全，協助管理階層落實公司內部規章及各項規定之遵行。</p>
行政管理處	<p>管理制度制定、人力資源管理、人事行政管理、固定資產管理、總務及共同費用掌控、薪資、員工福利、員工關係、員工諮商、總務、文件管制中心；組織規劃發展、人力資源、教育訓練、勞工法令。</p> <p>負責內部 MIS 系統規劃、執行與網路之維護。</p> <p>資金調度、銀行往來、預算編製及相關會計帳務處理、成本控制與管理制度規劃、資產設置及財務投資管理、股務作業、負責各部門橫向溝通、財務及管理制度，前瞻性規劃及執行。</p>
資材處	<p>原料採購之詢、比、議價作業及供應商之管理。</p> <p>原物料、零件採購控制及降低成本</p> <p>原物料及半成品之倉儲與物流管理。</p>
業務處	<p>制定行銷策略、新商品企劃、廣告、宣傳、媒體公關。</p> <p>合約審議。</p> <p>客戶抱怨及退貨之因應對策。</p>
製造部	<p>品質管制各項事宜之規劃執行、品管制度之推行</p> <p>客戶抱怨及退貨之因應對策</p> <p>提昇品質等相關事務管理。</p> <p>負責生產規劃、執行以完成產銷之整體目標，並有效提升製造之效率。</p> <p>委外作業管理及委外加工廠之聯繫。</p>
系統開發處	<p>製程之研發改善，及設備改良並協助相關技術問題分析。</p> <p>新產品之設計、開發；產品功能之改進。</p> <p>售後服務及技術支援。</p>

## 二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

### (一)董事及監察人

#### 1、董事及監察人資料(一)

98年4月18日

職稱	姓名	選任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人		
					股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係
董事長	陳永華	96.06.08	3年	90.11.02	3,954,207	10.41%	5,395,012	9.14%	2,139,350	3.63%	-	-	清華大學物理系 大同工學院事業經營研究所 精強科技(股)公司總經理	晶彩科技(股)公司執行長 晶昂科技(股)公司董事長	業務處 協理	王子越	配偶
董事	鄭國樑	96.06.08	3年	90.11.02	270,632	0.70%	353,985	0.60%	157,707	0.27%	-	-	台北工專畢 永捷高分子工業(股)公司總經理 永捷高分子工業(股)公司董事	永捷高分子工業(股)公司總經理 永捷高分子工業(股)公司董事	-	-	-
董事	林賜農	96.06.08	3年	90.11.02	643,655	1.69%	841,899	1.43%	-	-	-	-	初中畢 高毓企業(股)公司董事長 鉦冠企業(股)公司董事長 山冠興業(股)公司董事長 金偉星開發有限公司董事	高毓企業(股)公司董事長 鉦冠企業(股)公司董事長 山冠興業(股)公司董事長 金偉星開發有限公司董事	-	-	-
董事	周育民	96.06.08	3年	90.11.02	1,623,035	4.27%	2,132,929	3.61%	728,117	1.24%	-	-	文化大學畢 世強實業化學部經理	永捷高分子工業(股)公司監察人	-	-	-
董事	蔡顯章	96.06.08	3年	96.06.08	99,629	0.26%	220,314	0.37%	-	-	-	-	成功大學機械系 台灣大學機械研究所 斯利康科技經理	晶彩科技(股)公司總經理	-	-	-
獨立董事	嚴克文	96.06.08	3年	96.06.08	-	-	-	-	-	-	-	-	大同工學院事業經營研究所 中華民國證券分析師 台北富邦銀行企畫部經理	台北富邦銀行企畫部經理	-	-	-
獨立董事	林佳臻	96.06.08	3年	96.06.08	-	-	-	-	-	-	-	-	大同工學院事業經營研究所 中華民國會計師 兆豐國際商業銀行科長	林佳臻會計師事務所 兆豐國際商業銀行科長	-	-	-
監察人	莊永賀	96.06.08	3年	96.06.08	473,119	1.25%	618,838	1.05%	-	-	-	-	台南高商畢 上曜開發科技(股)公司財務經理	永捷高分子工業(股)公司董事長 上曜開發科技(股)公司董事 鴻華電子(股)公司董事	-	-	-
監察人	王淑珍	96.06.08	3年	96.06.08	118,448	0.31%	105,929	0.18%	-	-	-	-	清華大學工業工程研究所 RFC 國際認證財務規畫師 安泰人壽行銷經理	兆陽財務顧問(股)公司 副總經理	-	-	-
監察人	胡湘寧	96.06.08	3年	96.06.08	-	-	-	-	-	-	-	-	美國紐約州立大學水牛城分校會計碩士 中華民國(美國紐約州)會計師 揚智聯合會計師事務所會計師	東浦精密光電(股)公司監察人 輔祥實業(股)公司監察人	-	-	-

2、法人股東之主要股東：無。

3、法人股東之主要股東為法人者其主要股東：無。

4、董事及監察人資料(二)

98年04月18日

姓名	條件	是否具有五年以上工作經驗 及下列專業資格			符合獨立性情形(註1)										兼任其他 公開發行 公司獨立 董事家數
		商務、法 務、財務、 會計或公司 業務所須相 關科系之公 私立大專院 校講師以上	法官、檢察官、 律師、會計師 或其他與公司 業務所需之國 家考試及格領 有證書之專門 職業及技術人員	商務、法 務、財務、 會計或公司 業務所須之 工作經驗	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
陳永華			✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
鄭國樑			✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
林賜農			✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
周育民			✓	✓			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
蔡顯章			✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
嚴克文		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
林佳臻		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
莊永賀			✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
王淑珍			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
胡湘寧		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-

註1：各董事、監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“✓”。

- (1) 非為公司或其關係企業之受僱人。
- (2) 非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者，不在此限)。
- (3) 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
- (4) 非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或五親等以內直系血親親屬。
- (5) 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。
- (6) 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東。
- (7) 非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。
- (8) 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
- (9) 未有公司法第30條各款情事之一。
- (10) 未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。

## (二)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

98年04月18日

職稱	姓名	就任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人		
			股數	持股比率(%)	股數	持股比率(%)	股數	持股比率(%)			職稱	姓名	關係
總經理	蔡顯章	96.01.01	220,314	0.37%	-	-	-	-	●學歷 台灣大學機研所 ●經歷 斯利康科技經理	-	-	-	-
業務處副總	曾錦香	96.01.01	685,210	1.16%	-	-	-	-	●學歷 大同工學院經研所 ●經歷 宏遠電訊總經理	-	-	-	-
系統開發處副總	林燕松	96.01.01	204,977	0.35%	-	-	-	-	●學歷 交通大學機械所 ●經歷 勁協企業經理	-	-	-	-
軟體電控部協理	吳俊欽	95.03.01	197,568	0.33%	-	-	-	-	●學歷 東海大學資訊系 ●經歷 斯利康科技工程師	-	-	-	-
機構設計部協理	葉君基	96.06.15	70,064	0.12%	-	-	-	-	●學歷 元智大學製技系 ●經歷 斯利康科技經理	-	-	-	-
業務處協理	王子越	97.04.01	2,139,350	3.63%	-	-	-	-	●學歷 華東大學 ●經歷 華彩科技有限公司	-	董事長	陳永華	配偶
行政管理部協理	高金祥	95.03.01	167,714	0.28%	-	-	-	-	●學歷 Saginaw Valley State University/MBA ●經歷 星創科技經理	-	-	-	-

(三)最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金

1-1、董事(含獨立董事)之酬金

97年12月31日單位：新台幣仟元

職稱	姓名	董事酬金								A、B、C及D等四項總額占稅後純益之比例(註11)		兼任員工領取相關酬金								A、B、C、D、E、F及G等七項總額占稅後純益之比例(註11)		有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金(註12)						
		報酬(A)(註2)		退職退休金(B)		盈餘分配之酬勞(C)(註3)		業務執行費用(D)(註4)		薪資、獎金及特支費等(E)(註5)		退職退休金(F)		盈餘分配員工紅利(G)(註6)				員工認股權憑證得認購股數(H)(註7)										
		本公司	合併報表內所有公司(註8)	本公司	合併報表內所有公司(註8)	本公司	合併報表內所有公司(註8)	本公司	合併報表內所有公司(註8)	本公司	合併報表內所有公司(註8)	本公司	合併報表內所有公司(註8)	本公司		合併報表內所有公司(註8)		本公司	合併報表內所有公司(註8)	本公司	合併報表內所有公司(註8)							
董事長	陳永華																											
董事	鄭國樑																											
董事	林賜農																											
董事	周育民	-	-	-	-	2,965	2,965	225	225	3,190	3,190	4,645	4,645	-	-	-	1,478	-	1,478	400	400	3.03%	3.03%				-	
董事	蔡顯章																											
獨立董事	嚴克文																											
獨立董事	林佳養																											

1-2、酬金級距表

給付本公司各個董事酬金級距	董事姓名			
	前四項酬金總額(A+B+C+D)		前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G)	
	本公司 (註9)	合併報表內所有公司 G(註10)	本公司 (註9)	合併報表內所有公司 H(註10)
低於2,000,000元	陳永華、蔡顯章 鄭國樑、林賜農 周育民、嚴克文 林佳臻	陳永華、蔡顯章 鄭國樑、林賜農 周育民、嚴克文 林佳臻	鄭國樑、林賜農 周育民、嚴克文 林佳臻	鄭國樑、林賜農 周育民、嚴克文 林佳臻
2,000,000元(含)~5,000,000元(不含)	-	-	陳永華、蔡顯章	陳永華、蔡顯章
5,000,000元(含)~10,000,000元(不含)	-	-	-	-
10,000,000元(含)~15,000,000元(不含)	-	-	-	-
15,000,000元(含)~30,000,000元(不含)	-	-	-	-
30,000,000元(含)~50,000,000元(不含)	-	-	-	-
50,000,000元(含)~100,000,000元(不含)	-	-	-	-
100,000,000元以上	-	-	-	-
總計	7	7	7	7

註1：董事姓名應分別列示(法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示)，以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或副總經理者應填列本表及下表(3)。

註2：係指最近年度董事之報酬(包括董事薪資、職務加給、退職退休金、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。

註3：係指最近年度盈餘分配議案股東會前經董事會通過擬議配發之董事酬勞金額。

註4：係指最近年度董事之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。

註5：係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)所領取包括薪資、職務加給、退職退休金、離職金、各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。

註6：係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得員工紅利(含股票紅利及現金紅利)者，應揭露最近年度盈餘分配議案股東會前經董事會通過擬議配發員工紅利金額，若無法預估者則按去年實際配發比例計算今年擬議配發數，並另應填列附表一之三。其股票紅利金額上市上櫃公司應以證券發行人財務報告編製準則規定公平價值(係指資產負債表日之收盤價)計算之；若非上市上櫃公司則以盈餘所屬年度會計期間結束日之淨值計算之。

註7：係指截至年報刊印日止董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得員工認股權憑證得認購股數(不包括已執行部分)，除填列本表外，尚應填列附表十五。

註8：應揭露合併報表內所有公司(包括本公司)給付本公司董事各項酬金之總額。

註9：本公司給付每位董事各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露董事姓名。

註10：合併報表內所有公司(包括本公司)給付本公司每位董事各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露董事姓名。

註11：稅後純益係指最近年度之稅後純益。

註12：a.本欄應明確填列公司董事「有」或「無」領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金。

b.若填列「有」者，得自願性填列所領取酬金金額，並應依公司董事於子公司以外轉投資事業所擔任身分分別所領取之酬金，併入酬金級距表之G及H欄，並將欄位名稱改為「所有轉投資事業」

c.酬金係指本公司董事擔任子公司以外轉投資事業之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞、員工紅利及業務執行費用等相關酬金。

\*本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同，故本表目的係作為資訊揭露之用，不作課稅之用。

2-1、監察人之酬金

97年12月31日單位：新台幣仟元

職稱	姓名	監察人酬金								A、B、C及D等四項總額占稅後純益之比例(註8)		有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金(註9)
		報酬(A)(註2)		退職退休金(B)		盈餘分配之酬勞(C)(註3)		業務執行費用(D)(註4)				
		本公司	合併報表內所有公司(註5)	本公司	合併報表內所有公司(註5)	本公司	合併報表內所有公司(註5)	本公司	合併報表內所有公司(註5)	本公司	合併報表內所有公司(註5)	
監察人	莊永賀	-	-	-	-	1,271	1,271	90	90	0.44%	0.44%	-
監察人	王淑珍	-	-	-	-	1,271	1,271	90	90	0.44%	0.44%	-
獨立監察人	胡湘寧	-	-	-	-	1,271	1,271	90	90	0.44%	0.44%	-



## 2-2、酬金級距表

給付本公司各個監察人酬金級距	監察人人數	
	前四項酬金總額(A+B+C+D)	
	本公司(註 6)	合併報表內所有公司 (註 7)E
低於 2,000,000 元	莊永賀、王淑珍、胡湘寧	莊永賀、王淑珍、胡湘寧
2,000,000 元 (含) ~ 5,000,000 元(不含)	-	-
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元(不含)	-	-
10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元(不含)	-	-
15,000,000 元 (含) ~ 30,000,000 元(不含)	-	-
30,000,000 元 (含) ~ 50,000,000 元(不含)	-	-
50,000,000 元 (含) ~ 100,000,000 元(不含)	-	-
100,000,000 元以上	-	-
總計	3	3

註 1：監察人姓名應分別列示(法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示)，以彙總方式揭露各項給付金額。

註 2：係指最近年度監察人之報酬(包括監察人薪資、職務加給、退職退休金、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。

註 3：係填列最近年度盈餘分配議案股東會前經董事會通過擬議配發之監察人酬勞金額。

註 4：係指最近年度給付監察人之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。

註 5：應揭露合併報表內所有公司(包括本公司)給付本公司監察人各項酬金之總額。

註 6：本公司給付每位監察人各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露監察人姓名。

註 7：合併報表內所有公司(包括本公司)給付本公司每位監察人各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露監察人姓名。

註 8：稅後純益係指最近年度之稅後純益。

註 9：a.本欄應明確填列公司監察人「有」或「無」領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金。

b.若填列「有」者，得自願性填列所領取酬金金額，並應依公司監察人於子公司以外轉投資事業所擔任身分別所領取之酬金，併入酬金級距表 D 欄，並將欄位名稱改為「所有轉投資事業」

c.酬金係指本公司監察人擔任子公司以外轉投資事業之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞、員工紅利及業務執行費用等相關酬金。

\*本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同，故本表目的係作為資訊揭露之用，不作課稅之用。

### 3-1、總經理及副總經理之酬金

97年12月31日

單位：新台幣仟元/仟股

職稱	姓名	薪資(A) (註2)		退職退休金(B)		獎金及 特支費等等(C) (註3)		盈餘分配之員工紅利金額(D) (註4)				A、B、C及D等四 項總額占稅後純益 之比例(%) (註9)		取得員工認股權 憑證數額(註5)		有無領 取來自 子公司 以外轉 投資事 業酬金 (註10)
		本公司	合併報 表內所 有公司 (註 6)	本公司	合併報 表內所 有公司 (註 6)	本公司	合併報 表內所 有公司 (註6)	本公司		合併報表內所有 公司(註5)		本公 司	合併報表 內所有公 司 (註6)	本公 司	合併報 表內所 有公司 (註 6)	
								現金紅 利金額	股票紅 利金額	現金紅 利金額	股票紅 利金額					
總經理	蔡顯章	4,735	4,734	282 (說明1)	282 (說明1)	2,130	2,130	-	3,127	-	3,127	10,274	10,274	400	400	-
副總經理	林燕松															
副總經理	曾錦香															

說明1：退職退休金係屬97年度退職退休金費用化之提撥數。

### 3-2、酬金級距表

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級 距	總經理及副總經理姓名	
	本公司(註7)	合併報表內所有公司(註8)E
低於2,000,000元		
2,000,000元(含)~5,000,000元(不含)	蔡顯章、林燕松、曾錦香	蔡顯章、林燕松、曾錦香
5,000,000元(含)~10,000,000元(不含)	-	-
10,000,000元(含)~15,000,000元(不含)	-	-
15,000,000元(含)~30,000,000元(不含)	-	-
30,000,000元(含)~50,000,000元(不含)	-	-
50,000,000元(含)~100,000,000元(不含)	-	-
100,000,000元以上	-	-
總計	3	3

- 註1：總經理及副總經理姓名應分別列示，以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或副總經理者應填列本表及上表(1)
- 註2：係填列最近年度總經理及副總經理薪資、職務加給、退職退休金、離職金。
- 註3：係填列最近年度總經理及副總經理各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供及其他報酬金額。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。
- 註4：係填列最近年度盈餘分配議案股東會前經董事會通過擬議配發總經理及副總經理之員工紅利金額(含股票紅利及現金紅利)，若無法預估者則按去年實際配發比例計算今年擬議配發數，並另應填列附表一之三。其股票紅利金額上市上櫃公司應以證券發行人財務報告編製準則規定公平價值(係指資產負債表日之收盤價)計算之；若非上市上櫃公司則以盈餘所屬年度會計期間結束日之淨值計算之。稅後純益係指最近年度之稅後純益。
- 註5：係指截至年報刊印日止總經理及副總經理取得員工認股權憑證得認購股數(不包括已執行部分)，除填列本表外，尚應填列附表十五。
- 註6：應揭露合併報表內所有公司(包括本公司)給付本公司總經理及副總經理各項酬金之總額。
- 註7：本公司給付每位總經理及副總經理各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。
- 註8：合併報表內所有公司(包括本公司)給付本公司每位總經理及副總經理各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。
- 註9：稅後純益係指最近年度之稅後純益。
- 註10：a.本欄應明確填列公司總經理及副總經理「有」或「無」領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金。  
 b.若填列「有」者，得自願性填列所領取酬金金額，並應依公司總經理及副總經理於子公司以外轉投資事業所擔任身分分別所領取之酬金，併入酬金級距表D欄，並將欄位名稱改為「所有轉投資事業」  
 c.酬金係指本公司總經理及副總經理擔任子公司以外轉投資事業之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞、員工紅利及業務執行費用等相關酬金。

\*本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同，故本表目的係作為資訊揭露之用，不作課稅之用。

#### 4、配發員工紅利之經理人姓名及配發情形

97年12月31日  
單位：新台幣仟元

	職稱	姓名	股票紅利金額	現金紅利金額	總計	總額占稅後純益之比例(%)
經 理 人	總經理	蔡顯章	7,845	-	7,845	2.56%
	副總經理	林燕松				
	副總經理	曾錦香				
	協理	吳俊欽				
	協理	葉君基				
	協理	王子越				
	協理	高金祥				

係填列最近年度盈餘分配股東會前經董事會通過擬議配發經理人之員工紅利金額(含股票紅利及現金紅利)，若無法預估者則按去年實際配發比例計算今年擬議配發數。其股票紅利金額上市上櫃公司應以證券發行人財務報告編製準則規定公平價值(係指資產負債表日之收盤價)計算之；若非上市上櫃公司則以盈餘所屬年度會計期間結束日之淨值計算之。稅後純益係指最近年度之稅後純益。

註1：應揭露個別姓名及職稱，但得以彙總方式揭露盈餘分配情形。

註2：經理人之適用範圍，依據本會九十二年三月二十七日台財證三字第○九二○○○一三○一號函令規定，其範圍如下：

- (1)總經理及相當等級者
- (2)副總經理及相當等級者
- (3)協理及相當等級者
- (4)財務部門主管
- (5)會計部門主管
- (6)其他有為公司管理事務及簽名權利之人

#### (四)分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序及與經營績效之關聯性。

##### 1、97年度董監事、總經理及副總經理酬金佔稅後純益比例

(1)本公司全體董事及監察人酬勞為新台幣10,674仟元，佔稅後純益3.47%。

(2)本公司總經理及副總經理酬勞為新台幣10,274仟元，佔稅後純益3.35%。

##### 2、96年度董監事、總經理及副總經理酬金佔稅後純益比例

(1)本公司全體董事及監察人酬勞為新台幣5,165仟元，佔稅後純益

4.09%。

(2)本公司總經理及副總經理酬勞為新台幣 8,511 仟元，佔稅後純益 6.74%。

- 3、本公司給付董監之酬金政策主要為盈餘分配之報酬，其分配金額係考量公司年度經營結果，遵循公司章程規定提報董事會並經股東會決議通過。
- 4、總經理及副總經理酬金包括薪資、獎金等。酬金給付政策則係依其所擔任之職位、所擔任之職位、所承擔之責任及參考同業相較於同性質職位之薪資水準所訂定。

### 三、公司治理運作情形

#### (一)董事會運作情形 4

最近年度(97年度)董事會開會 6 次 (A)，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席次數 B	委託出席次數	實際出(列)席率 (%)【B/A】	備註
董事長	陳永華	6	-	100%	
董事	鄭國樑	5	1	100%	
董事	林賜農	3	-	50%	
董事	周育民	6	-	100%	
董事	蔡顯章	5	-	83%	
獨立董事	嚴克文	6		100%	
獨立董事	林佳臻	6		100%	
其他應記載事項： 一、證交法第 14 條之 3 所列事項暨其他經獨立董事反對或保留意見且有記錄或書面聲明之董事會議決事項：無。 二、董事對利害關係議案迴避之執行情形：無此情形。 三、當年度及最近年度加強董事會職能之目標(例如設立審計委員會、提升資訊透明度等)與執行情形評估：無。					

(二)審計委員會運作情形資訊：本公司未設置審計委員會。

### (三)董事會運作情形

最近年度(97年度)董事會開會 6 次 (A)，監察人出席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席次數B	委託出席次數	實際出(列)席率(%)【B/A】	備註
監察人	莊永賀	4		67%	
監察人	王淑珍	5		83%	
獨立監察人	胡湘寧	6	-	100%	
<p>其他應記載事項：</p> <p>一、監察人之組成及職責：</p> <p>(一)監察人與公司員工及股東之溝通情形：意見溝通良好。</p> <p>(二)監察人與內部稽核主管及會計師之溝通情形：意見溝通良好。</p> <p>二、監察人列席董事會如有陳述意見，應述明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對監察人陳述意見之處理：無。</p>					

### (四)公司治理運作情形及其與上市櫃公司治理實務守則差異情形及原因：

項目	運作情形	與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
<p>一、公司股權結構及股東權益</p> <p>(一)公司處理股東建議或糾紛等問題之方式</p> <p>(二)公司掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單之情形</p> <p>(三)公司建立與關係企業風險控管機制及防火牆之方式</p>	<p>(一)本公司為確保股東權益，設有專責人員處理股東建議、疑義或糾紛等事項。</p> <p>(二)本公司目前主要股東多為經營團隊、原始投資股東或員工所有，本公司可隨時掌握實際公司之主要股東名單，確保經營權之穩定。</p> <p>(三)本公司已訂定「關係人交易管理辦法」、「集團企業特定公司作業程序」、「子公司監督管理辦法」及內部控制相關作業程序，以規範相關事宜。</p>	符合「上市上櫃公司治理實務守則」規定。
<p>二、董事會之組成及職責</p> <p>(一)公司設置獨立董事之情形</p> <p>(二)定期評估簽證會計師獨立性之情形</p>	<p>(一)本公司目前設有七席董事，其中包含二席獨立董事。</p> <p>(二)本公司聘任之簽證會計師為四大會計師事務所之一，對於其直接或間接利害關係已予迴避，並無欠缺獨立性之情事。</p>	符合「上市上櫃公司治理實務守則」規定。
<p>三、建立與利害關係人溝通管道之情形</p>	<p>本公司設有發言人及代理發言人，負責公司對外溝通事項。</p>	符合「上市上櫃公司治理實務守則」規定。

項目	運作情形	與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
<p>四、資訊公開</p> <p>(一)公司架設網站,揭露財務業務及公司治理資訊之情形</p> <p>(二)公司採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等)</p>	<p>(一)本公司設有網站(<a href="http://www.favite.com">www.favite.com</a>),介紹公司狀況及有關業務;並依主管機關規定於公開資訊觀測站公告申報各項財務、業務資訊。</p> <p>(二)本公司已架設中英文網站,並設有發言人及代理發言人,負責公司對外關係之溝通,且指派專人依據法令規定於公開資訊觀測站揭露公司資訊。</p>	<p>符合「上市上櫃公司治理實務守則」規定。</p>
<p>五、公司設置提名或薪酬委員會等功能委員會之運作情形</p>	<p>本公司已設有具備財會背景之獨立董事及監察人參與督導,實已具備審計委員會之功能,故其設置必要性尚再行研究。</p>	<p>符合「上市上櫃公司治理實務守則」規定。</p>
<p>六、公司如依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂有公司治理實務守則者,請敘明其運作與所訂公司治理實務守則之差異情形:</p> <p>本公司尚未訂定「公司治理實務守則」,惟本公司一向努力維護股東權益,並依據相關法規辦理各項資訊揭露;董事會亦秉承股東賦予之責任,擬訂各項經營策略並有效監督經營階層之管理功能,以創造股東最大利益。</p>		
<p>七、其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊(如員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等):</p> <p>(一)本公司經營理念為永續經營,提升企業活力與競爭力,增進產品與服務的項目與品質,使公司、員工、客戶同步成長,並持續努力經營,保障投資者權益,做好環保,維護社會資源,並善盡企業責任回饋社會。</p> <p>(二)董事及監察人進修之情形:依據個人時間安排及考量專業背景選擇適合之研習課程。</p> <p>(三)董事出席及監察人列席董事會狀況:已輸入股市觀測站,每次董事會對於各項議案均逐項仔細審議,並確實評估可能造成公司之營運風險。</p> <p>(四)公司為董事及監察人購買責任保險之情形:已購買董監事責任險。</p>		
<p>八、如有公司治理自評報告或委託其他專業機構之公司治理評鑑報告者,應敘明其自評(或委外評鑑)結果、主要缺失(或建議)事項及改善情形:不適用。</p>		
<p>註一:董事及監察人進修之情形,參考臺灣證券交易所股份有限公司所發布之「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點參考範例」之規定。</p> <p>註二:如為證券商、證券投資信託事業、證券投資顧問事業及期貨商者,應敘明風險管理政策、風險衡量標準及保護消費者或客戶政策之執行情形。</p> <p>註三:所稱公司治理自評報告,係指依據公司治理自評項目,由公司自行評估並說明,各自評項目中目前公司運作及執行情形之報告。</p>		

(五)履行社會責任情形:本公司經營理念為永續經營,提升企業活力與競爭力,增進產品與服務的項目與品質,使公司、員工、客戶同步成長,並持續努力經營,保障投資者權益,做好環保,維護社會資源,並善盡企業責任回饋社會。

(六)公司如有訂定公司治理守則及相關規章者,應揭露其查詢方式:不適用。

(七)其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊,得一併揭露:不適用。

## (六)內部控制制度執行狀況應揭露下列事項

### 1、內部控制聲明書

晶彩科技股份有限公司  
內部控制制度聲明書

日期：98年4月28日

本公司民國97年1月1日至97年12月31日之內部控制制度，依據自行檢查的結果，謹聲明如下：

- 一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等)、財務報導之可靠性及相關法令之遵循等目標的達成，提供合理的確保。
- 二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。
- 三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」(以下簡稱「處理準則」)規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1.控制環境，2.風險評估，3.控制作業，4.資訊及溝通，及5.監督。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。
- 四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，檢查內部控制制度之設計及執行的有效性。
- 五、本公司基於前項檢查結果，認為本公司上開期間的內部控制制度(含對子公司之監督與管理)，包括知悉營運之效果及效率目標達成之程度、財務報導之可靠性及相關法令之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
- 六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
- 七、本聲明書業經本公司民國98年4月28日董事會通過，出席董事五人，均同意本聲明書之內容，併此聲明。

晶彩科技股份有限公司

董事長：陳永華

總經理：蔡顯章



2、經本會要求公司需委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無。

(七)最近年度及截至年報刊印日止公司及其內部人員依法被處罰、公司對其內部人員違反內部控制制度規定之處罰、主要缺失與改善情形：無。

(八)最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議：

日期	股東會/董事會	重要決議事項
97.03.26	董事會	1.決議通過本公司 96 年度財務報表案。 2.決議通過本公司 96 年度內部控制制度聲明書案。 3.決議通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 4.決議通過修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。 5.決議通過修訂本公司 95 年度「員工認股權憑證發行及認股辦法」部分條文案。 6.決議通過設立本公司中科分公司案。 7.決議通過本公司額定資本額減少案。 8.決議通過本公司提高額定資本額案。 9.決議通過選定「促進產業升級條例」中免徵營利事業所得稅之租稅減免案。 10.決議通過本公司申請銀行融資案。 11.決議通過訂定本公司 97 年股東常會開會日期、地點及召集事由案。 12.決議通過訂定 97 年股東常會 1%以上股東提案之受理處所及期間案。
97.04.25	董事會	1.決議通過 96 年度盈餘分配案。 2.決議通過 96 年度盈餘、資本公積暨員工紅利轉增資發行新股案。 3.決議通過審查 1%以上股東提案列入股東會議程案。 4.決議通過本公司中科分公司經理人案。 5.決議通過委任安侯建業會計師事務所辦理本公司 97 年度財務報表簽證案。
97.06.13	股東會	1.承認 96 年度營業報告書及財務報表案。 2.承認 96 年度盈餘分配案。 3.決議通過本公司章程部分條文案。 4.決議通過本公司「股東會議事規則」部分條文案。 5.決議通過 96 年度盈餘、資本公積暨員工紅利轉增資發行新股案。 6.決議通過選定「促進產業升級條例」中免徵營利事業所得稅之租稅減免案。
97.06.24	董事會	1.決議通過於 98 年股東常會補提列特別盈餘案。 2.決議通過本公司訂定 96 年度現金股利除息基準日案。 3.決議通過本公司訂定 96 年度盈餘暨資本公積轉增資之增資基準日案。
97.08.20	董事會	1.決議通過本公司 97 年上半年度財務報表案。 2.決議通過本公司進行多元化業務發展之策略性投資案。 3.決議通過本公司申請銀行融資額度案。 4.決議通過本公司董監事及重要職員責任保險到期續約案。
97.10.28	董事會	1.決議通過本公司 97 年前三季財務報表案。 2.決議通過本公司進行多元化業務發展之策略性投資案。 3.決議通過本公司申請銀行融資額度案。 4.決議通過訂定本公司員工認股權憑證執行認購普通股轉發行新股之增資基準日案。 5.決議通過本公司內部稽核主管任免案。
97.12.25	董事會	1.決議通過本公司 98 年度預算案。 2.決議通過本公司 97 年度稽核計劃案。

日期	股東會/董事會	重要決議事項
98.02.12	董事會	1.決議通過本公司簽證會計師事務所內部調整更換會計師案。 2.決議通過選定「促進產業升級條例」中免徵營利事業所得稅之租稅減免案。 3.決議通過訂定本公司員工認股權憑證執行認購普通股轉發行新股之增資基準日案。
98.03.27	董事會	1.決議通過本公司 97 年度財務報表案。 2.決議通過修訂本公司章程部分條文案。 3.決議通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 4.決議通過修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文案。 5.決議通過訂定本公司 98 年股東常會開會日期、地點及召集事由案。 6.決議通過 97 年度盈餘分配案。 7.決議通過 97 年度盈餘、資本公積暨員工紅利轉增資發行新股案。 8.決議通過訂定 97 年股東常會 1% 以上股東提案之受理處所及期間案。 9.決議通過委任安侯建業會計師事務所辦理本公司 98 年度財務報表簽證案。 10.決議通過本公司申請銀行融資額度案。
98.04.28	董事會	1.決議通過本公司 98 年度第一季財務報表案。 2.決議通過本公司 97 年度內部控制制度聲明書案，提請討論。 3.決議通過審查 1% 以上股東提案列入股東會議程案。 4.決議通過訂定本公司員工認股權憑證執行認購普通股轉發行新股之增資基準日案。

(九)最近年度及截至年報刊印日止董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有記錄或書面聲明者，其主要內容：無。

(十)最近年度及截至年報刊印日止，與財務報告有關人士(包括董事長、總經理、會計主管及內部稽核主管等)辭職解任情形之彙總：

職稱	姓名	到任日期	解任日期	辭職或解認原因
稽核課長	戴振遠	95 年 3 月 1 日	97 年 10 月 16 日	個人生涯規劃請辭

#### 四、會計師公費資訊

(一)給付簽證會計師、簽證會計師所屬事務所及其關係企業之非審計公費占審計公費之比例達四分之一以上者，應揭露審計與非審計公費金額及非審計服務內容：

事務所名稱	會計師姓名		審計公費	非審計公費					會計師之查核期間是否涵蓋完整會計年度			備註	
				制度設計	工商登記	人力資源	其他(註1)	小計	是	否	查核期間		
安侯建業會計師事務所	張字信	郭士華	1,380,000				175,000	175,000	V				

註 1：非審計公費之「其他」係指辦理 97 年度工商登記公費。

(二)更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：無。

(三)審計公費較前一年度減少達百分之十五以上者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：無

五、更換會計師資訊：

(一)關於前任會計師

更換日期	98年01月07日		
更換原因及說明	配合會計師事務所內部調整更換會計師		
說明係委任人或會計師終止或不接受委任	當事人	會計師	委任人
	情況		
	主動終止委任		
	不再接受(繼續)委任		
最新兩年內簽發無保留意見以外之查核報告書意見及原因	無		
與發行人有無不同意見	有		會計原則或實務
			財務報告之揭露
			查核範圍或步驟
			其他
	無	V	
	說明		
其他揭露事項 (本準則第二十條之二第二款第一目第四點應加以揭露者)	無		

(二)關於繼任會計師

事務所名稱	安侯建業會計師事務所
會計師姓名	張字信會計師 郭士華會計師
委任之日期	98年01月07日
委任前就特定交易之會計處理方法或會計原則及對財務報告可能簽發之意見諮詢事項及結果	無

繼任會計師對前任會計師不同意見 事項之書面意見	無
----------------------------	---

(三)前任會計師對本準則第二十條之二第二款第一目及第二目第三點事項之復函：不適用。

六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者，應揭露其姓名、職稱及任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業之期間：無。

七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形

(一)董事、監察人、經理人及大股東股權變動情形

職稱	姓名	97年度		截至98年3月31日止	
		持有股數增(減)數(註)	質押股數增(減)數	持有股數增(減)數	質押股數增(減)數
董事長	陳永華	1,065,873	2,170,000	-	1,667,000
董事	鄭國樑	58,997	-	-	-
董事	林賜農	140,316	-	-	-
董事	周育民	363,821	-	-	-
董事/總經理	蔡顯章	207,719	-	(116,000)	-
獨立董事	嚴克文	-	-	-	-
獨立董事	林佳臻	-	-	-	-
監察人	莊永賀	103,139	-	-	-
監察人	王淑珍	(17,179)	-	(6,000)	-
獨立監察人	胡湘寧	-	-	-	-
副總經理	林燕松	88,329	-	(20,000)	-
副總經理	曾錦香	260,535	-	-	-
協理	吳俊欽	86,428	-	(11,000)	-
協理	葉君基	47,844	-	(57,000)	-
協理	高金祥	226,452	-	(146,000)	-
協理	王子越	544,225	1,712,000	-	-

(二)股權移轉資訊：

無股權移轉之相對人為關係人之情形。

(三)股權質押資訊：

無股權質押之相對人為關係人之情形。

八、持股比例占前十大股東間互為財務會計準則公報第六號關係人關係之資訊：

姓名(註1)	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有財務會計準則公報第六號關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係。(註3)		備註
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	名稱(或姓名)	關係	
陳永華	5,395,012	9.14	2,139,350	3.63	-	-	王子越	配偶	-
中華開發工業銀行股份有限公司	2,484,000	4.21	-	-	-	-	-	-	-
永捷高分子工業股份有限公司	2,454,837	4.16	-	-	-	-	-	-	-
王子越	2,139,350	3.63	5,395,012	9.14	-	-	陳永華	配偶	-
周育民	2,132,929	3.61	728,117	1.24	-	-	-	-	-
漢通創業投資股份有限公司	1,546,000	2.62	-	-	-	-	-	-	-

中盈投資開發股份有限公司	1,084,000	1.84	-	-	-	-	-	-	-
台灣人壽保險股份有限公司	924,000	1.57	-	-	-	-	-	-	-
林賜農	841,899	1.43	-	-	-	-	-	-	-
林振益	778,660	1.32	-	-	-	-	-	-	-

九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資之持股數，並合併計算綜合持股比例

97年12月31日 單位：股；%

轉投資事業	本公司投資		董事、監察人、經理人及直接或間接控制事業之投資		綜合投資	
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
鑫豪科技股份有限公司	1,300,000	19.23%	-	-	1,300,000	19.23%
華康半導體股份有限公司	5,219,000	24.85%	523,000	2.49%	5,742,000	27.34%
晶隼科技股份有限公司	500,000	10.00%	1,998,000	39.96%	2,498,000	49.96%

## 肆、募資情形

### 一、資本及股份

#### (一)股本來源

##### (1)股本形成經過

年月	發行價格(元)	核定股本		實收股本		備註		
		股數(仟股)	金額(仟元)	股數(仟股)	金額(仟元)	股本來源	以現金以外財產抵充股款者	其他
89.3	10	100	1,000	100	1,000	現金增資	-	89年3月10日經(89)中字第392266號
89.5	10	5,000	50,000	5,000	50,000	現金增資	-	89年6月10日經(89)中字第436229號
91.4	28	5,800	58,000	5,800	58,000	現金增資	-	91年4月29日經授中字第09132041160號
92.1	10	10,000	100,000	10,000	100,000	現金增資	-	92年1月22日經授商字第09201018260號
93.3	10	15,000	150,000	15,000	150,000	現金增資	-	93年3月17日經授中字第09331825840號
93.11	10	20,000	200,000	20,000	200,000	現金增資	-	93年11月19日經授中字第0933304899號
94.8	10	25,000	250,000	25,000	250,000	現金增資	-	94年8月25日經授中字第09432728210號
95.6	10	50,000	500,000	30,000	300,000	現金增資	-	95年8月07日經授中字第09532612320號
95.11	40	50,000	500,000	38,000	380,000	現金增資	-	95年9月13日金管證一字第0950140080號
96.08	10	50,000	500,000	41,830	418,300	盈餘暨員工紅利轉增資	-	96年7月4日金管證一字第0960034050號
97.02	27	50,000	500,000	46,674	466,740	現金增資	-	97年2月15日經授中字第09731727570號
97.06	-	100,000	1,000,000	46,674	466,740	增加額定資本額	-	97年6月25日經授中字第09732506560號
97.09	10	100,000	1,000,000	57,028	570,288	盈餘暨員工紅利轉增資	-	97年9月05日經授商字第09707887870號
97.11	10	100,000	1,000,000	58,773	587,738	員工認股權	-	97年11月19日經授商字第09701294670號
98.03	10	100,000	1,000,000	58,934	589,348	員工認股權	-	98年03月06日經授商字第09801041060號
98.05	10	100,000	1,000,000	59,008	590,088	員工認股權	-	截至年報刊印日止尚未取得商業司核准

## (2)已發行之股份總類

98年04月18日；單位：仟股

股 種 份 類	核 定 股 本			備 註
	流通在外股份 (註1)	未 發 行 股 份	合 計	
普通股	59,008	40,992	100,000	

(3)總括申報制度相關資訊：無。

## (二)股東結構

98年4月18日；單位：股

股東 結構 數量	政府機 構	金融機構	其他法人	個人	外國機構 及外人	合計
人數	1	3	23	3,142	12	3,181
持有股數	200	3,410,400	8,518,929	45,368,264	1,711,007	59,008,800
持股比例%	-	5.78	24.43	76.88	2.9	100.00

## (三)股權分散情形

每股面額 10 元 98年4月18日

持股分級	股東人數	持有股數	持股比例%
1 至 999	422	89,079	0.15
1,000 至 5,000	1,887	4,397,599	7.45
5,001 至 10,000	386	3,143,210	5.33
10,001 至 15,000	115	1,456,482	2.47
15,001 至 20,000	70	1,319,512	2.24
20,001 至 30,000	78	2,036,547	3.45
30,001 至 50,000	84	3,332,073	5.65
50,001 至 100,000	55	3,884,296	6.58
100,001 至 200,000	31	4,399,820	7.46
200,001 至 400,000	31	8,038,907	13.62
400,001 至 600,000	5	2,453,421	4.16
600,001 至 800,000	8	5,455,827	9.25
800,001 至 1000,000	2	1,765,899	2.99
1,000,001 以上	7	17,236,128	29.21
合 計	3,181	59,008,800	100.00



## (四)主要股東名單(股權比例達百分之五以上之股東或股權比例占前十名之股東)

98年04月18日

主要股東名稱	股份	持有股數(股)	持股比例(%)
陳永華		5,395,012	9.14
中華開發工業銀行股份有限公司		2,484,000	4.21
永捷高分子工業股份有限公司		2,454,837	4.16
王子越		2,139,350	3.63
周育民		2,132,929	3.61
漢通創業投資股份有限公司		1,546,000	2.62
中盈投資開發股份有限公司		1,084,000	1.84
台灣人壽保險股份有限公司		924,000	1.57
林賜農		841,899	1.43
林振益		778,660	1.32

## (五)最近二年度每股市價、淨值、盈餘、股利及相關資料

項 目	年 度		96年	97年	98年度截至 3月31日
	每股	最 高		不適用	57.9
市價	最 低		不適用	16.5	18.45
	平 均		不適用	35.95	22.05
	分 配 前		19.29	21.31	-
每股淨值	分 配 後 (註1)		13.77	註 7	-
	加權平均股數		41,830 仟股	57,295 仟股	58,961 仟股
每股盈餘	每 股 盈 餘 (註2)		2.46	5.35	-
	現 金 股 利		0.13	0.16	-
每股 股利	無償配股	盈餘配股	1.80	3.00	-
		資本公積配股	0.20	-	-
	累積未付股利 (註3)		-	-	-
投資報酬分析	本益比 (註4)		未上市/櫃	6.72	-
	本利比 (註5)		未上市/櫃	224.69	-
	現金股利殖利率 (註6)		未上市/櫃	0.0045	-

註 1：依據次年度股東會決議分配之情形填。

註 1：依據次年度股東會決議分配之情形填列。

註 2：每股盈餘係按追溯調整後加權平均股數計算。

註 3：權益證券發行條件如有規定當年度未發放之股利得累積至有盈餘年度發放者，應分別揭露截至當年度止累積未付之股利。

註 4：本益比＝當年度每股平均收盤價／每股盈餘。

註 5：本利比＝當年度每股平均收盤價／每股現金股利。

註 6：現金股利殖利率＝每股現金股利／當年度每股平均收盤價

註 7：97年度盈餘分配案尚未經股東會決議通過。

## (六)公司股利政策及執行情形

### 1.公司股利政策：

本公司每年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補以前年度虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，如尚有盈餘作百分比再分配如下：

一、股東紅利百分之八十八。

二、員工紅利百分之十。發放對象亦適用於從屬公司之員工。

三、董事監察人酬勞百分之二。

本公司股利政策係配合當年度之資本、財務結構、整體環境及產業成長特性，以達成公司永續經營、穩定經營績效之目標，故本公司之股利分派將以不超過公司可分派盈餘百分之九十分派予股東。而依未來資本支出預算及資金需求情形，本公司股利發放採股票股利(含盈餘轉增資、資本公積轉增資)及現金股利二種方式配合辦理，其中現金股利不低於股利總額之百分之五。

### 2.本次股東會擬議股利分配之情形：

本公司 97 年度擬配發股東股票股利 177,026,400 元，現金股利 9,317,179 元及配發員工現金紅利 175,407 元，員工股票紅利 21,000,000 元；另擬配發董監酬勞 4,235,081 元。以上盈餘分配案尚待本次 98 年 6 月 16 日股東常會決議通過。

### 3.預期股利政策將有重大變動時，應加以說明：本公司股利政策並無重大變動。

## (七)本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：

### 1.無償配股對公司營業績效之影響：

97 年度擬議配之無償配股對本公司未來營運績效及每股盈餘，雖會有因股本擴大而略有稀釋之影響，惟以本公司未來所屬產業之成長空間觀之，影響程度應不大。

### 2.無償配股對每股盈餘之影響：

		98 年度(預估)
期初實收資本額		590,088
本年度配股配息情形(註 1)	每股現金股利(元)	0.1578
	盈餘轉增資每股配股數(股)	0.3
對營業績效之影響		不影響
對每股盈餘之影響		不影響

註 1：尚未經股東常會決議。

**(八)員工分紅及董事、監察人酬勞：**

1. 公司章程所載員工分紅及董事、監察人酬勞之成數或範圍：

本公司每年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補以前年度虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，如尚有盈餘作百分比再分配如下：

- 一、股東紅利百分之八十八。
- 二、員工紅利百分之十。發放對象亦適用於從屬公司之員工。
- 三、董事監察人酬勞百分之二。

2. 董事會通過之擬議配發員工分紅等資訊：

(1) 配發員工現金紅利、股票紅利及董事、監察人酬勞金額。

項 目	擬議配發金額(元)
員工現金紅利	175,407
員工股票紅利	21,000,000
董監事酬勞	4,235,081

(2) 擬議配發員工股票紅利股數以其員工紅利新台幣 21,000,000 元依股東會前一日收盤價並考量除權除息之影響為計算基礎之。

(3) 擬議配發員工紅利後之設算每股盈餘為

3. 上年度盈餘用以配發員工紅利及董事、監察人酬勞情形：

本公司經 97 年 6 月 13 日股東常會決議由未分配盈餘中分配員工紅利 10,236,457 元(其中 36,457 元以現金發放，10,200,000 元以配股方式發放)及董監事酬勞 2,047,291 元，與 97 年 4 月 25 日董事會決議配發情形一致。

**(九)公司買回本公司股份情形：無。**

**二、公司債辦理情形：無。**

**三、特別股辦理情形：無。**

**四、海外存託憑證辦理情形：無。**

## 五、員工認股權憑證辦理情形：

### (一)公司尚未屆期之員工認股權憑證：

#### 員工認股權憑證辦理情形

98年4月18日

單位：新台幣仟元、仟單位、仟股

員工認股權憑證種類	95年度第一次員工認股權憑證
主管機關核准日期	-
發行日期	95.8.15
存續期間	95.8.15~102.8.15
發行單位數	2,000
發行得認購股數占已發行股份總數比率	3.39%
得認股期間	自授予員工認股權憑證屆滿二年後至102.8.15
履約方式	發行新股
限制認股期間及比率(%)	屆滿二年可全數認購
已執行取得股數	1,980
已執行取得金額	19,800
已失效認股數量	20
未執行認股者其每股認購價格	最近一期經會計師查核簽證之財務報告每股淨值，惟其認股價格不得低於面額。
未執行者認股數量占已發行股份總數(%)	0.03%
對股東權益影響	本公司為吸引及留任公司所需人才，並提高員工對公司之向心力及歸屬感，共同創造公司及股東之利益，對股東權益具有正面影響；且其認股數量佔公司已發行股份總數為，對股權稀釋效果不大，因此對股東權益尚無重大影響。

(二)累積至年報印刊日止取得員工認股權憑證之經理人及取得憑證數量前十大且得認購金額達新台幣三千萬元以上員工之姓名、取得及認購情形：無。

(三)最近三年度私募員工認股權憑證辦理情形，應揭露股東會通過日期與數額、價格訂定之依據及合理性、特定人選擇之方式(其已洽定應募人者，並敘明應募人姓名及其與公司之關係)、辦理私募之必要理由及截至年報刊印日止執行情形：無。

六、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無。

## 七、資金運用計劃執行情形：

(一)計劃內容：截至年報刊印日之前一季止，前各次發行或私募有價證券尚未完成或最近三年內已完成且計劃效益尚未顯現者，應詳細說明前開各次發行或私募有價證券計劃內容，包括歷次變更計劃內容、資金之來源與運用、變更原因、變更前後效益及變更計劃提報股東會之日期，並應刊載輸入本會指定資訊申報網站之日期：不適用。

(二)執行情形：就前款之各次計劃之用途，逐項分析截至年報刊印日之前一季止，其執行情形

及與原預計效益之比較，如執行進度或效益未達預計目標者，應具體說明其原因、對股東權益之影響及改進計劃。前款之各次計劃內容如屬下列各目者，另應揭露下列事項：

- 1.如為併購或受讓其他公司、擴建或新建固定資產者，應就固定資產、營業收入、營業成本及營業利益等科目予以比較說明：不適用。
- 2.如為轉投資其他公司，應就該轉投資事業之營運情形、對公司投資損益之影響加以說明：不適用。

## 伍、營運概況

### 一、業務內容

#### (一)業務範圍

(1)所營業務之主要內容：

- A. I301010 資訊軟體服務業。
- B. F213040 精密儀器零售業。
- C. CB01010 機械設備製造業。
- D. CE01010 一般儀器製造業。
- E. CC01080 電子零組件製造業。
- F. ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

(2)營業比重

單位：新台幣仟元

主要產品	97 年度	
	營業收入	營業比重
TFT-LCD 面板及彩色濾光片自動光學檢測機	1,329,750	99.67%
其他	4,380	0.33%
合計	1,334,130	100.00%

## (3)公司目前之商品(服務)項目

產業區分	產品種類(用途)	產品名稱
精密機械產業	TFT Array 檢測、量測、修補設備	薄膜電晶體低解析度自動光學檢測機
		薄膜電晶體高解析度自動光學檢測機
		素玻璃自動光學檢測機
		突起物自動光學檢測機
		光罩自動光學檢測機
		ADSI自動線寬量測機
		膜厚量測機
	Color Filter 檢測、量測、修補設備	彩色濾光片自動光學檢測機
		高速缺陷複檢機
		突起物自動光學檢測機
		Digital Marco自動光學檢測機
		CD/OL量測機
		色度、膜厚、光學密度量測機
	TFT Cell 檢測、量測、修補設備	PI 自動光學檢測機
		Seal 框膠自動光學檢測機
		Burr Check 切裂自動光學檢測機
		Particle Counter 粒子檢查機
	零配件、維修收入	
	RFID 產業	高頻及超高頻 RFID 標籤
高頻及超高頻 RFID Inlay (天線+RFID Chip)		
高頻及超高頻 RFID 標籤成品(貼紙、票卡、航空行李條)		
超高頻 RFID 讀取器		EPC C1 Gen2 超高頻 RFID 讀取器模組
		EPC C1 Gen2 超高頻 RFID 固定式讀取器
		EPC C1 Gen2 超高頻 RFID 手持式讀取器
超高頻 RFID 遙控器		超高頻 RFID 遙控器模組
		52-Key TV 用超高頻 RFID 遙控器

#### (4)計劃開發之新商品(服務)

產業區分	產品名稱	主要用途
精密機械產業	TFT面板雷射修補機	以雷射技術將缺陷區之TFT線路打掉或將金屬層熔接
	次世代機台設備開發	配合客戶擴廠需求，開發7.5代以上相關設備
	自動缺陷修補機	結合缺陷複檢機、自動缺陷判定軟體以及缺陷修補機技術，以判定缺陷是否需要修補，同時將該缺陷自動修補。
	RFID Inlay&Tag	以即時影像檢測及光學對位技術運用於RFID封裝測試
RFID 產業	RFID Inlay & Tag 製造設備	以具有即時影像檢測及光學對位等精密技術，而用以開發 RFID IC 的覆晶封裝生產設備及標籤壓合生產設備。
	超高頻 RFID 讀取器	係利用 Impinj R1000 RFID Reader Chipset，以開發符合 EPC C1 Gen2 規範的雙天線超高頻 RFID 讀取器模組；同時可利用此模組功能，衍生開發出八天線超高頻 RFID 固定式及單天線超高頻 RFID 手持式讀取器，而能提供完整的超高頻 RFID 讀取器產品系列。
	超高頻 RFID 遙控器	利用超高頻 RFID 的超省電、無方向性及遠距離傳輸等技術，開發適用於整體家電系列的遙控器模組，而以操控簡便及免更換電池的強力訴求，以取代目前的紅外線遙控器。

## (二) 產業概況

本公司原係屬專業精密機械產品開發的生產製造廠商，產品本包含平面顯示器的檢測/量測/修補、Solar Cell 的檢測/量測/篩選設備及其他產業的檢測/量測設備等；然基於業務的擴展及避免產品因產業及銷售集中現象所衍生之負面效應，本公司自 2008 年初起積極推動 RFID 相關系列產品之開發，其所研製之產品類別包含 RFID 標籤(Tag)、超高頻 RFID 讀取器及遙控器等。而由於新產品開發的進度順利，是故自 2009 年度起，本公司的營運將同時正式跨足精密機械生產製造及 RFID 相關產品生產製造等兩大產業領域，藉此以穩定擴展公司的營運規模，而以下茲就各產業領域，簡述其產業概況

### 1. 產業之現況與發展

#### A. 精密機械產業

##### (1) 平面顯示器產業市場分析與回顧

2008 年第四季台灣平面顯示器總產值約達新台幣 2,642.4 億元，比前一季衰退 35.3%。其中面板產業產值約新台幣 1,829.1 億元，比前一季衰退 39.1%，主力為大型 TFT-LCD 面板產業，產值約新台幣 1,326 億元；其次為中小型 TFT-LCD 面板產業，產值約新台幣 370 億元；而 TN/STN 面板產業，產值約新台幣 110.9 億元。此外，關鍵零組件產業產值估計總額約為新台幣 813.3



億元，比前一季衰退 25.4%，其中彩色濾光片產業產值約新台幣 182.9 億元，偏光板產業產值約新台幣 87.3 億元，玻璃基板產業產值約新台幣 286.8 億元，背光模組產業產值約新台幣 256.3 億元。

然就大型 TFT-LCD 面板產業而言，2008 年第四季台灣大型 TFT LCD 產值在需求持續萎縮導致價格低下，以及廠商減產的雙重效應影響下，呈現旺季不旺的態勢，較 2008 第三季更為減少，金額萎縮至 1,326.9 億新台幣的規模。主要原因仍在於金融海嘯持續衝擊歐美各國經濟，失業率攀升的隱憂與對未來的不確定性，致使消費者對消費性電子產品的購買意願普遍低落。由於觀望氣氛濃厚，連帶終端廠商對面板的備貨意願也相對保守，也讓大型面板報價持續走跌，所以整體預估 2008 年第四季整季平均跌價幅度約 2~3 成。為控制價格跌勢，廠商紛紛以減產因應，在報價仍低以及減產效應的作用下，嚴重影響廠商營收。

## (2) 平面顯示器設備市場分析與回顧

2008 年底，百年難得一見的金融海嘯席捲全球，原本第四季為面板廠商期待的傳統旺季，然因遭受景氣不彰的拖累，需求端持續嚴重萎縮，使面板銷售呈現空前的寒冬，就如歐美零售市場，在傳統聖誕節假期 LCD TV 銷售的旺季，其表現也不若以往的熱絡；是故，系統廠商為避免庫存堆積，嚴格的限制對上游面板廠的下單，因此讓面板報價不斷呈現節節敗退的局面；而面板業者為控制價格下跌，亦不斷以減產的方式來應對，如此的連鎖效應，導致台灣面板產業在第四季的產能利用率嚴重的下滑，銷售也大幅的滑落；接續而來的，是成本費用的樽節，資本支出也全部凍結；此舉也使得 TFT LCD 設備廠商業績一落千丈，急速冷凍。

時序進入 2009 年初，受惠於中國大陸家電下鄉政策，所湧現的集單效應，致國內面板產業呈現短暫的復甦；然急單效應所眷顧的，僅係去化面板廠商前幾季羈押的庫存，並非意味著面板銷售有大幅反轉的可能。另外，普遍業者對中國政府宣示的家電下鄉政策寄予厚望，然而此次中國政府對於 LCD TV 購買的補助，多數集中於 10~20 吋級規格較低之 TV 面板；而 2008 年底設備廠商接獲的新設備採購訂單，主係集中於大世代大尺寸的面板生產設備，是故，此番中小尺寸急單需求的效應，對於大世代設備 move in 使用並沒有積極的推動能力，所以截至 2009 年第一季，國內 2 大面板廠大世代廠的擴展，仍然處於半停滯狀態；同時家電下鄉政策預期應為暫時階段性政策，對面板未來長期穩定的需求提升，並無持續性的助益，所以下一波台灣面板相關產業的振興，端視全球大環境景氣能否復甦為依歸。

Taiwan FPD Revenue (Unit: 100 Million NTD)		2008Q1		2008Q2		2008Q3		2008Q4		2008		2009Q1(e)		2009(a)	
		Revenue	Q/Q	Revenue	Q/Q	Revenue	Q/Q	Revenue	Q/Q	Revenue	Y/Y	Revenue	Q/Q	Revenue	Y/Y
Panel	TFT-LCD(>10")	2,936.5	-12.6%	2,815.9	-4.1%	2,426.0	-13.8%	1,326.9	-45.3%	9,505.3	-12.6%	1,194.3	-10.0%	7,984.5	-16.0%
	TFT-LCD(<10")	429.0	-6.3%	391.2	-22.8%	416.0	25.6%	37.0	-11.0%	1,545.4	21.6%	288.8	-22.0%	1,402.9	-9.3%
	TN&TN LCD	132.0	-11.6%	122.0	-7.6%	138.3	13.4%	110.9	-19.5%	503.2	-21.1%	112.4	1.4%	419.6	-16.6%
	OLED	16.3	-10.4%	17.8	9.2%	21.9	23.0%	19.9	-9.0%	75.9	19.7%	18.3	-8.0%	83.7	10.2%
	Others	1.4	-12.5%	1.3	-7.1%	1.5	15.4%	1.2	-20.0%	5.4	-19.4%	1.1	-8.3%	5.0	-7.4%
Sub-totl		3,515.2	-11.7%	3,288.2	-6.5%	3,003.7	-9.7%	1,829.1	-39.1%	11,636.1	-8.4%	1,614.8	-11.7%	9,887.7	-15.0%
Key Parts	Color Filter	380.0	-11.0%	388.3	3.1%	315.3	-14.4%	182.9	-42.0%	1,245.5	-6.8%	154.5	-15.5%	838.6	-32.7%
	Polarizer	177.5	-10.4%	181.0	2.0%	150.4	-16.9%	87.3	-42.0%	596.2	-13.8%	90.3	6.9%	506.6	-15.0%
	Glass Substrate	339.0	2.0%	332.2	-2.0%	322.2	-3.0%	265.5	-11.0%	1,200.2	10.8%	266.7	-1.0%	1,167.5	-8.8%
	Backlight Unit	379.2	-6.6%	380.1	0.2%	375.2	-1.3%	285.3	-23.7%	1,390.8	-1.3%	277.2	8.2%	1,176.5	-15.4%
	Sub-totl	1,275.7	-6.1%	1,261.6	-1.1%	1,163.1	-7.8%	813.2	-30.1%	4,518.6	-3.4%	791.8	-2.4%	3,689.2	-18.3%
FPD Totl		4,790.9	-10.3%	4,549.8	-5.0%	4,166.8	-9.4%	2,642.4	-35.3%	16,284.0	-7.5%	2,406.6	-18.3%	13,576.9	-16.2%

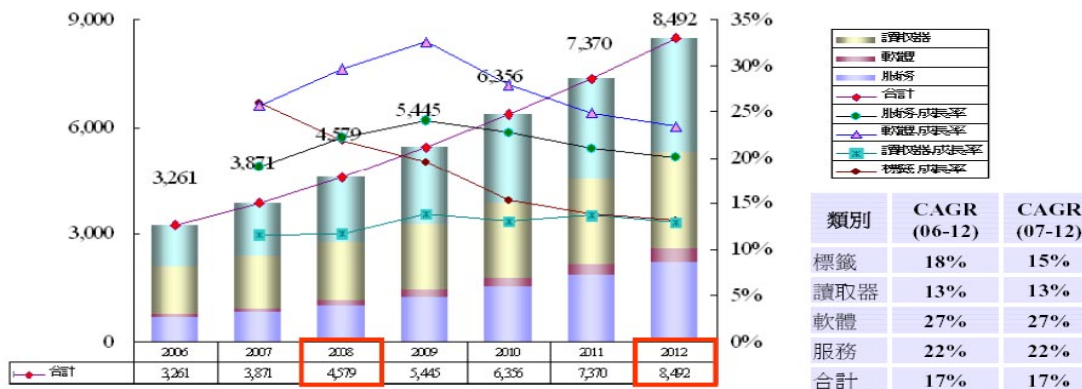
我國平面顯示器產業 2008 年第四季回顧與 2009 年第一季觀察

## B. RFID 產業

無線射頻辨識系統(RFID)具備無線讀取、讀取範圍廣泛及資料儲存量大等功能特性，因此可以普遍應用於物流的追蹤、管理效率和資訊回饋等，且自 2003 年零售業者沃爾瑪(Wal-Mart)要求前一百大供應商在 2005 年前導入 RFID，而開始廣受市場關注。

以 RFID 應用層面而言，根據資策會調查顯示，2007~2012 年應用成長率最高的產業為零售業、健康照護與生產製造，年複合成長率分別為 38.7%、36.5%、35.8%，可以窺知 RFID 導入範圍。隨著零售業的帶動、RFID 技術改進和標準訂定逐漸跨入多樣領域。據資策會創新應用研究所調查，RFID 未來 5 年關鍵應用產業將是汽車、政府部門、運輸物流，產值集中在高頻、低頻(LF)技術，約達到整體硬體產值的八成，也因為該技術的成熟，未來以封閉系統應用為主，關鍵應用在車輛管理、文件管理與存取控制。

### (1)全球各項 RFID 相關產品的市場規模預估

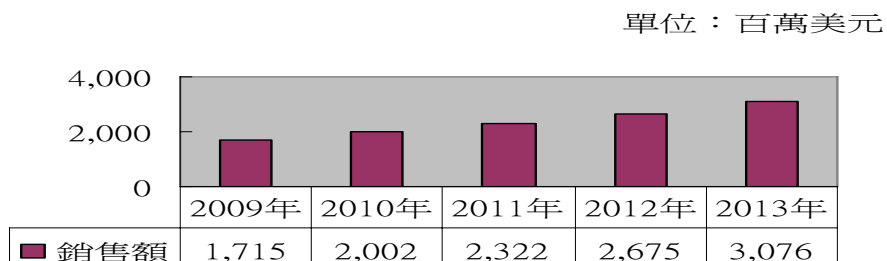


(資料來源：ABI Research(2007Q4)；單位：百萬美元)

ABI Research 估計，2008 年全球 RFID 市場規模可達美金 45.7 億元，至 2012 年可達美金 84.9 億元，年複合成長率約為 17%，全球市場將呈現穩定成長的現象；而未來 5 年內產值，主要係來自於 RFID 硬體(包含讀取器與標籤)，約佔總產值的 7 成，而成長動能則以軟體為最高，年複合成長率為 27%，且自 2009 年起將開始顯著的成長。

### (2)全球無線射頻辨識讀取器(RFID Reader)市場規模預估

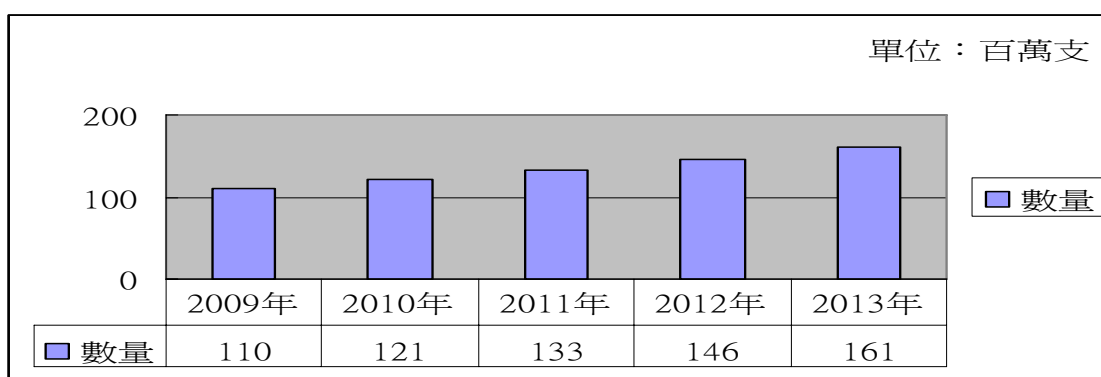
根據上述 ABI Research 的市場預測資料，全球 RFID Reader 佔所有 RFID 產品的 31.5%，而根據 2012 年後的成長率預估為 15%，故推估全球無線射頻辨識讀取器(RFID Reader)市場規模如下表：



### (3)全球遙控器相關產業之市場預估

根據日本 NIKKEI ELECTRONICS 的報導資料，2007 年全球的遙控器市場規模高達 6 億台。這些遙控器主要是用在家電系列產品的控制，包括 CRT TV、PDP-TV、LCD-TV、CD/DVD Player、BD-DVD Player、音響設備、空調設備等。目前遙控器的技術因成本因素幾乎全部採用紅外線遙控器，然較高級之產品如 LCD-TV，已逐漸有採用 RF 遙控器的趨勢。

RFID 遙控器的潛在市場，將以平面顯示器(LCD-TV & PDP-TV)為主，因此，全球平面顯示器的市場規模即為 RFID 遙控器的市場規模。根據 Display Search 統計，全球平面顯示器 2008 年的市場規模預估達到一億台的規模，若每年仍以 10% 的比例成長，則預估未來五年 RFID 遙控器的市場規模如下：



資料來源: Display Search 、Favite 整理

## 2.產業上、中、下游之關聯性：

### A. 精密機械產業

#### 上游：

本公司的核心技術包含多項尖端技術：如彩色圖像識別演算法、光學取像技術、照明系統、精密機械設計、光機電控制整合、數位影像處理電路與相機等，因此公司在開發機台的同時，也將帶動上游相關產業的蓬勃發展。如在軟體方面，除自行開發的優化函式庫，可以採用模版比對或鄰邊比對等技術，而針對不同應用的瑕疵檢測，也將提高檢出率及縮短檢測時間，以符合客戶實際生產的需求，另外並研發出高速瑕疵檢測演算法，更為世界先進，國內目前均無法開發出如此有效率的 algorithms，將可帶動國內檢測軟體的提昇；在機械設計方面，除了栽培大型機台開發設計的優秀技術人員外，同時也提升協力加工廠對於大型精密設備加工的技术經驗，而提升整體產業競爭能力。

#### 中游：自動光學檢測產業

一直以來，國內自動光學檢測設備製造產業，由於對於核心技術的欠缺，所有廠商均只擁有一、兩項專業技術，無法進行有效的垂直整合系統，只能做低階的檢測，致使國內高科技產業所需的高階檢測設備，均需仰賴國外公司的昂貴機台及服務。晶彩科技以彩色影像分析軟體技術發跡，持續集結光學、電子及機構設計等相關技術人才，在歷經不斷的開發測試，所累積

的技術經驗，使我們成功開發出大型精密機械所需之所有相關技術(包含彩色圖像識別演算法、光學取像技術、照明系統、精密機械設計、光機電控制整合、數位影像處理電路及系統整合等)，不斷受到客戶高度的肯定與信賴，也成為國內目前唯一能開發 TFT-LCD Array 段檢測設備的專業廠商。是故，晶彩科技將持續開發更新更嶄新的技術，以帶動國內自動光學檢測產業科技的提昇，使台灣能與國際相抗衡。

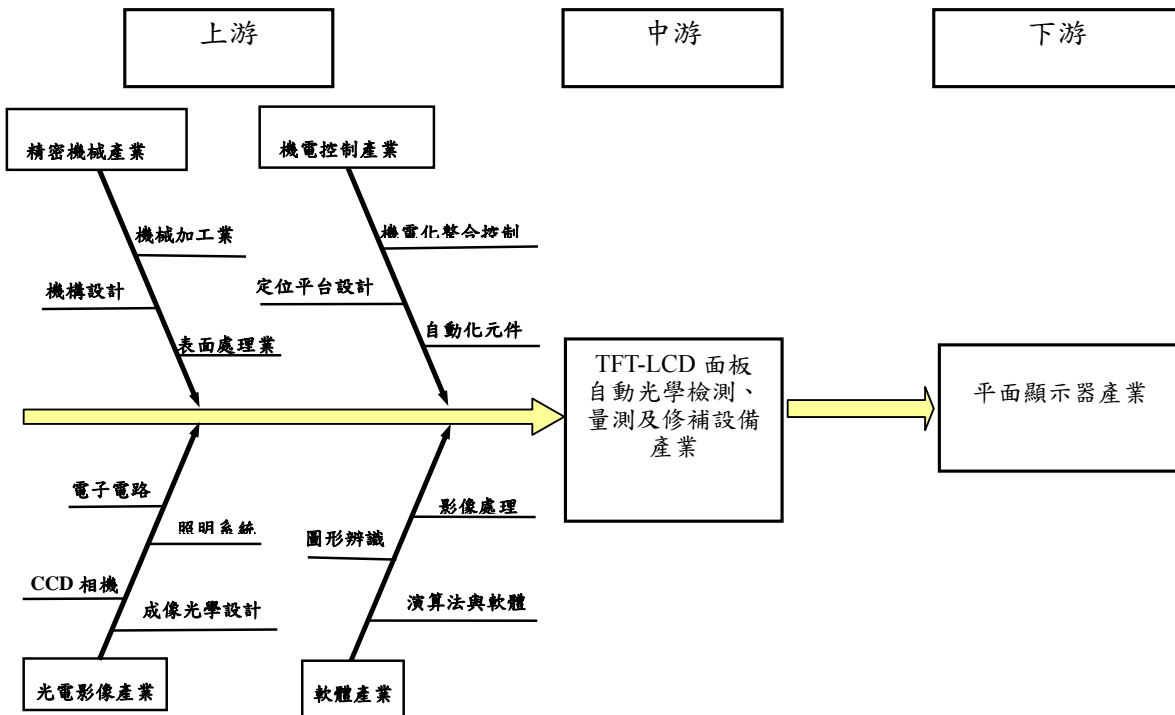
#### 下游：TFT-LCD 面板製造業

過去，TFT-LCD 產業由日本主導，相關的製程設備與原物料同樣也掌握在日本手中，而國內 TFT-LCD 產業發展較日、韓晚，市場規模也小，造成技術與人才不足，國內生產設備自製率因而較低，使得我國面板廠商絕大部分的設備皆須仰賴日本、美國，甚至近年來新興的韓國設備廠商供應。就國內整體 LCD 設備市場發展而言，2001 年國內並沒有 LCD 設備產值，2002 年國內面板廠開始少量採用國產設備。而國內廠商在 TFT-LCD 設備的開發是由檢測設備、洗淨設備、自動化設備、設備代工開始，目前則是以自動光學檢測設備與輸送設備為主。

隨著半導體與 TFT-LCD 兩兆雙星計畫的推動，引發國內廠商對自動化測試設備的需求擴大，因此政府為強化國內完備的 TFT-LCD 面板產業鏈，逐步朝上游設備產業發展，經由策略的扶植以及業界的努力，大力推動設備國產化，計畫要在五年內，達到我國整體半導體積體電路與平面顯示器設備自製率 50% 的目標。而自動化光學檢測機為一光、機、電技術與影像軟體處理等整合性系統，對平面顯示器面板製程的線上監控或自動化檢測作業的品質管控已日益重要，且目前面板業者仍面臨降價壓力，價格戰一觸即發，為縮小與日、韓廠商的成本差異，關鍵設備技術的掌握與設備自製的需求就更為迫切。本公司開發出的檢測機台將可提供與台灣 TFT-LCD 面板廠以下的優勢：

- 合理價格與優惠
- 客製化產品
- 立即專業服務
- 提昇產品品質
- 改善良率
- 減少對國外廠商的依賴
- 加速台灣 TFT-LCD 面板廠製程技術自行開發腳步

## 產業關聯性



### B. RFID 產業

#### 上游：RFID 標籤 IC 及讀取器、遙控器 IC 研發及製造

RFID 產業的上游包括 RFID 標籤 IC 及讀取器、遙控器 IC 研發及製造，以及相關的材料製造，包括電子零組件、PET 膜、導電膠、電鍍藥液等之供應。RFID IC 研發牽涉的核心技術包含無線射頻技術、可重複讀寫的 EEPROM 記憶體技術、以及各項傳輸 Protocol 的數位技術。在 RFID 標籤產品方面，本公司主要使用 NXP 的小容量記憶體(128 bit / 512 bit) 標籤 IC，以及關係企業所研發的大容量記憶體(64K/128K bit) 標籤 IC；在超高頻 RFID 讀取器產品方面，本公司主要使用原 Intel 所開發的 R1000 Reader Chipset (現已被 Impinj 所合併)；在超高頻 RFID 遙控器產品方面，本公司則使用關係企業所研發的 RFID 遙控器 IC。

#### 中游：RFID 標籤 IC 及讀取器、遙控器 IC 研發及製造

本公司所製造的高頻及超高頻 RFID 標籤、超高頻 RFID 讀取器以及超高頻 RFID 遙控器係 RFID 產業的中游。其中 RFID 標籤的製造成功關鍵在於製程 Know-how，本公司的優勢在於 PET 模的軟板電鍍銅製程；超高頻 RFID 讀取器開發的成功關鍵在於無線射頻的產品研發專業，本公司已有優秀人才且已成功開發出符合 EPC C1 Gen2 規範的超高頻 RFID 讀取器，是全世界少數有研發能力的廠商；超高頻 RFID 遙控器係本公司與關係企業合作開發的產品，主係利用關係企業的超高頻標籤 IC 改造而成，其所具備超低耗電、廣視角及無障礙的特性，是全世界最低耗電及最具成本競爭力的獨特無線遙控器。

## 下游：RFID 系統整合及各種應用

RFID 的下游應用涵蓋層面甚廣，包括：

- (1)物流：物流倉儲是 RFID 最有潛力的應用領域之一，UPS、DHL 及 Fedex 等國際物流巨頭都在積極試驗 RFID 技術，期於將來大規模應用，以提升其物流能力；而其應用的過程包括：物流過程中的貨物追蹤、資訊自動採集、倉儲管理應用、港口應用、郵政包裹及快遞等。
- (2)零售：由 Wal-Mart 及 METRO 等大超市一手推動的 RFID 應用，可以為零售業帶來包括降低勞動力成本、商品可視度提高、降低因商品斷貨造成的損失及減少商品偷竊現象等等好處；其應用的內容包括：商品銷售資料的即時統計、補貨及防盜等。
- (3)製造業：應用於生產過程中相關資料的即時監控、品質追蹤及自動化生產等；而對於貴重及精密貨品生產的應用領域，更為迫切。
- (4)軍事方面：彈藥、槍支、物資、人員及卡車等識別與追蹤，如美國曾在伊拉克戰爭中已有大量使用，且目前美國國防部仍持續與其上萬供應商，正在對軍事物資進行電子標籤標識與識別。
- (5)服裝業：可以應用於服裝的自動化生產、倉儲管理、品牌管理、單品管理及通路管理等過程，隨著標籤價格的降低，這一領域將有很大的應用潛力；但是在應用時，必須得仔細考慮如何保護個人隱私的問題。
- (6)醫療：可以應用於醫院的醫療器械管理、病人身份識別、嬰兒防盜等領域。醫療行業對標籤的成本比較不敏感，所以該行業將是 RFID 應用的先鋒之一。
- (7)身份識別：RFID 由於本具備快速讀取與難以偽造的技術特性，適合被廣泛應用於個人的身份識別證件，如現在世界各國現在開展的電子護照專案、我國的第二代身份證、學生證等其他各種電子證件。
- (8)防偽：RFID 技術具有很難偽造的特性，但是如何應用於防偽還需要政府和企業的積極推廣。其可應用的領域包括：貴重物品（煙，酒，藥品）的防偽、票證的防偽等。
- (9)資產管理：各類資產（貴重的或數量相似性高的或危險品等）隨著標籤價格的降低，幾乎可以涉及到所有物品的應用。
- (10)交通：高速不停車、計程車管理、公車樞紐管理及鐵路機車識別等，已有不少較為成功的案例，其應用潛力大。
- (11)食品：水果、蔬菜、生鮮、食品等保鮮度等管理應用。由於食品、水果、蔬菜、生鮮上水份多，會影響正常的標籤識別，所以該領域的應用將在標籤的設計及應用模式上有所創新。
- (12)動物識別：如訓養動物、畜牧牲口、寵物等識別管理；另動物的疾病追蹤、畜牧牲口的個性化養殖等，也是可應用之範圍，而當前國際上已有不少較為成功的案例。
- (13)圖書館：書店、圖書館、出版社等應用。可以大大減少書籍的盤點及管理時間，可以實現自動租、借、還書等功能。在美國、歐洲、新加坡等已有圖書館應用成功案例；而目前在國內亦有圖書館正在測試中。

- (14)汽車製造相關：可以應用於汽車的自動化、個性化生產、汽車的防盜及汽車的定位，可以做為安全性極高的汽車鑰匙；目前國際上也有成功案例。
- (15)航空相關：可以應用於飛機的製造、飛機零部件的保養及品質追蹤；另旅客的機票、快速登機、旅客的包裹追蹤等，也是很大的應用領域。
- (16)其他：包含門禁、考勤、電子巡更、一卡通、消費、電子停車場等，在在皆然。

#### 產業關聯性

產品	上游	中游	下游
高頻及超高頻 RFID 標籤	1. PET 膜、電鍍用導電油墨、電鍍銅藥液 2. RFID 標籤 IC、ACP 導電膠 3. 紙張、離型紙、雙面膠	1. 高頻及超高頻 RFID 標籤天線 2. 高頻及超高頻 RFID Inlay 3. 高頻及超高頻 RFID 標籤，含貼紙、票卡、航空行李條	RFID 系統整合廠商
超高頻 RFID 讀取器	1. 超高頻 RFID 讀取器 IC 2. 電阻、電容、電感、IC、PCB 等電子零組件	1. 超高頻 RFID 讀取器模組 2. 超高頻 RFID 固定式讀取器 3. 超高頻 RFID 手持式讀取器	RFID 系統整合廠商
超高頻 RFID 遙控器	1. 超高頻 RFID 遙控器 IC 2. 電阻、電容、PCB、電池等電子零組件	超高頻 RFID 遙控器	家電產品製造商

### 3. 產品之各種發展趨勢

#### A. 精密機械產業

##### (1) Array 檢測量測設備 inline 智能化

隨著 TFT-LCD 面板朝尺寸大型化發展，由 5 代、5.5 代、6 代、7.5 代甚至 8 代玻璃基板，其尺寸已經超過 2 米長，基板的搬運變得越來越困難；另外由於大世代廠通常廠房面積也跟著放大，不同產線路程遙遠，因此檢測及量測設備，也都朝向 inline 智能化的改變趨勢。為因應此需求，設備必須提高自身的穩定性、速度、生產效率，藉以縮減搬運成本。並提供整合性平台技術，提高智能化品檢自動化程度，以及遠端遙控的功能，藉提升生產效率，降低生產成本。

##### (2) 設備本土化生產

隨著面板朝尺寸大型化發展，動輒長達十幾公尺的 TFT-LCD 面板設備，在國際運輸上已造成嚴重困擾，因此，設備已逐漸有本土化生產之趨勢。另外，政府為了加強策略性產業的競爭能力，亦積極推動設備本土化政策，預計至 2009 年所有的 TFT-LCD 面板設備的本土化目標為 60%，在檢測量測及修補設備方面，除了個別特殊的單一設備外，其他設備應可以 100% 本土化。

##### (3) 各面板廠商的設備需求差異化

TFT-LCD 面板產業的投資價值極大，各面板廠為了增加競爭力，除了降低材料成本外，最重要的工作，就是要快速提升生產製程的良率。然各面板廠由於技術傳承及發展經驗不同，亦各自發展出個別的快速提升製程良率的技術經驗，所以對於檢測、量測及修補設備的應用方式亦逐漸差異化。是故，設備業者必須能夠快速的滿足各面板廠商差異化的設備需求，才能獲取不同廠商的訂單。

## B. RFID 產業

### (1) 全球市場穩健成長

根據 ABI 調查報告，2007 年全球 RFID 市場規模達美金 38.7 億美元，將於 2012 年達 84.9 億美元，估計年複合成長率為 17%。未來 5 年 RFID 應用將以高頻(HF)的封閉式系統(close-loop system)為主，但高頻應用的年複合成長率為 35%，而超高頻(UHF)應用的年複合成長率高達 60%，其成長率穩定超越高頻的應用。

### (2) RFID 標籤單價持續下降

根據 ABI 調查報告，2008 年高頻 RFID 標籤平均單價為 1.29 美元，預估 2012 年將下降 27% 至 0.94 美元。而 2008 年被動式超高頻 RFID 標籤平均單價為 0.17 美元，預估 2012 年將下降至 0.09 美元，量大的訂單將可以獲得更低報價。對於標籤使用量大的 RFID 應用，超高頻 RFID 標籤無疑是最佳選擇。

### (3) RFID 導入範圍逐漸擴大

RFID 導入範圍逐漸擴大，由早期應用的『進出與存取』、『動物識別』與『車輛辨識』等領域，另隨著零售業、醫療及國防 Mandate 等需求增加、技術的改進及標準的訂定等帶動，逐漸跨入多樣領域範圍。

### (4) Mandates 帶動多元應用

大型零售業者包括 Wal-Mart 發出 Mandates，要求供應商在產品使用 RFID 標籤，帶動 RFID 供應鏈管理快速發展，2007 至 2012 年的年複合成長率為 33%，超高頻的品項更以 58% 爆發性成長。而這些 Mandates 同時也帶動 RFID 應用快速發展，包括 POS、即時定位系統及貨櫃追蹤等皆以 40% 的年複合成長率快速成長。

## 4. 競爭情形

### A. 精密機械產業

#### (1) 我國 LCD 設備業 SWOT 競爭分析

優勢 (Strength)	劣勢 (Weakness)
<p>A. 國內精密機械加工技術已累積多年，可快速切入 LCD 設備零組件加工製造。</p> <p>B. 國內製造成本較主要競爭者美國、日本及以色列低廉。</p> <p>C. 本土廠商具有維修服務速度快、溝通方便，可爭取國內市場商機。</p>	<p>A. 新客戶對於國產品信心不足。</p> <p>B. 原系統使用者，基於規避對新系統採用，所需額外耗費的時間及精力，是故較不願替換新的廠商。</p> <p>C. 對製程瞭解有限，難以深耕累積相關設備技術。</p> <p>D. 缺乏製程驗證能力及機會。</p>



<p>D. LCD設備驗證期間長，故形成市場寡佔，進入障礙高。</p> <p>E. 晶彩科技機台設備，已成功導入國內各大面板廠，擁有大量的實績及多年相關經驗與技術，目前已躍居業界領導地位。</p>	<p>E. 國內多為中小企業，研發經費較為不足。</p>
<p style="text-align: center;"><b>機會 (Opportunities)</b></p> <p>A. 國內LCD 面板廠商面臨成本競爭壓力，尤其是來自韓國廠商的壓力，故積極尋求設備本土化。</p> <p>B. 國內TFT-LCD製程設備市場需求逐年擴大，且政府積極推動LCD設備本土化政策，為產業帶來極大契機。</p> <p>C. 次代設備體積龐大，搬遷運輸不易，是故實有在本土組裝、測試之必要。</p>	<p style="text-align: center;"><b>威脅 (Threats)</b></p> <p>A. 國外設備商面臨被國內廠商取代的生存壓力，降價銷售打壓新開發廠商。</p> <p>B. 韓國設備業者快速崛起，且以低價積極搶單形成競爭對手。</p> <p>C. LCD 產業景氣循環快，設備需求量變化大，研究開發挑戰高。</p> <p>D. 由於2008年金融海嘯持續衝擊，台灣面板廠商紛紛減產，暫停機械設備投資。導致下游設備商出貨量大幅萎縮營收下跌，影響公司營運。</p>

資料來源：本公司整理。

## (2)LCD 設備商競爭情形

本公司為 TFT-LCD 檢測、量測及修補設備之專業廠商，各類產品主要競爭供應商如下表：

產品種類	產品名稱	主要功能及特色	技術層次	競爭廠商
TFT Array 檢測、量測、 修補設備	Inline 薄膜電晶體 自動光學檢測機	薄膜電晶體各道製 程的全面缺陷檢 測，解析度較低但 可以全面檢測	光學解析度 5um 或 10um，影像比對技 術，快速影像處理能 力(640MB/Sec)	以色列商 Orbotech
	Offline 薄膜電晶體 高解析度自動光學 檢測機	薄膜電晶體各道製 程的缺陷抽檢，解 析度較高且解測時 間長，故通常係採 用抽檢	光學解析度 1um ~5um，變焦鏡頭系 統，影像比對技術， 快速影像處理能力 (640MB/Sec)	以色列商 Orbotech
	突起物自動光學檢 測機	薄膜電晶體玻璃突 起物的檢測，以防 止玻璃上的突起物 將昂貴的光罩刮傷	由 2D 影像計算 3D 突起物的數學演算 法	韓商 SNU
	光罩自動光學檢測 機	光罩的缺陷檢測	光學解析度 3um，影 像比對技術，快速影 像處理能力 (640MB/Sec)	以色列商 Orbotech
	ADSI 自動線寬量 測機	薄膜電晶體各道製 程的線寬線距量測	影像尋邊技術，量測 模式的模組開發，機 台機密構造及防震 能力	日商 Hitachi Olympus
	膜厚、穿透率量測 機	薄膜電晶體各道製 程的膜厚及穿透率 量測	色度膜厚演算法、相 關量測光學元件的 設計，待測薄膜材料 的 nk 參數資料庫	美商 Nanometric 韓商 KMC
	高速缺陷複檢機	將自動光學檢測機 所檢測出的缺陷以 高解析	影像自動聚焦技 術、機台快速移動取 像能力、加上自動缺 陷判定的軟體能力	日商 Takano 由田新技
Color Filter 檢測、量測、 修補設備	突起物自動光學檢 測機	彩色濾光片玻璃突 起物的檢測，以防 止玻璃上的突起物 將昂貴的光罩刮傷	由 2D 影像計算 3D 突起物的數學演算 法	韓商 SNU
	彩色濾光片自動光 學檢測機	彩色濾光片各道製 程的缺陷檢測	光學解析度 10um ~20um，影像比對技 術	日商 Takano 德商 Basler 由田新技 東捷科技
	Digital Marco 自動 光學檢測機	彩色濾光片色不均 (Mura) 的缺陷檢 測	影像積分演算法、 影像比對技術、光學 取像雜訊改善技 術、光源雜訊降低技 術	日商 Technos 由田新技

產品種類	產品名稱	主要功能及特色	技術層次	競爭廠商
	CD/OL 量測機	彩色濾光片各道製程的線寬線距量測	影像尋邊技術，量測模式的模組開發，機台機密構造及防震能力	日商 Sokkia 美商 Zygo 東捷科技
	色度、膜厚、光學密度量測機	彩色濾光片 RGB 製程的色度量測，PS/MVA/OC/ITO 製程的膜厚度量測，BM 製程的光學密度量測	色度膜厚演算法、相關量測光學元件的設計	日商 Otuska 日商 Torray
	自動缺陷測高機	將自動光學檢測機所檢測出的缺陷以白光干涉測高	白光干涉測高技術	美商 Zygo 東捷科技
	雷射修補	以雷射技術將缺陷區之光阻直接打掉	雷射修補的雷射控制及使用技術，自動缺陷判定軟體技術	日商 V-Tech 日商 LaserTek 東捷科技
	光阻噴墨修補機	以噴墨技術將光阻修補回被雷射打掉的區域	噴墨頭控制及使用技術，自動缺陷判定軟體技術	日商 Takano 日商 V-Tech 日商 EPSON
	Miss Alignment 對位檢查機	檢查 TFT 面板與 CF 面板貼附的精度	影像演算法	日商 V-Tech 日商 Kubotech 宏瀨科技
TFT Cell 檢測、量測、修補設備	框膠自動光學檢測機	框膠的缺陷檢測	光學解析度 30um ~50um，影像尋邊技術，影像比對技術	日商 Kubotech 由田新技 宏瀨科技
	PI 自動光學檢測機	PI 的缺陷檢測	光學解析度 20um ~30um，影像比對技術	日商 Kubotech 由田新技 宏瀨科技
	自動光學切裂檢測機	切裂的缺陷檢測	光學解析度 20um (以前、新要求 -5um)，影像比對技術	日商 Kubotech 均豪科技 恆昌科技
	自動光學偏光膜偏貼檢測機	檢查偏光膜的貼附的精度	光學解析度 20um，影像比對技術	日商清河光學 宏瀨科技
	Particle Counter 粒子檢查機	檢查 TFT 面板與 CF 面板上的粒子，確認沒有過大的粒子影響面板之貼附	光學解析度 2um ~7um，影像比對技術	日商清河光學

資料來源：工研院專案計畫調查，本公司整理

本公司為國內極少數擁有全方位核心技術，能於 TFT-LCD 面板產業的檢測、量測及修補設備全面自主開發的設備製造廠商，目前已通過友達光電、奇美電子及中華映管的驗證及實際交機，且自 95 年起已獲得大量訂單，97 年度更是勇奪 G8.5 Array 段台灣市場佔有率第一名，漸漸開始全面取代外商，使國內面板業者更有競爭力。

## B. RFID 產業

### (1)我國 RFID 產業 SWOT 競爭分析

<p style="text-align: center;"><b>優勢 (Strength)</b></p> <p>A. 擁有特殊的PET膜電鍍銅軟板天線製造技術，可提供高品質、低成本的RFID天線；並將以此優勢與業界之領導廠商建立起OEM/ODM的合作關係。</p> <p>B. 自行開發覆晶封裝機台，除了可大幅降低機台的投資成本，增加標籤產品的競爭力外；另藉著自行機台開發的技術，以增加覆晶封裝的生產彈性，而突破標籤生產的障礙。</p> <p>C. 藉關係所開發具業界最大記憶容量的超高頻RFID標籤IC，其容量為市售產品的128倍，但價格極具競爭能力，是故將藉此產品以攻佔利基市場。</p> <p>D. 本公司係業界唯一可以提供RFID天線、Inlay、標籤生產，以及超高頻讀取器的供應商，可以提供全世界系統整合公司one-step shopping的服務，是故具有價格及技術服務之優勢。</p> <p>E. 推出超省電、無方向性、可穿越障礙的廣視角RFID遙控器，在Zigbee/ Bluetooth等無線遙控器技術中，最省電及最具競爭力的產品，將攻佔LCD-TV的遙控器市場。</p>	<p style="text-align: center;"><b>劣勢 (Weakness)</b></p> <p>A. 在RFID產業的知名度不足，需要時間累積才能建立遍及全世界的銷售網路。</p> <p>B. 使用量最大的小記憶容量的超高頻標籤IC仍需對外採購，是故標籤成本仍有一大部分取決於IC供應商。</p> <p>C. RFID遙控器的功能雖較紅外線強及省電，但紅外線遙控器市場已經成熟穩定價格很低，推展過程會有價格障礙。</p>
<p style="text-align: center;"><b>機會 (Opportunities)</b></p> <p>A. 目前RFID標籤市場爆發成長的關鍵，亦即使超高頻標籤成本降低至美金5分的目標，一直無法達成，所以任何可以降低成本的製程或方式，對於產業發展而言，皆為一重大突破及貢獻。本公司所提出新的RFID電鍍銅天線製程，將可大幅降低天線成本，進而獲取市場與客戶的認同，以創造雙贏機會。</p> <p>B. 過去幾年因技術障礙，超高頻RFID讀取器的價格一直居高不下，使得超高頻RFID應用的投資成本太高。現Intel(Impinj)推出R1000 Chipset將提供強大的超高頻RFID讀取器功能，而成本卻大幅下降，將使超高頻的應用更快速普及。</p> <p>C. 綠色環保為現階段用戶的重要訴求，利用RFID超省電功能所提供的RFID遙控器，可以終身免</p>	<p style="text-align: center;"><b>威脅 (Threats)</b></p> <p>A. PET膜電鍍銅天線製程若迅速被複製，將使得RFID天線的製造優勢消失，故該技術必須妥善保護。</p> <p>B. 隨者時間的推移，全世界將愈來愈多的廠商根據R1000 Chipset研發出超高頻的RFID讀取器，屆時超高頻的RFID讀取器將進入無利潤的紅海市場。</p> <p>C. Bluetooth技術聯盟亦針對家用產品的無線遙控器市場，重新定義一個省電的Bluetooth規格，希望進入家用產品的遙控器市場，將對本公司的高頻的RFID遙控器有技術威脅。</p>

換電池，符合環保精神，而且此遙控器是無方向性、可穿越障礙物之強大無線遙控器，是用戶遙控器的最佳選擇。	
--	--

資料來源：本公司整理。

## (2) RFID 供應商競爭情形

RFID 各類產品主要競爭供應商如下表：

產品種類	產品名稱	競爭廠商
RFID 標籤	RFID 標籤天線	以銅蝕刻製程或銀膠印刷天線的小型製造商
	RFID Inlay	Alien, UPM, Averydennsion, Symbol, AWID, 永道科技
	RFID 標籤成品	Alien, UPM, Averydennsion, Symbol, AWID, 永道科技 其他：採購 Inlay 做 Tag Converting 的小型廠商
RFID 讀取器	超高頻 RFID 讀取器模組	USA: Alien, AWID, Intermec, Skytek, ThingMagic, TWN: MTI, Unitech, Amostech China: Invengo, Sense
	超高頻 RFID 固定式讀取器	USA: Alien, Symbol, Impinj, AWID, Intermec, ThingMagic EU: Intellex TWN: MTI China: Invengo, Sense
	超高頻 RFID 手持式讀取器	USA: Alien, Symbol, Intermec TWN: MTI, Unitech China: Invengo
RFID 遙控器	超高頻 RFID 遙控器	Zigbee 技術: Radiopulse

本公司是 RFID 產業中少數具有 RFID 標籤、各種超高頻 RFID 讀取器產品的製造商，是全世界系統整合廠商 one-step shopping 的最好選擇。

## 5. 發展遠景之有利、不利因素與因應對策

### A. 精密機械產業

#### (1) 有利因素

##### a. 中國大陸 TFT-LCD 產業蓬勃發展

隨著 LCD-TV 需求的快速增加，以及在金融海嘯之後，中國大陸積極推動家電下鄉計畫救市策略，使中小尺寸面板需求量增長，擴大了內需的市場。然中國大陸 TFT-LCD 產業為應所需也快速的大幅擴充產能，京東方、彩虹集團分別於 2009 開始新廠評估，預定 2010 年設備開始 move in。是故，近三年中國大陸的 TFT LCD 產業都將處於成長的高峰期，公司將掌握此成長契機，即時擷取市場機會。

##### b. 產品已獲得客戶的認證

本公司於 92 年即投入 FPD 面板設備研發，產品範圍涵蓋檢測、量測及修補設備，這些設備經由長期的客戶驗證，皆已獲得台灣主要客戶(包含奇美、友達及華映等)的認證，

而厚植國內市場地位，目前為國內唯一產製 Array 段 AOI 設備及當前 In-Line AOI 設備實積最多的專業供應商，是故對於未來強攻大陸市場是非常有利的因素。

c. 擁有優良技術的研發團隊

本公司除擁有優良技術的研發團隊，已經整合來自物理、數學、機械、自動控制、光電、資訊各領域的人才與知識，核心技術的開發涵蓋 AOI 檢測、CD/OL 短吋量測、色度/膜厚/光學密度/面電阻量測、白光干涉測高等技術，在檢測量測領域領先其他同業，並可針對任一客戶客製化專業設備。

(2) 不利因素與因應對策

a. 在中國大陸沒有銷售實績，不利產品推廣

TFT-LCD 產業由於投資金額龐大，面板製造廠的工程師在業者無特殊政策的指示下，一般皆會以較高的費用採購過去已經採購的國外設備。而對於新品牌產品的選用，除須經長期的測試及認證，始能確保生產之毫無風險；此外，對於作業人員而言，需額外耗費較多的時間及精力，所以在一動不如一靜的使用慣性下，對於選擇新產品的使用，會有心理上的先天性障礙。

因應對策：

提供晶彩在台的實績列表予中國大陸客戶，其中包含所開發之各項優良技術、產品及各面板廠所建立的好口碑及獎項。藉此，以類似產品及客戶的新需求切入，並以積極的服務精神與良好的互動關係，讓客戶對公司的技術及服務具有信心，以縮短新產品推廣期間。

b. 銷貨客戶集中

由於國內 TFT-LCD 產業有大者恆大的趨勢，僅有少數業者有能力持續擴廠；然由於各廠商設備國產化政策的差異，導致短期銷貨客戶集中情形無法改善。

因應對策：

除持續拓展國內廠商商機外，晶彩將把握中國大陸對於面板產業發展的雄心，以積極爭取大陸市場設備需求訂單，使業務範圍擴展，而降低對單一客戶銷售的風險；另將以自動光學檢測技術為基礎，開發太陽能電池檢測設備及半導體測試設備，並增設 RFID 事業部，跨足不同產業，以降低對單一產業銷售風險。

c. 客戶的收款期長，不利公司之資金有效運用

TFT-LCD 設備業一般按交機及驗收完成收款，而驗收時間有時長達一年以上，由於本公司目前資本規模尚小，故於營收快速成長的過程中，對於大量營運資金的需求及調度，應審慎規劃。

因應對策：

不斷藉提升產品品質、服務品質及裝機效率等方式，以縮短收款時間，另持續保持與金融業界的關係，以適時補充資金的需求。

## B. RFID 產業

### (1) 有利因素

#### a. 全球 RFID 產業持續穩健成長

全球 RFID 市場規模穩健成長，預期超高頻(UHF)應用的年複合成長率將高達 60%，而本公司的產品即主要布局超高頻應用，將可以隨著市場的成長而發展。

#### b. Mandates 帶動多元應用

大型零售業者包括 Wal-Mart 發出的 Mandates，帶動 RFID 供應鏈管理快速發展，2007 至 012 年的年複合成長率為 33%，其中超高頻的品項更以 58% 爆發性成長。而這些 Mandates 同時也帶動 RFID 應用快速發展，使得 RFID 導入的範圍逐漸擴大，將為產業帶來無限商機。

#### c. 政府推動關鍵技術概念驗證

政府自近 2006 年成立『RFID 推動辦公室』，協助公部門推動 RFID 應用，並協助經濟部草擬『RFID 推動方案』，各部會期後成立超過 20 個部門先導應用計畫，並逐年皆有新興計畫成立，其中包括『居家與民眾安全』、『食品流通安全』、『健康與醫療應用』、『航空旅運應用』、『貿易通道安全』等五大公共領用應用，未來 RFID 公領域應用將根據先導計畫成果朝向整合與擴散。

### (2) 不利因素與因應對策

#### a. 標籤生產的設備成本高昂

目前標籤生產的瓶頸是覆晶封裝製程，由於 RFID IC 是一個個打到天線上，所以 IC 封裝對於位置精密度的要求極高，而現行產製所需的設備不但價格高昂，且生產速度很慢；而因覆晶封裝設備佔整體標籤生產的支出比例極大，所以僅就設備折舊的攤提，就使的標籤製造的成本難以下降。

因應對策：

本公司將以現行種種設備開發的技術，以自行開發覆晶封裝設備，而降低整體的標籤生產設備成本。

#### b. 標籤 IC 成本仍然居高不下

若以市場的標籤目標價格 5 美分而言，光是以現行超高頻 RFID 標籤 IC 成本就高於此一標準，故對於促進 RFID 產業快速發展的期望，在技術上又形成一大障礙。

因應對策：

本公司將透過關係企業 IC 開發的技術，以開發功率高、價格低廉的超高頻 RFID 標籤 IC，以降低標籤的成本。

### (三)技術及研發概況

#### 1.最近年度及截至年報刊印日止投入之研發費用

單位：新台幣仟元

項目	97 年度	98 年 03 月 31
研發費用	121,888	15,329

#### 2.開發成功之技術與產品

年度	產業區分	項目
93	精密機械產業	<b>素玻璃自動光學檢測機</b> 適用於TFT-LCD薄膜電晶體廠及彩色濾光片廠，製程的進料檢驗，以確保投入產線的素玻璃的品質係符合生產線之標準。
		<b>彩色濾光片突起物自動光學檢測機</b> 檢測彩色濾光片之突起物，以防止玻璃上的突起物將光罩刮傷。
		<b>彩色濾光片Digital Marco自動光學檢測機</b> 檢測彩色濾光片Digital Marco之色不均巨觀缺陷。
		<b>彩色濾光片CD/OL量測機</b> 量測彩色濾光片各製程含BM/R/G/B/PS/MVA等層之Critical Dimension、Overlay。
		<b>彩色濾光片自動光學檢測機</b> 適用於TFT-LCD彩色濾光片廠，BM/R/G/B/PS/MVA等製程之缺陷，Pattern偏移、Pattern Missing、粒子、破洞。
		<b>高速缺陷複檢機</b> 針對自動光學檢測機檢測出之缺陷，以高解析度之彩色相機快速的取像供人工或電腦自動複檢，以判別該缺陷之嚴重程度。該機台目前是TFT-LCD產業複檢速度最快的設備，可以大幅提昇檢測效率。
		<b>Digital Marco自動光學檢測機鈉燈驅動器</b> 自行開發Digital Marco自動光學檢測機之鈉燈光源驅動器關鍵零件，光源之亮度變動率為1/1000以下，較日製之鈉燈光源之亮度變動率1/100較佳10倍，以確保光源的穩定性，不會因光源閃爍而造成誤檢。



年度	產業區分	項目
94	精密機械產業	<p><b>薄膜電晶體低解析度自動光學檢測機</b> 台灣首部開發成功之Inline薄膜電晶體高自動光學檢測機，使用在薄膜電晶體製程之檢測，檢測一片5代玻璃的Tact Time為20秒，符合Inline全檢之目標。</p> <p><b>ADSI自動線寬量測機</b> 量測薄膜電晶體製程之線寬，蝕刻前後之線寬變化。</p> <p><b>250W複金屬燈燈箱</b> 目前自動光學檢測機台的250W檢測光源燈箱皆自日本採購，其成本高昂且仍有低頻雜訊，對自動光學檢測機台的競爭力影響甚鉅，故自行開發此250W複金屬燈檢測光源，以增加設備競爭力。</p> <p><b>色度、膜厚、光學密度量測機</b> 量測彩色濾光片BM層之光學密度、R/G/B層之色度、PS/MVA/ITO層之膜厚。</p> <p><b>面電阻量測機</b> 量測彩色濾光片ITO層之面電阻，檢測ITO之鍍膜之面電阻是否符合製程條件。</p>
95	精密機械產業	<p><b>7.5代廠薄膜電晶體高解析度自動光學檢測機</b> 榮獲「經濟部工業局九十四年度主導性新產品開發計畫」補助，已有具體研發成果。該機型為全台首創，已獲TFT-LCD之薄膜電晶體廠商下單，進入量產階段，且持續進行精進研發及市場開拓。</p> <p><b>光罩自動光學檢測機</b> 檢測光罩之缺陷，包括光罩之Pattern缺陷、刮傷、異物、粒子沾附等缺陷。</p> <p><b>Burr Check 切裂自動光學檢測機</b> TFT-LCD組立廠後段，切裂後的光學檢測機，檢測切裂之毛邊、Chipping、Broken等缺陷。</p>

年度	產業區分	項目
		<p><b>150W複金屬燈燈箱</b>            一般自動光學檢測機台的250W檢測光源，由於燈泡昂貴及2000小時的使用壽命，故面板製造廠的營運成本高。150W複金屬燈檢測光源燈箱的燈泡使用壽命高達6000小時，且單價較低，開發此一關鍵零組件，預計可為面板製造廠節省80%以上的營運成本。</p>
96	精密機械產業	<p><b>彩色濾光片自動雷射修補機</b>            適用於TFT-LCD彩色濾光片廠，針對自動光學檢測機檢測出之缺陷，以高解析度之彩色相機快速的取像供人工或電腦自動複檢，以ADJ軟體判別該缺陷之嚴重程度，然後自動控制雷射的Shutter大小將缺陷全自動修補，可以大幅加速雷射修補的效率，提昇TFT廠的生產效能。</p> <p><b>5W LED燈檢測光源</b>            一般自動光學檢測機台的複金屬燈檢測光源，由於複金屬燈泡昂貴及使用壽命短，故面板製造廠的營運成本高。本公司針對TFT Array面板開發出LED燈檢測光源，此一關鍵零組件其使用壽命高達30,000小時，預計可為面板製造廠節省大幅營運成本。</p> <p><b>太陽能電池IQC晶片分選機</b>            適用於太陽能電池廠的IQC進料檢驗應用，可以檢測晶片的厚度、面電阻值、P/N型態、電子壽命(Carrier Life Time)等參數，再根據這些參數的組合將晶片分成不同等級。</p> <p><b>太陽能電池OQC晶片分選機</b>            適用於太陽能電池廠的OQC出料檢驗應用，可以太陽能電池成品的顏色及發電效率，再根據這些參數的組合將成品分成不同等級。</p>
97	精密機械產業	<p><b>電子紙光學檢測及灰階分佈量測機</b>            適用於電子紙光學檢測，針對自動光學檢測機檢測出之缺陷，並且量測出start value 灰階分佈做為客戶OQC檢驗標準。</p>

年度	產業區分	項目
		<p><b>36W LED燈檢測光源</b>            一般自動光學檢測機台的複金屬燈檢測光源，由於複金屬燈泡昂貴及使用壽命短，故面板製造廠的營運成本高。本公司針對TFT Array面板開發出LED燈檢測光源，此一關鍵零組件其使用壽命高達30,000小時，預計可為面板製造廠節省大幅營運成本。</p> <p><b>8.5代廠薄膜電晶體In-line高解析度自動光學檢測機</b>            台灣首部開發成功之薄膜電晶體In-line高自動光學檢測機，使用在薄膜電晶體製程之檢測，符合Inline全檢之目標。該機型為全台首創，已獲TFT-LCD之薄膜電晶體廠商下單量產，進入裝機及生產階段，且持續進行精進研發及市場開拓。</p> <p><b>8.5代廠薄膜電晶體Off-line高解析度自動光學檢測機</b>            台灣首部開發成功之薄膜電晶體Off-line高自動光學檢測機，使用在薄膜電晶體製程之檢測，符合Off-line檢測之目標。該機型為全台首創，已獲TFT-LCD之薄膜電晶體廠商下單量產，進入裝機及生產階段，且持續進行精進研發及市場開拓。</p>
	RFID產業	<p><b>RFID標籤天線電鍍銅製程</b>            利用電鍍方式將銅電鍍到PET膜上的天線Pattern，形成高頻或超高頻的標籤天線，此製程較一般的銅蝕刻製程節省50%以上的成本，且產品的品質相同，係本公司所研發的業界最具競爭力的標籤天線製程。</p> <p><b>雙天線超高頻RFID讀取器模組</b>            利用Impinj R1000 RFID Reader Chipset開發的符合EPC C1 Gen2 規範的雙天線超高頻RFID讀取器模組，可以讀寫被動式超高頻RFID標籤的距離達10米，為目前國際通用的超高頻RFID規格。</p> <p><b>超高頻RFID遙控器模組初步樣品</b>            利用超高頻RFID技術所開發的遙控器核心，可以提供無方向性、高達15米遠距離的遙控需求，目標是取代一般的家用電器的紅外線遙控器。</p>

#### (四)長、短期業務發展計劃

##### 1.短期業務發展計劃：

###### A.行銷策略

機密機械產業：

- a.以高效能及合理價位產品迎合客戶需求，積極擴展市場。
- b.持續加強產品品質與售後服務之效率，以鞏固現有顧客。
- c.結合大陸設備代理商，深耕大陸市場，拓展新業務。

RFID產業：

- a.參加國內外的RFID專業展覽，讓世界各國的系統整合公司(System Integrator)了解本公司在RFID產業所提供的服務及產品，逐步建立全球合作關係。
- b.超高頻RFID遙控器將以較高單價的家電產品 LCD-TV製造商為主要市場，以全面取代該領域目前所使用的紅外線遙控器。

###### B.產品策略

機密機械產業：

- a.整合檢測、量測及維修機台，成為多功能設備，並將客製化產品，轉型為量產產品；除可節省Fab的空間及營運成本外，並可簡化產品之生產規劃。
- b.善用本公司的機台整合能力，整合本公司尚未具備核心技術，發展符合客戶製程所需的機台。

RFID產業：

- a.利用電鍍銅天線製程的高品質及低成本優勢，以大幅降低RFID天線/Inlay/標籤產品的最終成本，同時建立起本公司在標籤產品的優勢。
- b.超高頻RFID遙控器將設計為終身免換電池的超省電、超薄型的無線遙控器，同時將配合各LCD-TV製造商的需求做成不同的模組，以擴大市場佔有率。

###### C.生產策略

機密機械產業：

- a.持持續推動技術的升級，以提升製造效率，確實掌握各零組件交期使完全符合客戶要求。
- b.推動關鍵零組件國產化，以降低成本及縮短交期，增加產品競爭力。

RFID產業：

- a.掌握RFID標籤生產的量產設備，以持續低成本優勢；另利用本公司自行開發的電鍍銅製程，以降低天線成本。
- b.超高頻RFID遙控器模組係以FR-1材料的硬式PCB生產，將規劃以外包生產，以提昇全方位的產製效率。

###### D.經營管理

- a.落實各專案之管理，利用ERP系統，從接單、生產、出貨、會計、財務等作業流程

電腦化，以提高營運績效。

b.加強各項分析管理報表功能，提供管理階層及時性、正確性的數據分析，協助其經營管理。

c.訂定公司未來營運方向及經營目標，配合員工獎勵方案激勵同仁實踐目標。

## 2.長期業務發展計劃：

### A.行銷策略

機密機械產業：

a.利用本公司的優良的技術，為客戶打造符合其製程所需之要求，並提供TFT-LCD業者於設備方面各項解決方案。

b.增加產品及服務項目，甚而擴展至現有其他廠牌設備之效率提升及顧問服務，以全方位解決客戶現有機台的服務問題及增加客戶的忠誠度。

c.結合大陸設備代理商，深耕大陸市場，必要時將考慮設立大陸分公司，就近服務客戶，以利拓展新業務。

RFID產業：

a.提供極有競爭力的超高頻RFID讀取器解決方案給系統整合公司，以降低超高頻RFID解決方案的整體投資成本，讓 EPC C1 Gen2 的低超高頻RFID技術更快普及，進而帶動整體超高頻RFID標籤的使用量。

b.將超高頻RFID遙控器的應用，進一步擴充到其他需使用無線遙控需求的地方，尤其是提供加減密的傳輸功能，以提供高安全等級的控制需求。

### B.產品策略

機密機械產業：

a.擴大與國內外學術機構、技術單位合作，以發展多元化的技術，並增加產品種類。

b.逐步開發關鍵零組件，以降低成本及增加競爭優勢。

c.整合本公司的自動缺陷判別軟體，將檢測機台、量測機台及修補機台整合為自動化作業，達到無人化工廠的目標，以提昇面板廠效率及降低面板製造成本。

RFID產業：

a.充實超高頻RFID讀取器的產品線，包括讀取器模組、固定式讀取器以及手持式讀取器，以提供客戶高頻RFID讀取器One-Stop Shopping的服務。

b.充實超高頻RFID遙控器的產品線，包括遙控器傳輸的加減密安全功能、雙向傳輸的功能等。

### C.生產策略

機密機械產業：

a.加強投入生產技術研究，進而提高產品及服務品質。

b.與供應商建立夥伴關係，輔導策略性供應商提升技術能力及品管能力，提高零組件之品質、增進生產效率及降低成本。

RFID產業：

- a. 標籤生產的瓶頸為覆晶封裝製程，其設備精密度要求高、生產數度慢，且設備價格高昂，故本公司將規劃自行開發覆晶封裝設備，以降低標籤生產的瓶頸及設備投資，以增加長期競爭力。
- b. 超高頻RFID遙控器模組，將規劃以目前RFID天線的軟板製程取代，以大幅降低FR-1硬式PCB的成本，增加高頻RFID遙控器模組的競爭力。

D. 經營管理

- a. 強化員工訓練，積極培養優秀人才，建立優良的企業文化。
- b. 利用資本市場特點，以因應公司長期發展。

## 二、市場及產銷概況

### (一) 市場分析

#### 1. 主要商品(服務)之銷售(提供)地區

##### A. 精密機械產業

單位：新台幣仟元

年 度	97 年度		96 年度	
	銷 售 地 區	營收金額	比重(%)	營收金額
內 銷	1,334,130	100.00	825,513	100.00
合 計	1,334,130	100.00	825,513	100.00

##### B. RFID 產業

本公司 RFID 相關產品係於 98 年開始進入小量出貨階段，故過往尚無重大銷售狀況。

#### 2. 市場占有率

##### A. 精密機械產業：

- a. 隨著面板尺寸朝大型化發展，致使運送風險及成本提高，TFT-LCD設備國產化已是必然趨勢，且近來中國大陸面板廠也紛紛宣佈各世代廠擴建計劃下，是故，在在將可望帶動國內TFT-LCD產業相關設備需求成長。
- b. 隨著本公司日益精良的技術開發及成品發展，目前於國內8.5代廠Array段檢測設備的市占率，已高達80%以上。

B. RFID產業：本公司RFID相關產品係於98年開始進入小量出貨階段，故不適用市場佔有率計算。

#### 3. 市場未來之供需狀況與成長性

##### A. 精密機械產業：

DisplaySearch近期發表TFT LCD供給與需求季報告指出，2008年全球TFT LCD設備資本支出將創歷史新高，估計超過130億美元；然由於面板價格的快速下跌、產能利用率的偏低及全球經濟持續低迷等因素，導致原訂的擴廠計劃紛紛遞延，預期2009年全球TFT LCD設備資本支出將下降至100.6億美元水準，較2008年下滑21%。

展望2009年，金融海嘯雖仍持續席捲全球，各面板業者對資本支出政策，仍持保守的態度；但由於近來的大陸家電下鄉急單效應，持續發揮效用，加上各國政府不遺

餘力的振興景氣措施，使得急單效應轉化為短單效應，故在台灣業界普遍似都認為景氣的低點已過，進而有賴未來景氣一步步持續的復甦。而國內面板大廠也同樣有此現象，所以近來其庫存也逐漸去化，產能利用率也普遍提升，面板價格也止穩回升，進而對第二季的銷售情況，都有看多的預期。所以隨著景氣的逐漸復甦，產能的逐漸成長，市場估計到了2009年中需求與供給將逐漸達到平衡，到時又會開始刺激面板廠進行下一波擴產計劃，並進而提高2010年資本支出規模。

#### B. RFID 產業

RFID的應用，從大型零售業者Wal-Mart發佈Mandates，要求其供應商在進貨時貼附符合EPC C1 Gen2 規範的超高頻RFID標籤，此舉，直接加速了RFID產品的應用需求，促進了RFID產業的成長，預估 2007至2012年的年複合成長率為33%，而其中超高頻的品項，更以58%爆發性成長為甚。所以，目前RFID應用導入的範圍逐漸擴大，將為產業帶來無限新的商機。

根據 ABI調查報告，全球RFID市場規模將由2007年約38.7億美元成長到2012年的84.9億美元的水平，預估年複合成長率為17%，其中高頻應用的年複合成長率為35%，而超高頻(UHF)應用的年複合成長率高達60%；至於標籤的價格方面，高頻RFID標籤平均單價將由2008年為1.29美元下降至2012年的0.94美元，被動式超高頻RFID標籤平均單價將由2008年的0.17美元，下降至2012年的0.09美元。

故整體而言，RFID產業正處於持續穩健成長中，是一個很有發展潛力的市場。

#### 4. 競爭利基

本公司自成立以來即不斷致力於研發技能的開發，初期以24位元全彩影像技術為核心，進而開發諸如彩色圖像識別演算法、光學取像技術、照明系統、精密機械設計、光機電控制整合、數位影像處理電路等相關技術，並為客戶提供全彩、高解析度、精確、快速且完全量身訂做的檢測機，目前所開發的產品，皆已經過國內面板大廠的認證與肯定，是故對於未來在大陸市場會有很好的參照價值。

另為避免產業集中，擴大經營範圍，晶彩自2008年起也積極投入RFID標籤製程的研發，目前所開發之軟性PET膜電鍍銅的技術，能以節省成本50%之目標，生產出與目前超高頻及高頻銅蝕刻天線相同的效能；另外，本公司也投入RFID讀取器、遙控器相關產品的研發，以提供完整的RFID產品線。茲就本公司之競爭利基分析如下：

##### A. 人才

本公司擁有整合來自物理、數學、機械、自動控制、光電、資訊等各領域的人才與堅強的研發團隊，除可持續創新、改良各相關領域技能，亦可滿足客戶開發的需求，所以，目前技術的開發業已領先其他國內競爭廠商。

另外管理人才方面，本公司均積極提供員工專業的教育訓練，增進各職位所需之專業知識，以面對不斷進步變遷的大環境，達到理論與實際結合應用的目標。而這些專業的人才，正是公司不斷開創新產品的原動力，並和公司之發展一起與時俱進。

##### B. 技術

精密機械產業：

在檢測設備開發的領域上，本公司除影像辨識的核心技術領先同業外，在光學系統的設計亦以突破薄膜電晶體高解析檢測設備所需的變焦光學設計，是國內唯一通過高解析薄膜電晶體檢測設備的公司；另在量測設備的開發領域上，經由多年的努力，本公司已完全具備量測設備開發的核心技術，包括 CD/OL 量測、色度/膜厚/光學密度/面電阻量測、白光干涉測高等技術，此為國內業界少數具有完整核心技術的公司。

RFID 產業：

在 RFID 標籤的製造技術，本公司除了開發革命性的 PET 膜軟板電鍍銅技術領先同業外，亦充分利用本公司即時檢測的高速運算技術，以投入覆晶封裝設備的開發，此將可以克服覆晶封裝的生產瓶頸及高單價設備投資的障礙，進一步藉以降低標籤製造的成本；在超高頻 RFID 的讀取器方面，本公司已經成功利用 Impinj R1000 Chipset 開發出符合 EPC C1 Gen2 的超高頻 RFID 讀取器模組，係國內少數具有此超高頻 RFID 讀取器開發能力的廠商。

### C. 產品

精密機械產業：

本公司經由過去五年技術經驗的累積，檢測、量測相關產品線業已完整，主要涵蓋薄膜電晶體廠、彩色濾光片廠及面板組裝廠，此諸多產品皆已經過國內 TFT-LCD 面板大廠的認證與肯定，銷售實績也日益成長，並成為台灣 2008 年度 G8.5 Array 段檢測設備市場占有率第一的專業廠商。

RFID 產業：

在 RFID 標籤產品方面，本公司採用 NXP 的標籤 IC 提供適用於紙箱/棧板/玻璃/金屬環境長/中/短距離的各式超高頻及高頻標籤，可以滿足客戶各種需求；另在高單價超高頻 RFID 讀取器方面，本公司提供依 Impinj R1000 Chipset 開發出符合 EPC C1 Gen2 的超高頻 RFID 讀取器模組，同時將近一步利用該模組開發為八天線的固定式超高頻 RFID 讀取器，以及單天線的手持式超高頻 RFID 讀取器，以降低全世界系統整合公司在推展超高頻 RFID 應用的初期投資門檻，以快速普及超高頻 RFID 的技術。

### D. 價格

精密機械產業：

本公司針對設備開發所需要的主要核心技術均自行開發，故較其他廠商有競爭力；且主要的關鍵零組件，如昂貴的檢測光源，本公司亦自行開發以降低成本，而由於目前本公司產品之量產已達規模經濟，更可有效降低生產成本，故本公司可以提供比國外設備商更有價格競爭力的檢測、量測、修補設備，嘉惠國內 TFT-LCD 面板製造廠商。

RFID 產業：

在 RFID 標籤產品方面，由於本公司的標籤天線製造成本，較現有其他製程產品低 50% 以上，且主製程設備可自行生產，故整體標籤競爭力十足；而在超高頻 RFID



讀取器方面，由於該產品是利用 R1000 Chipset 所開發，其功能不但強大，且較傳統自行以離散式 IC 所設計的成本低很多，所以讀取器的成本亦很有競爭力。是故，本公司將以較低價的方式與全世界的系統整合廠商建立合作關係，以順利取得其後續長期耗材性的標籤訂單。

#### E.服務

精密機械產業：

TFT-LCD 設備本土化最大的優點為本土化廠商可以提供非常即時性的產品研發、設計、整合及客戶服務，本公司即憑藉此優勢逐漸擊敗國外諸多設備對手，為公司在市場競爭力上再加一分。

RFID 產業：

在 RFID 產品服務上，本公司將以標籤天線及讀取器天線的設計能力，提供各式設計服務以滿足不同應用環境的需求，降低系統整合公司的技術障礙，與這些 RFID 的應用推動者建立長期的夥伴關係。

### (二)主要產品之重要用途及產製過程

#### 1.主要產品之重要用途

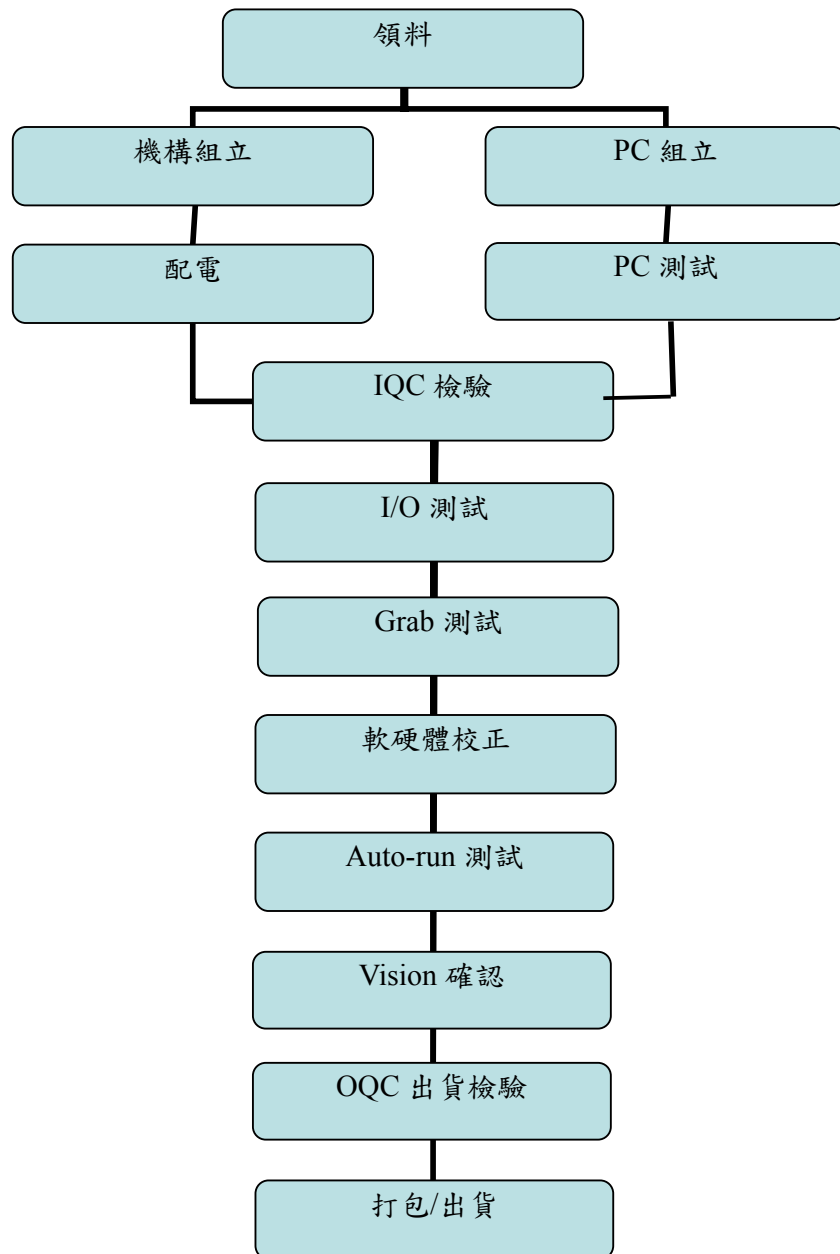
產業區分	產品種類	產品名稱	主要用途
精密機械產業	TFT Array 檢測、量測、修補設備	薄膜電晶體低解析度自動光學檢測機	薄膜電晶體各道製程的全面瑕疵檢測，解析度較低但可以全面檢測。
		薄膜電晶體高解析度自動光學檢測機	薄膜電晶體各道製程的瑕疵抽檢，解析度較高且解測時間長，故通常係採用抽檢。
		素玻璃自動光學檢測機	素玻璃的瑕疵檢測。
		突起物自動光學檢測機	薄膜電晶體玻璃突起物的檢測，以防止玻璃上的突起物將昂貴的光罩刮傷。
		光罩自動光學檢測機	光罩的瑕疵檢測。
		ADSI自動線寬量測機	薄膜電晶體各道製程的線寬線距量測。
		膜厚量測機	薄膜電晶體各道製程的膜厚量測。
	Color Filter 檢測、量測、修補設備	彩色濾光片自動光學檢測機	彩色濾光片的瑕疵檢測。
		高速缺陷複檢機	將自動光學檢測機所檢測出的瑕疵以高解析度相機拍攝供人員或電腦對缺陷重新複檢。
		突起物自動光學檢測機	彩色濾光片玻璃突起物的檢測，以防止玻璃上的突起物將昂貴的光罩刮傷。
		Digital Marco自動光學檢測機	色不均(Mura) 的瑕疵檢測。

產業區分	產品種類	產品名稱	主要用途
		CD/OL量測機	彩色濾光片各道製程的線寬線距量測。
		色度、膜厚、光學密度量測機	彩色濾光片 RGB製程的色度量測，PS/MVA/OC/ITO製程的膜厚度量測，BM製程的光學密度量測。
	TFT Cell 檢 測、量測、修補 設備	PI 自動光學檢測機	PI的瑕疵檢測。
		Seal 框膠自動光學檢測機	框膠的瑕疵檢測。
		Burr Check 切裂自動光學檢測機	切裂的瑕疵檢測。
		Particle Counter 粒子檢查機	粒子檢查。
	RFID產業	高頻及超高頻 RFID 標籤	高頻及超高頻RFID標籤天線
高頻及超高頻RFID Inlay (天線+RFID Chip)			將RFID IC (Chip)直接以覆晶封裝的技術貼附在RFID天線上，形成RFID Inlay的標籤半成品，是最符合經濟的標籤量產技術。
高頻及超高頻RFID標籤成品 (貼紙、票卡、航空行李條)			RFID標籤最終產品型態，概包括貼紙、票卡、航空行李條等。
超高頻RFID 讀取器		EPC C1 Gen2 超高頻RFID讀取器模組	超高頻RFID讀取器的功能是讀寫標籤上的資訊，一般讀取距離在無電池的被動式超高頻RFID標籤的應用可達10米；目前國際通用的規格為 EPC C1 Gen2，此讀取器模組為雙天線設計，為用戶可以選用的讀取器入門機種。
		EPC C1 Gen2 超高頻RFID固定式讀取器	超高頻RFID固定式讀取器為八天線設計，內含Intel ATOM CPU，可以執行用戶的應用程式，為用戶可以選用的讀取器高階機種。
		EPC C1 Gen2 超高頻RFID手持式讀取器	在移動式的超高頻RFID讀寫需求上，一般皆選用此單天線的手持式讀取器。

產業區分	產品種類	產品名稱	主要用途
	超高頻RFID 遙控器	超高頻 RFID 遙控器模組	超高頻RFID 遙控器模組係利用RFID技術所開發的遙控器核心,可以提供無方向性、高達15米遠距離的遙控需求,目標是取代一般的家用電器的紅外線遙控器。
		52-Key TV用超高頻RFID遙控器	此52-Key超高頻RFID遙控器針對TV的遙控需求所設計的超低耗電,免換電池的超薄型無線遙控器。

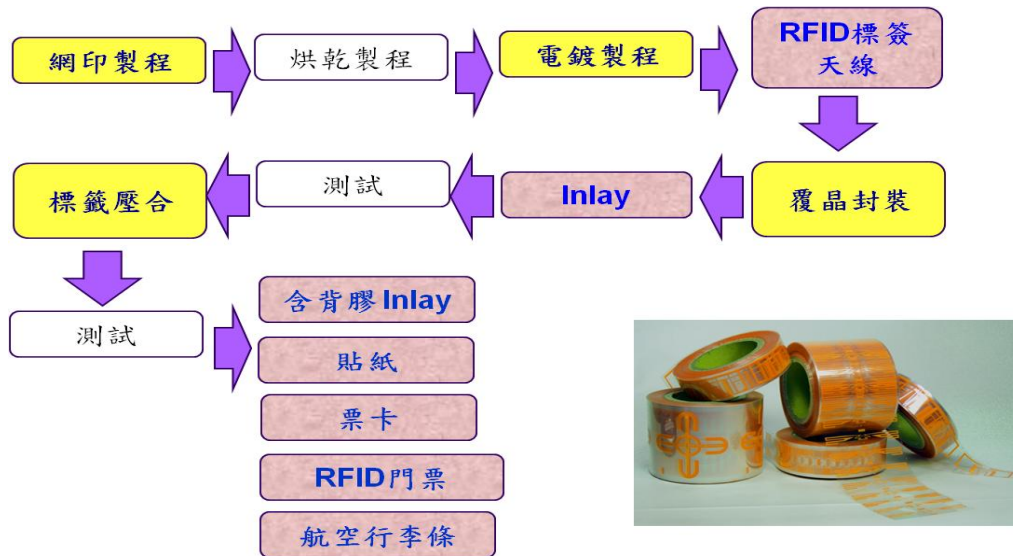
## 2. 主要產品之產製過程

### A. 精密機械產業



## B.RFID 產業

1. RFID 標籤的生產流程如下：



2. 超高頻 RFID 讀取器的生產流程如下：



3. 超高頻 RFID 遙控器的生產流程如下：



### (三)主要原料之供應狀況

原料名稱	供應情形
相機	良好
線性馬達	良好
工業電腦	良好
光纖管	良好
平台	良好

(四)最近二年度任一年度中曾占進(銷)貨總額百分之十以上之客戶名稱及進(銷)貨金額與比例

1.主要進貨供應商情形

單位：新台幣仟元

年度	97年				96年				
	項目	名稱	金額	占進貨淨額比率〔%〕	與發行人之關係	名稱	金額	占進貨淨額比率〔%〕	與發行人之關係
1		泰洛	151,820	15.96%	無	新亞洲	48,460	9.44%	無
2		東元	62,994	6.62%	無	泰洛	40,810	6.06%	無
		其他	736,199	77.42%	無	其他	423,847	84.50%	無
			951,013	100.00%		合計	513,117	100.00%	

2.主要銷貨客戶情形

單位：新台幣仟元

年度	97年				96年				
	項目	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率〔%〕	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率〔%〕	與發行人之關係
1		奇美	1,041,950	78.10%	無	奇美	801,549	97.10%	無
		其他	292,180	21.90%	無	其他	23,964	2.90%	無
		合計	1,334,130	100.00%		合計	825,513	100.00%	

## (五)最近二年度生產量值表\*

單位：個；新台幣仟元

生產 量值 主要商品	年度	97 年度			96 年度		
		產能	產量	產值	產能	產量	產值
TFT-LCD 面板 及彩色濾光片 自動光學檢測 機		-	94	836,599	-	79	488,241
其他		-	-	310	-	-	16,569
合計		-	94	836,909	-	79	504,810

註：本公司係屬 TFT-LCD 面板及彩色濾光片自動光學檢測機之研發設計、製造與銷售公司，除少數之加工機器及研發電腦設備外，係投入人力組裝，故不適用計算設備之產能利用率。

## (六)最近二年度銷售量值表

單位：個；新台幣仟元

銷售 量值 主要商品	年度	97 年度				96 年度			
		內 銷		外 銷		內 銷		外 銷	
		量	值	量	值	量	值	量	值
TFT-LCD 面 板及彩色濾 光片自動光 學檢測機		94	1,329,750	-	-	79	799,140	-	-
其他		-	4,380	-	-	-	26,373	-	-
合計		94	1,334,130	-	-	79	825,513	-	-

## 三、從業員工

年度		97 年度	96 年度	98 年度 (截至 98/03/31)
員 工 人 數	生產人員	112	79	87
	管理人員	40	37	34
	研發人員	60	57	55
	合計	212	173	176
平均年歲		30	30	30
平均服務年資		2.5	2	2.5
學 歷 分 布 比 率 (%)	博士	-	-	-
	碩士	17%	13%	18%
	大專	83%	87%	82%
	高中	-	-	-
	高中以下	-	-	-

#### 四、環保支出資訊

- 1.依法令規定，應申領污染設施設置許可證或污染排放許可證或應繳納污染防治費用或應設立環保專責單位人員者，其申領、繳納或設立情形之說明：本公司為專業光學檢測設備製造商，法令並無規定需申請污染設施設置許可證、污染排放許可證或應繳納污染防治費用或應設立環保專責單位人員。
- 2.有關防治污染設備主要設備之投資及其用途與可能產生之效益：本公司主要產品為自動化光學檢測設備，在產品之製程過程中並無環境污染之情形發生，故不適用。
- 3.最近年度及截至年報刊印日止，公司改善環境污染之經過，其有污染糾紛事件者，應說明其處理經過：本公司成立至今，僅於94年9月因搬遷新廠，負責新廠裝潢之室內設計公司，不慎將廢棄物倒置於廠房外面之排水溝，遭新竹縣環境保護局依違反廢棄物清理法第27條第二款規定，於94年9月26日依同法第50條第三款處新台幣三仟元之罰鍰。本公司除責令包商迅速清除相關廢棄物，並要求其他工程單位妥善處理廢棄物等環安問題；同時公司行政單位日後處理相關工程時，應約定或提醒包商或工程單位確實做好環保及工安措施，以釐清相關權責，並善盡社會責任。
- 4.最近年度及截至年報刊印日止，公司因污染環境所受損失(包括賠償)，處分之總額，並揭露其未來因應對策(包括改善措施)及可能之支出(包括未採取因應對策可能發生損失、處分及賠償之估計金額，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實)：本公司成立至今，僅因前述之情形遭新竹縣環保局因違反廢棄物清理法處新台幣三仟元之罰鍰外，尚未有因環境汙染而遭遇重大處分與損失之情形；且以公司目前及未來產品發展方向觀之，預期未來亦不致有重大環境污染問題。
- 5.說明目前污染狀況及其改善對公司盈餘、競爭地位及資本支出之影響及其未來二年度預計之重大環保資本支出：本公司產品產製過程目前並無重大環境汙染狀況，對公司盈餘、競爭地位及資本支出均不會造成影響，且預計未來二年度亦不會產生重大環保資本支出。



## 五、勞資關係

1.公司各項員工福利措施、進修、訓練、退休制度與其實施狀況，以及勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形：

### (1)員工福利措施

A.本公司為增進員工福利，依法提撥福利金，成立職工福利委員會，由其統籌辦理員工各種福利活動。

B.員工分紅及配股：

為使全體員工能同心協力共創利潤，公司於會計年度結束後，如有盈餘，除優先彌補虧損並依法提列法定公積外，再從盈餘提撥10%的員工分紅，並於每次現金增資時，依法提撥一定比例供員工入股。

C.員工制服：製作冬夏季制服。

D.婚喪喜慶補助。

E.國內旅遊。

F.勞健保及團保。

### (2)進修、訓練

公司對目前在職人員均不定期給予參加本身職務相關之教育訓練，已提高工作效率，培養員工職務上應有之認知。又對現場相關人員亦實施各項機具操作證照訓練。

### (3)退休制度及其實施情形

依勞動基準法及本公司管理規則之規定，設立勞工退休準備金監督委員會，並按月提撥退休準備金存入中央信託局，由退休準備金監督委員會負責保管及運用。

### (4)勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形

本公司一向秉持『勞資一體』、『共存共榮』的基本觀念，培養了對延續企業生存與長期發展的認同和共識，並適切的將公司面臨之困難與問題加以說明及表達公司之立場和決策，使勞資雙方得到公平的對待，建立穩定和諧的勞資關係。

2.說明年度截至年報刊印日止，勞資糾紛所遭受之損失，並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施：

本公司自成立以來勞資關係和諧，估計未來因勞資糾紛所遭受損失之可能性極低。

## 六、重要契約

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	重要限制條款
土地抵押借款	土地銀行	97.01.11-112.01.10	土地借款	提供土地擔保
購料借款	土地銀行	98.04.03-99.04.02	購料借款	-
信用借款	上海商銀	97.10.15-102.10.15	建構研發環境貸款	-
購置廠房借款	玉山銀行	94.07.20-104.07.20	廠房借款	提供廠房擔保
信用借款	玉山銀行	97.07.08-98.07.08	週轉金借款	-
購料借款	玉山銀行	97.07.24-98.07.24	購料借款	-
信用借款	彰化銀行	97.09.30-98.09.30	週轉金借款	-
購料借款	彰化銀行	97.07.18-98.09.30	購料借款	-
廠房工程合約	富泰營造股份有限公司	95.12.11-97.05.23	廠房新建及機電工程	-

## 陸、財務概況

### 一、最近五年度簡明資產負債表、損益表、簽證會計師姓名及查核意見

#### (一)簡明資產負債表

單位:新台幣仟元

項 目	年 度	最近五年度財務資料 (註 1)				
		93 年	94 年	95 年	96 年	97 年
流 動 資 產		195,264	187,068	764,293	988,131	1,767,807
基 金 及 長 期 投 資		7,722	9,105	4,750	40,095	54,802
固 定 資 產		17,738	138,864	236,025	339,195	450,603
無 形 資 產		550	8,182	10,737	13,480	15,941
其 他 資 產		43,017	44,475	39,696	35,587	75,008
資 產 總 額		264,291	387,694	1,055,501	1,416,488	2,364,161
流 動 負 債	分 配 前	93,226	120,434	203,328	464,351	847,360
	分 配 後	93,226	120,434	206,104	456,200	註 2
長 期 負 債		-	105,368	170,029	143,166	261,156
其 他 負 債		931	1,538	1,793	2,117	3,073
負 債 總 額	分 配 前	94,157	227,340	375,150	609,634	1,111,589
	分 配 後	94,157	227,340	377,926	617,785	註 2
股 本		200,000	250,000	380,000	418,300	587,738
資 本 公 積		14,400	14,688	254,688	257,625	328,824
保 留 盈 餘	分 配 前	(44,266)	(104,297)	46,077	131,366	335,678
	分 配 後	(44,266)	(104,297)	5,001	29,002	註 2
金 融 商 品 未 實 現 損 益		-	-	-	-	43
累 積 換 算 調 整 數		-	-	-	-	-
未 認 列 為 退 休 金 成 本 之 淨 損 失		-	(37)	(414)	(437)	(1,321)
股 東 權 益 總 額	分 配 前	170,134	160,354	680,351	806,854	1,252,572
	分 配 後	170,134	160,354	677,575	798,703	註 2

註 1：本公司最近五年度財務報表均經會計師查核簽證。

註 2：97 年度盈餘分配尚未經股東會決議。

## (二)簡明損益表

單位：新台幣仟元  
(除每股盈餘為新台幣元外)

項 目	最近五年度財務資料(註2)				
	93年	94年	95年	96年	97年
營業收入	190,663	122,938	809,237	825,513	1334,130
營業毛利(損)	51,362	25,263	292,822	320,703	836,909
營業(損)益	(3,550)	(67,622)	167,742	165,604	285,109
營業外收入及利益	822	8,701	3,294	3,506	4,424
營業外費用及損失	1,417	8,041	15,510	19,031	20,954
繼續營業部門稅前(損)益	(4,145)	(66,962)	155,526	150,079	268,579
繼續營業部門(損)益	(4,145)	(66,962)	155,526	150,079	268,579
停業部門(損)益	-	-	-	-	-
非常(損)益	-	-	-	-	-
會計原則變動之累積影響數	-	-	-	-	-
本期(損)益	4,780	(60,031)	150,374	126,365	306,676
每股盈餘(虧損)	0.3	(2.70)	5.18	3.02	5.35
每股盈餘(虧損)(註1)	0.27	(2.44)	4.69	2.42	

註1：每股盈餘係按追溯調整後之加權平均股數計算。

註2：本公司最近五年度財務報表均經會計師查核簽證。

## (三)最近五年度簽證會計師姓名及其查核意見

年度	會計師事務所名稱	簽證會計師姓名	意見
93	勤業眾信會計師事務所	江美艷、林政治	無保留意見
94	勤業眾信會計師事務所	江美艷、林政治	無保留意見
95	安侯建業會計師事務所	張字信、梅元貞	修正式無保留意見
96	安侯建業會計師事務所	張字信、梅元貞	修正式無保留意見
97	安侯建業會計師事務所	張字信、郭士華	修正式無保留意見

## 二、最近五年度財務分析

### (一)財務分析

分析項目		最近五年度財務分析					
		93年	94年	95年	96年	97年	
財務結構(%)	負債占資產比率	35.63	58.64	35.54	43.04	47.02	
	長期資金占固定資產比率	959.15	191.35	360.29	284.82	335.93	
償債能力(%)	流動比率	209.45	155.33	375.89	212.80	208.63	
	速動比率	132.53	74.88	295.30	163.98	154.27	
	利息保障倍數	(2.93)	(15.65)	17.56	18.93	19.70	
經營能力	應收款項週轉率(次)	5.56	1.76	4.11	1.65	1.76	
	平均收現日數	66	207	89	221	207	
	存貨週轉率(次)	4.80	1.50	4.75	2.83	2.48	
	應付款項週轉率	4.40	1.97	7.15	3.87	5.15	
	平均銷貨日數	76	244	77	129	147	
	固定資產週轉率(次)	10.75	0.89	3.43	2.87	3.38	
	總資產週轉率(次)	0.72	0.32	0.77	0.67	0.71	
獲利能力	資產報酬率(%)	2.89	(17.49)	21.82	10.73	16.79	
	股東權益報酬率(%)	3.42	(36.33)	35.77	16.99	29.78	
	占實收資本比率(%)	營業(損)益	(1.78)	(27.05)	44.14	39.59	48.51
		稅前(損)益	(2.07)	(26.78)	40.93	35.88	45.70
	純益率(%)	2.51	(48.83)	18.58	15.31	22.99	
每股盈餘(元)	0.30	(2.70)	5.18	3.02	5.35		
現金流量	現金流量比率(%)	-	-	-	-	-	
	現金流量允當比率(%)	-	-	-	-	-	
	現金再投資比率(%)	-	-	-	-	-	
槓桿度	營運槓桿度	-	-	4.21	4.14	4.68	
	財務槓桿度	-	-	1.06	1.05	1.05	

說明最近二年度各項財務比率變動原因：

1. 財務結構：97年度因擴廠所需，資金需求增加，銀行借款增加，故使負債占資產比率增加。在長期資金占固定資產比率方面，93~97年度均在100%以上，顯示本公司並無以短期資金支應固定資產之情形。
2. 償債能力：97年度因增加存貨因應，相對使得銀行借款及應付帳款增加，致使流動比率及速動比率因而下降。在利息保障倍數方面，隨著本公司營運規模逐漸成長，致97年度利息保障倍數上升。
3. 經營能力：本公司96及97年度應收款項週轉率分別為1.65次及1.76次，平均收現日數由221天降至207天，代表營業收入成長同時應收帳款收現日數仍然控制良好。96及97年度存貨週轉率分別為2.83次及2.48次，平均銷貨日數由129天上升至147天，主要係97年第四季全球金融海嘯，致使客戶要求延後交機，因此期末存貨略為增加。固定資產週轉率及總資產週轉率皆因營業效率提昇使得週轉次數增加。
4. 獲利能力：由於營運效率提昇使得純益率、總資產週轉率提高，致使股東權益報酬率回升。
5. 96及97年度為營業活動現金流量為淨流出，故未予列示。

### 1.財務結構

(1)負債占資產比率＝負債總額/資產總額。

(2)長期資金占固定資產比率＝（股東權益淨額＋長期負債）/固定資產淨額。

### 2.償債能力

(1)流動比率＝流動資產/流動負債。

(2)速動比率＝（流動資產－存貨－預付費用）/流動負債。

(3)利息保障倍數＝所得稅及利息費用前純益/本期利息支出。

### 3.經營能力

(1)應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)週轉率＝銷貨淨額/各期平均應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)餘額。

(2)平均收現日數＝365/應收款項週轉率。

(3)存貨週轉率＝銷貨成本/平均存貨額。

(4)應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)週轉率＝銷貨成本/各期平均應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)餘額。

(5)平均銷貨日數＝365/存貨週轉率。

(6)固定資產週轉率＝銷貨淨額/固定資產淨額。

(7)總資產週轉率＝銷貨淨額/資產總額。

### 4.獲利能力

(1)資產報酬率＝〔稅後損益＋利息費用×（1－稅率）〕/平均資產總額。

(2)股東權益報酬率＝稅後損益/平均股東權益淨額。

(3)純益率＝稅後損益/銷貨淨額。

(4)每股盈餘＝（稅後淨利－特別股股利）/加權平均已發行股數。

### 5.現金流量

(1)現金流量比率＝營業活動淨現金流量/流動負債。

(2)淨現金流量允當比率＝最近五年度營業活動淨現金流量/最近五年度(資本支出＋存貨增加額＋現金股利)。

(3)現金再投資比率＝(營業活動淨現金流量－現金股利)/(固定資產毛額＋長期投資＋其他資產＋營運資金)。

### 6.槓桿度：

(1)營運槓桿度＝(營業收入淨額－變動營業成本及費用)/營業利益。

(2)財務槓桿度＝營業利益/(營業利益－利息費用)

(二)合併財務比率分析：不適用。

### 三、最近年度財務報告之監察人審查報告

#### 監察人審查報告書

董事會造送本公司九十七年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表等各項財務報表，其中財務報表業經安侯建業會計師事務所張字信會計師及郭士華會計師查核竣事。上述各項財務報表經本監察人審查完竣，認為尚無不符，爰依公司法第二一九條之規定，繕具報告書，敬請 鑒察。

此 致

晶彩科技股份有限公司九十八年股東常會

監察人：胡湘寧

監察人：王淑珍

監察人：莊永賀

中 華 民 國 九 十 八 年 三 月 二 十 七 日

四、最近年度財務報表

股票代碼：3535

晶彩科技股份有限公司

財 務 報 告

民國九十七年及九十六年十二月三十一日

公司地址：新竹縣竹北市沿河街78巷19號  
電 話：(03) 5545988



# 目 錄

項 目	頁 次
一、封 面	80
二、目 錄	81
三、會計師查核報告	82
四、資產負債表	84
五、損益表	85
六、股東權益變動表	86
七、現金流量表	87
八、財務報表附註	
(一)公司沿革	88
(二)重要會計政策之彙總說明	88
(三)會計變動之理由及其影響	94
(四)重要會計科目之說明	94
(五)關係人交易	108
(六)抵質押之資產	110
(七)重大承諾事項及或有事項	110
(八)重大之災害損失	111
(九)重大之期後事項	111
(十)其 他	111
(十一)附註揭露事項	111
1.重大交易事項相關資訊	111
2.轉投資事業相關資訊	112
3.大陸投資資訊	113
(十二)部門別財務資訊	113
九、重要會計科目明細表	114~125

## 會計師查核報告

晶彩科技股份有限公司董事會 公鑒：

晶彩科技股份有限公司民國九十七年及九十六年十二月三十一日之資產負債表，暨截至各該日止之民國九十七年度及九十六年度之損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開財務報表表示意見。晶彩科技股份有限公司採權益法評價之長期股權投資中，有關華康半導體股份有限公司民國九十六年度之財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核，因此，本會計師對民國九十六年度財務報表所表示之意見中，有關華康半導體股份有限公司財務報表所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。民國九十六年十二月三十一日對華康半導體股份有限公司認列之長期股權投資金額為35,179千元，占資產總額之3%，民國九十六年度所認列之投資損失為4,821千元，占稅前淨利之(3.2)%。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，第一段所述財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則、商業會計法及商業會計處理準則中與財務會計準則相關之規定及一般公認會計原則編製，足以允當表達晶彩科技股份有限公司 民國九十七年及九十六年十二月三十一日之財務狀況，暨截至各該日止之民國九十七年度及 九十六年度之經營成果與現金流量。

民國九十七年度財務報表重要會計科目明細表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核。依本會計師之意見，該等明細表係依據證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達其與第一段所述財務報表有關之內容。

如財務報表附註三所述，晶彩科技股份有限公司自民國九十七年一月一日起，首次適用財務會計準則公報第三十九號「股份基礎給付之會計處理準則」及會計研究發展基金會(96)基祕字第052號解釋函，依公報及解釋函規定分類、衡量及揭露股份基礎給付交易、員工分紅及董監酬勞，致民國九十七年度稅後淨利減少24,841千元，每股盈餘減少0.43元。

安 侯 建 業 會 計 師 事 務 所

張 字 信

會 計 師：

郭 士 華

證券主管機關：金管證六字第 0940100754 號  
核准簽證文號：金管證六字第 0950103298 號  
民國九十八年二月二十日

## 晶彩科技股份有限公司

## 資產負債表

民國九十七年及九十六年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	97.12.31		96.12.31			97.12.31		96.12.31	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
<b>資 產</b>									
<b>流動資產：</b>									
1100 現金(附註四(一))	\$ 373,277	16	86,326	6	2100				
1140 應收票據及帳款淨額(附註四(三)及五)	866,469	37	652,887	46	2120				
1210 存貨淨額(附註四(四))	458,484	19	216,880	15	2140				
1286 遞延所得稅資產-流動(附註四(十三))	13,678	1	6,253	1	2224				
1298 其他流動資產(附註五)	15,856	1	25,785	2	2272				
1310 備供出售金融資產-流動 (附註四(二))	40,043	2	-	-	2280				
	<u>1,767,807</u>	<u>76</u>	<u>988,131</u>	<u>70</u>	2420				
<b>長期投資：</b>									
1421 權益法之長期股權投資(附註四(五))	44,886	2	35,179	3	2810				
1480 以成本衡量之金融資產-非流動 (附註四(二)及(五))	9,916	-	4,916	-	2820				
	<u>54,802</u>	<u>2</u>	<u>40,095</u>	<u>3</u>	2881				
<b>固定資產(附註四(六)、五及六)：</b>									
<b>成 本：</b>									
1501 土地	184,746	8	184,746	14	3110				
1521 房屋及建築	173,486	7	103,513	7	3140				
1531 機器設備	39,486	2	11,548	1					
1551 運輸設備	3,337	-	3,337	-	3210				
1561 辦公設備	5,866	-	7,040	-					
1681 其他設備	2,928	-	6,095	-	3310				
	<u>409,849</u>	<u>17</u>	<u>316,279</u>	<u>22</u>	3350				
15X9 減：累計折舊	13,484	1	12,927	1					
1670 未完工程及預付設備款	54,238	2	35,843	3	3430				
	<u>450,603</u>	<u>18</u>	<u>339,195</u>	<u>24</u>					
<b>無形資產：</b>									
1710 無形資產(附註四(七)及五)	14,968	1	12,445	1	3451				
1770 遞延退休金成本(附註四(十))	973	-	1,035	-					
	<u>15,941</u>	<u>1</u>	<u>13,480</u>	<u>1</u>					
<b>其他資產：</b>									
1820 存出保證金	1,193	-	767	-					
1830 遞延費用	7,213	-	4,345	-					
1860 遞延所得稅資產-非流動 (附註四(十三))	66,602	3	30,475	2					
	<u>75,008</u>	<u>3</u>	<u>35,587</u>	<u>2</u>					
<b>資產總計</b>	<b>\$ 2,364,161</b>	<b>100</b>	<b>1,416,488</b>	<b>100</b>					
<b>負債及股東權益</b>									
<b>流動負債：</b>									
短期借款(附註四(八))	\$ 555,700	24	223,555	16					
應付票據	141,725	6	83,521	6					
應付帳款	24,736	1	74,834	5					
應付設備款	97	-	242	-					
一年內到期之長期借款(附註四(九)及六)	17,875	1	16,089	1					
應付費用及其他流動負債	107,227	4	66,110	5					
	<u>847,360</u>	<u>36</u>	<u>464,351</u>	<u>33</u>					
<b>長期借款(附註四(九)及六)</b>	<u>261,156</u>	<u>11</u>	<u>143,166</u>	<u>10</u>					
<b>其他負債：</b>									
應計退休金負債(附註四(十))	2,861	-	1,867	-					
存入保證金	150	-	150	-					
遞延貸項-聯屬公司間利益 (附註五)	62	-	100	-					
	<u>3,073</u>	<u>-</u>	<u>2,117</u>	<u>-</u>					
<b>負債合計</b>	<u>1,111,589</u>	<u>47</u>	<u>609,634</u>	<u>43</u>					
<b>股東權益(附註四(十二))：</b>									
股本	587,738	25	418,300	30					
預收股本	1,610	-	-	-					
	<u>589,348</u>	<u>25</u>	<u>418,300</u>	<u>30</u>					
資本公積	328,824	14	257,625	18					
保留盈餘：									
法定盈餘公積	17,245	1	4,608	-					
未分配盈餘	318,433	13	126,758	9					
	<u>335,678</u>	<u>14</u>	<u>131,366</u>	<u>9</u>					
未認列為退休金成本之淨損失 (附註四(十))	(1,321)	-	(437)	-					
金融資產未實現損益(附註四(二))	43	-	-	-					
<b>股東權益合計</b>	<u>1,252,572</u>	<u>53</u>	<u>806,854</u>	<u>57</u>					
<b>重大承諾事項及或有事項(附註七)</b>									
<b>負債及股東權益總計</b>	<b>\$ 2,364,161</b>	<b>100</b>	<b>1,416,488</b>	<b>100</b>					

(請詳閱後附財務報表附註)

董事長：

經理人：

會計主管：

民國九十七年及九十六年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

		97年度		96年度	
		金額	%	金額	%
4000	營業收入(附註五)	\$ 1,334,130	100	825,513	100
5110	營業成本(附註五)	836,909	63	504,810	61
5910	營業毛利	497,221	37	320,703	39
6000	營業費用(附註十)：				
6100	推銷費用	12,511	1	7,343	1
6200	管理及總務費用	77,713	6	91,068	11
6300	研究發展費用	121,888	9	56,688	7
		212,112	16	155,099	19
6900	營業淨利	285,109	21	165,604	20
	營業外收入及利益：				
7110	利息收入	655	-	140	-
7290	政府補助收入(附註七)	-	-	811	-
7310	金融資產評價利益	-	-	409	-
7480	什項收入(附註五)	3,769	-	2,146	-
		4,424	-	3,506	-
	營業外費用及損失：				
7510	利息費用	14,366	1	8,371	1
7521	採權益法認列之投資損失(附註四(五))	6,107	-	7,592	1
7530	處分及報廢固定資產淨損失	30	-	944	-
7880	什項支出	451	-	2,124	-
		20,954	1	19,031	2
7900	稅前淨利	268,579	20	150,079	18
8110	所得稅(利益)費用(附註四(十三))	(38,097)	(3)	23,714	3
	本期淨利	<b>\$ 306,676</b>	<b>23</b>	<b>126,365</b>	<b>15</b>
		稅前	稅後	稅前	稅後
	每股盈餘(元)(附註四(十四))				
9750	基本每股盈餘	<b>\$ 4.69</b>	<b>5.35</b>	<b>3.59</b>	<b>3.02</b>
9850	稀釋每股盈餘	<b>\$ 4.49</b>	<b>5.13</b>	<b>3.50</b>	<b>2.95</b>
	基本每股盈餘-追溯調整			<b>\$ 2.93</b>	<b>2.46</b>

晶彩科技股份有限公司

股東權益變動表

民國九十七年及九十六年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	股 本	預收股本	資本公積	保留盈餘		金融商品 未實現損益	未認列為 退休金成本 之淨損失	合 計
				法定盈餘 公 積	未 分 配 盈 餘			
民國九十六年一月一日期初餘額	\$ 380,000	-	254,688	-	46,077	-	(414)	680,351
盈餘指撥及分配：								
法定盈餘公積	-	-	-	4,608	(4,608)	-	-	-
董事監察人酬勞	-	-	-	-	(829)	-	-	(829)
員工紅利	-	-	-	-	(47)	-	-	(47)
員工紅利轉增資	4,100	-	-	-	(4,100)	-	-	-
股東紅利	-	-	-	-	(1,900)	-	-	(1,900)
股東紅利轉增資	34,200	-	-	-	(34,200)	-	-	-
未按持股比例認購長期股權投資之資本公積變動	-	-	2,937	-	-	-	-	2,937
未認列為退休金成本之淨損失變動	-	-	-	-	-	-	(23)	(23)
民國九十六年度淨利	-	-	-	-	126,365	-	-	126,365
民國九十六年十二月三十一日餘額	418,300	-	257,625	4,608	126,758	-	(437)	806,854
現金增資	48,440	-	79,348	-	-	-	-	127,788
盈餘指撥及分配：								
法定盈餘公積	-	-	-	12,637	(12,637)	-	-	-
董事監察人酬勞	-	-	-	-	(2,047)	-	-	(2,047)
員工紅利	-	-	-	-	(36)	-	-	(36)
員工紅利轉增資	10,200	-	-	-	(10,200)	-	-	-
股東紅利	-	-	-	-	(6,068)	-	-	(6,068)
股東紅利轉增資	84,013	-	-	-	(84,013)	-	-	-
員工行使認股權	17,450	1,610	-	-	-	-	-	19,060
資本公積轉增資	9,335	-	(9,335)	-	-	-	-	-
備供出售金融資產未實現損益之變動	-	-	-	-	-	43	-	43
未認列為退休金成本之淨損失變動	-	-	-	-	-	-	(884)	(884)
未按持股比例認購長期股權投資之資本公積變動	-	-	1,186	-	-	-	-	1,186
民國九十七年度淨利	-	-	-	-	306,676	-	-	306,676
民國九十七年十二月三十一日餘額	\$ 587,738	1,610	328,824	17,245	318,433	43	(1,321)	1,252,572

(請詳閱後附財務報表附註)

董事長：

經理人：

會計主管：

	97年度	96年度
<b>營業活動之現金流量：</b>		
<b>本期淨利</b>	\$ 306,676	126,365
<b>調整項目：</b>		
提列呆帳損失	14,905	17,746
採權益法認列之投資損失	6,107	7,592
折舊及攤銷	18,140	13,614
處分固定資產損失淨額	30	944
公平價值變動列入損益之金融資產減少	-	71,091
土地徵收損失	-	1,618
其他不影響現金流量之收益及費損淨額	(38)	(59)
應收票據及帳款增加	(228,487)	(360,403)
存貨增加	(241,604)	(77,398)
其他營業相關之流動資產(增加)減少	9,107	(1,850)
遞延所得稅資產(增加)減少	(43,552)	11,583
應付票據及帳款增加	8,106	56,081
其他營業相關之流動負債增加	42,111	32,039
<b>營業活動之淨現金流出</b>	<u>(108,499)</u>	<u>(101,037)</u>
<b>投資活動之現金流量：</b>		
採權益法評價之長期股權投資增加	(14,628)	(40,000)
備供出售金融資產增加	(40,000)	-
購置固定資產	(130,447)	(132,456)
處分固定資產價款	-	8,039
以成本衡量之金融資產增加	(5,000)	-
存出保證金減少(增加)	(426)	1,950
遞延費用及無形資產增加	(4,667)	(12,686)
<b>投資活動之淨現金流出</b>	<u>(195,168)</u>	<u>(175,153)</u>
<b>融資活動之現金流量：</b>		
支付董監酬勞	(2,047)	(829)
支付員工紅利	(36)	(47)
支付股東紅利	(6,068)	(1,900)
現金增資	127,788	-
員工認股權行使	19,060	-
短期借款增加	332,145	188,555
長期借款增加	209,000	10,000
償還長期借款	(89,224)	(40,773)
<b>融資活動之淨現金流入</b>	<u>590,618</u>	<u>155,006</u>
<b>本期現金增加(減少)數</b>	286,951	(121,184)
<b>期初現金餘額</b>	86,326	207,510
<b>期末現金餘額</b>	<u>\$ 373,277</u>	<u>86,326</u>
<b>現金流量資訊之補充揭露：</b>		
本期支付利息	<u>\$ 13,718</u>	<u>8,786</u>
本期支付所得稅	<u>\$ 15,767</u>	<u>5,381</u>
<b>支付現金取得固定資產</b>		
購置固定資產	\$ 130,302	120,985
應付設備款淨變動數	145	11,471
	<u>\$ 130,447</u>	<u>132,456</u>
<b>不影響現金流量之投資及融資活動：</b>		

## 晶彩科技股份有限公司財務報表附註(續)

### 晶彩科技股份有限公司

#### 財務報表附註

民國九十七年及九十六年十二月三十一日

(除另有註明者外，所有金額均以新台幣千元為單位)

#### 一、公司沿革

晶彩科技股份有限公司(以下稱本公司)於民國八十九年三月十日經經濟部核准設立，民國九十五年九月十三日獲准公開發行股票，自民國九十五年十二月十三日起於興櫃市場交易，並自民國九十七年一月三十一日起於台灣證券交易所上市掛牌買賣。主要業務為一般儀器及精密儀器之製造及銷售暨資訊軟體服務等。

截至民國九十七年及九十六年十二月三十一日止，本公司員工人數分別為212人及182人。

#### 二、重要會計政策之彙總說明

本公司財務報表係依照證券發行人財務報告編製準則、商業會計法、商業會計處理準則及我國一般公認會計原則編製。重要會計政策及衡量基礎彙總說明如下：

##### (一)會計估計

本公司於編製財務報表時，業已依規定對財務報表所列資產、負債、收益、費損及或有事項，採用必要之假設及估計加以衡量、評估與揭露，惟該等估計與實際結果可能存有差異。

##### (二)外幣交易

本公司以新台幣記帳。非衍生性商品之外幣交易依交易日之即期匯率入帳；資產負債表日之外幣貨幣性資產或負債，依當日之即期匯率換算，產生之兌換差額列為當期損益。本公司將外幣非貨幣性資產或負債按交易日之歷史匯率衡量；但以公平價值衡量之外幣非貨幣性資產或負債，則按資產負債表日即期匯率換算，如屬公平價值變動認列為當期損益者，兌換差額亦認列為當期損益；如屬公平價值變動認列為股東權益調整項目者，兌換差額亦認列為股東權益調整項目。

##### (三)資產與負債區分流動與非流動之標準

資產符合下列條件之一者，列為流動資產，非屬流動資產者列為非流動資



## 晶彩科技股份有限公司財務報表附註(續)

產：

- 企業因營業所產生之資產，預期將於企業之正常營運週期中變現、消耗或意圖出售者。
- 主要為交易目的而持有者。
- 預期於資產負債表日後十二個月內將變現者。
- 現金或約當現金，但於資產負債表日後逾十二個月用以交換、清償負債或專有其他限制者除外。

負債符合下列條件之一者列為流動負債；非屬流動負債者列為非流動負債：

- 企業因營業而發生之債務，預期將於企業之正常營運週期中清償者。
- 主要為交易目的而發生者。
- 須於資產負債表日後十二個月內清償之負債。
- 不得無條件延期至資產負債表日後逾十二個月清償之負債。

### (四)資產減損

本公司於資產負債表日就有減損跡象之資產，估計其可回收金額，並就可回收金額低於帳面價值之資產，認列減損損失。前述所認列之累積減損損失，嗣後若已不存在或減少，即予迴轉，增加資產帳面價值至可回收金額，惟不超過資產在未認列減損損失下，減除應提列折舊或攤銷之數。

### (五)金融商品

本公司對金融商品交易係採交易日會計，於原始認列時，將金融商品以公平價值衡量，除以交易為目的之金融商品外，其他金融商品之原始認列金額則加計取得或發行之交易成本。在原始認列後，依本公司發行之目的分類及衡量如下：

1. 備供出售金融資產：係以公平價值評價，除減損損失及貨幣性金融資產外幣兌換損益外，於金融資產除列前，認列為股東權益調整項目。於除列時，將累積之利益或損失列入當期損益。若有減損之客觀證據，則認列減損損失。若後續期間減損金額減少，備供出售權益商品之減損減少金額，認列為股東權益調整項目；備供出售債務商品之減損減少金額若明顯與認列減損後發生之事件有關，則予以迴轉並認列為當期損益。
2. 以成本衡量之金融資產：無法可靠衡量公平價值之權益商品投資，以原始

## 晶彩科技股份有限公司財務報表附註(續)

認列之成本衡量。若有減損之客觀證據，則認列減損損失，此減損金額不予迴轉。

### (六)備抵呆帳

備抵呆帳係依據帳齡分析、客戶信用評估、及過去收款經驗，並考量內部授信政策後提列。

### (七)存貨

存貨以成本與市價孰低法評價。成本計算採加權平均法，市價以重置成本或淨變現價值為基礎。

### (八)採權益法之長期股權投資

本公司持有被投資公司有表決權股份比例達百分之二十以上者，採權益法評價。

與權益法評價之被投資公司間交易所產生之損益尚未實現者予以遞延。交易損益如屬折舊性或攤銷性資產所產生者，依其效益年限逐年承認；其他類資產所產生者，於實現年度承認。

本公司非按持股比例認購或取得被投資公司增發新股，致投資比例發生變動，而使投資之股權淨值發生增減時，其增減數調整資本公積。若此項調整係沖減資本公積，但由長期投資所發生之資本公積餘額不足時，其差額則沖銷保留盈餘。

### (九)固定資產及其折舊

固定資產以取得成本為入帳基礎。重大增添、改良及重置支出予以資本化；維護及修理費用列為發生當期費用。

固定資產之折舊係按直線法以成本依估計耐用年數計提，耐用年限屆滿仍繼續使用者，就其殘值自該屆滿日起估計尚可使用年限繼續提列折舊。主要固定資產之耐用年數如下：

1. 房屋及建築：7~50 年
2. 機器設備：6~10 年
3. 運輸設備：5 年
4. 辦公設備：5~8 年
5. 其他設備：3~5 年

處分固定資產之損益列為營業外收支。

## 晶彩科技股份有限公司財務報表附註(續)

### (十)無形資產

本公司自民國九十六年度起適用財務會計準則公報第三十七號「無形資產之會計處理準則」。

依該公報規定，研究階段之支出除於企業合併認列為商譽或無形資產者外，於發生時即認列費用。

發展階段之支出於同時符合下列所有條件時，認列為無形資產；未同時符合者，於發生時即認列為費用：

1. 完成該無形資產已達技術可行性，使該無形資產將可供使用或出售。
2. 意圖完成該無形資產，並加以使用或出售。
3. 有能力使用或出售該無形資產。
4. 無形資產將很有可能產生未來經濟效益。
5. 具充足之技術、財務及其他資源，以完成此項發展專案計畫。
6. 發展階段歸屬於無形資產之支出能可靠衡量。

由內部產生以外之無形資產原始認列無形資產時以成本衡量。續後，以成本減除累計攤銷及累計減損損失後之金額作為帳面價值。

攤銷時以原始成本減除殘值後之金額為可攤銷金額，並於已達可供使用狀態開始時，於耐用年限期間(一至五年)以直線法攤銷。

每年至少於會計年度終了時評估無形資產之殘值、攤銷期間及攤銷方法。殘值、攤銷期間及攤銷方法之變動，均視為會計估計變動。

### (十一)遞延費用

係電話系統、電力工程等，以取得成本為入帳基礎，並依估計效益年限二至五年平均攤銷。

### (十二)產品售後服務及保固準備

估計可能發生之產品售後服務、保固及修理費用，於產品出售年度按銷貨總額之一定百分比認列為維修成本。

### (十三)退休金

本公司之職工退休辦法涵蓋所有正式任用員工。依該辦法規定，員工退休金之支付係根據服務年資所獲得之基數及核准退休時六個月平均工資，一次給付退休金。基數之計算係依每位員工前十五年之服務，每服務一年可獲得二個基數，自第十六年起，每服務滿一年可獲得一個基數，惟最高總數以四十五

## 晶彩科技股份有限公司財務報表附註(續)

個基數為限，退休金給付全數由本公司負擔。

自民國九十四年七月一日起配合勞工退休金條例（以下簡稱「新制」）之實施，原適用該辦法之員工如經選擇適用新制後之服務年資或新制施行後到職之員工其服務年資改採確定提撥制，其退休金之給付由本公司按月以不低於每月工資百分之六提繳退休金，儲存於勞工退休金個人專戶。本公司之退休辦法並未配合新制之實施修訂，故職工退休辦法未規定者，依新制之規定辦理。

採用確定給付退休辦法部份，本公司依財務會計準則公報第十八號「退休金會計處理準則」規定，以年度資產負債表日為衡量日完成精算，其累積給付義務超過退休基金資產公平價值部份，於資產負債表認列最低退休金負債，並依退休辦法之精算結果認列淨退休金成本，包括當期服務成本、利息成本、退休基金資產報酬及過渡性淨給付義務依員工平均剩餘服務年限採直線法攤銷之數。本公司依勞動基準法規定，按月依薪資總額百分之二提撥勞工退休準備金，專戶儲存於台灣銀行。

採用確定提撥退休辦法部份，本公司依新制之規定，依勞工每月工資百分之六之提繳率，提撥至勞工保險局，提撥數列為當期費用。

### (十四)營業收入

機器設備之銷貨收入係於組裝完成並交付，且風險及報酬移轉予客戶時認列。

營業收入係按本公司與買方所協議交易對價之公平價值衡量；惟營業收入之對價為一年期以內之應收款時，其公平價值與到期值差異不大且交易量頻繁，則不按設算利率計算公平價值。

### (十五)員工紅利及董監酬勞

本公司民國九十七年度(含)以後之盈餘，依公司法及本公司章程規定分配之員工紅利及董監酬勞時，係依會計研究發展基金會(96)基秘字第052號解釋函，於報導期中及年度財務報表，先行估計擬分配員工紅利及董監酬勞金額，並依員工紅利及董監酬勞之性質列為營業成本或營業費用項下之適當會計科目。嗣後股東會決議分配金額與財務報表估列數如有差異，視為估計變動，列為分配當期損益。

### (十六)股份基礎給付交易

本公司所發行之員工認股權憑證之給與日係於民國九十七年一月一日(含)

## 晶彩科技股份有限公司財務報表附註(續)

以前，本公司依會計研究發展基金會(92)基秘字第 070、071、072 號解釋函之規定，對於前述員工認股權憑證採用衡量日內含價值法認列酬勞性員工認股選擇權計劃之酬勞成本，亦即按衡量日本公司股票公平價值或發行日時最近期財務報表之股票淨值與行使價格間之差額估計為酬勞成本，並於員工認股選擇權計劃所規定之員工服務年限認列為本公司之費用，同時增加本公司股東權益一認股權。另，依據財務會計準則公報第三十九號「股份基礎給付之會計處理準則」之規定，本公司上述員工認股權憑證無須追溯適用財務會計準則公報第三十九號，但需揭露依該公報規定衡量股份基礎給付。

### (十七)所得稅

所得稅計算係以會計所得為基礎，資產及負債之帳面價值與課稅基礎之差異，依預計回轉年度之適用稅率計算認列遞延所得稅。並將應課稅暫時性差異所產生之所得稅影響數認列為遞延所得稅負債；可減除暫時性差異、虧損扣除及所得稅抵減所產生之所得稅影響數認列為遞延所得稅資產，再評估其遞延所得稅資產之可實現性，認列其備抵評價金額。

遞延所得稅資產或負債依其相關資產或負債之分類劃分為流動或非流動項目；非與資產或負債相關者，則依預期回轉期間之長短劃分。

因投資研究發展所產生之所得稅抵減採當期認列法處理。

本公司未分配盈餘加徵百分之十營利事業所得稅部分，於次年度股東會決議分配盈餘之後列為當期費用。

### (十八)每股盈餘

每股盈餘係以本期淨利除以普通股流通在外加權平均股數計算。若有因資本公積、盈餘及員工紅利轉增資而新增之股數時，則另追溯調整計算每一會計期間加權流通股數之每股盈餘。

自民國九十七年一月一日起，依照會計研究發展基金會(97)基秘字第 169 號函規定，本公司尚未經股東會決議得採股票發放方式之員工紅利，係屬潛在普通股，於計算稀釋每股盈餘時，係假設依會計研究發展基金會(97)基秘字第 052 號函規定估列之員工紅利將採股票方式，以資產負債表日之公平價值並考量最近期除權除息之影響作為發行股數之判斷依據，列為潛在普通股。潛在普通股如均未具稀釋作用，僅揭露基本每股盈餘，反之除揭露基本每股盈餘外，並揭露稀釋每股盈餘。稀釋每股盈餘則假設所有具稀釋作用之潛在普通股均於

## 晶彩科技股份有限公司財務報表附註(續)

當期流通在外，故本期淨利及流通在外普通股股數均須調整所有具稀釋作用潛在普通股之影響。

### 三、會計變動之理由及其影響

本公司自民國九十七年一月一日起，首次適用財務會計準則公報第三十九號「股份基礎給付之會計處理準則」及會計研究發展基金會(96)基秘字第 052 號解釋函，依公報及解釋函規定分類、衡量及揭露股份基礎給付交易、員工分紅及董監酬勞，致民國九十七年度稅後淨利減少 24,841 千元，每股盈餘減少 0.43 元。

本公司自民國九十六年一月一日起，首次適用財務會計準則公報第三十七號「無形資產之會計處理準則」，依該公報規定，本公司於開始適用日重新評估已認列無形資產之耐用年限或攤銷方法，並無應予變更之情事，此項變動對民國九十六年度稅後淨利及每股盈餘皆無影響。

### 四、重要會計科目之說明

#### (一) 現金

	97.12.31	96.12.31
庫存現金	\$ 60	45
活期存款及支票存款	288,217	86,281
定期存款	85,000	-
	\$ 373,277	86,326

#### (二) 金融商品

本公司民國九十七年及九十六年十二月三十一日持有之各類金融資產帳面價值明細如下：

	97.12.31	96.12.31
備供出售金融資產—流動		
受益憑證—債券型基金	\$ 40,043	-
以成本衡量之金融資產—非流動		
股票投資—鑫豪科技股份有限公司(鑫豪科技)	\$ 4,916	4,916
股票投資—晶隼科技股份有限公司(晶隼科技)	5,000	-
	\$ 9,916	4,916

本公司民國九十七年十二月三十一日之備供出售金融資產皆依公平價值衡量。截至民國九十七年十二月三十一日止，股東權益調整數之備供出售金

晶彩科技股份有限公司財務報表附註(續)

融資產未實現利益為 43 千元。

本公司民國九十六年度未投資備供出售金融資產。

本公司於民國九十七年及九十六年十二月三十一日所持有之鑫豪科技股份有限公司及晶隼科技股份有限公司股票，因無活絡市場之公開報價資訊，且其公平價值無法可靠衡量，故以成本衡量。

(三) 應收票據及帳款

	<u>97. 12. 31</u>	<u>96. 12. 31</u>
應收票據	\$ 254	150
應收帳款	<u>908, 325</u>	<u>679, 942</u>
	908, 579	680, 092
減：備抵呆帳	<u>42, 110</u>	<u>27, 205</u>
	<u><u>\$ 866, 469</u></u>	<u><u>652, 887</u></u>

上列應收票據及帳款均未供作擔保。

(四) 存 貨

	<u>97. 12. 31</u>	<u>96. 12. 31</u>
製成品	\$ 25, 405	28, 104
在製品	238, 238	78, 392
原 料	<u>195, 321</u>	<u>110, 864</u>
	458, 964	217, 360
減：備抵存貨跌價損失	<u>(480)</u>	<u>(480)</u>
	<u><u>\$ 458, 484</u></u>	<u><u>216, 880</u></u>

截至民國九十七年及九十六年十二月三十一日止，上項存貨均未提供作為擔保品。

(五) 採權益法之長期股權投資

	<u>97. 12. 31</u>			
	<u>累積投資 成 本</u>	<u>持股 比例%</u>	<u>期 末 帳面價值</u>	<u>本期認列 投資損失</u>
華康半導體股份有限公司	<u>\$ 54, 628</u>	24. 85	<u>44, 886</u>	<u>6, 107</u>
	<u>96. 12. 31</u>			
	<u>累積投資 成 本</u>	<u>持股 比例%</u>	<u>期 末 帳面價值</u>	<u>本期認列 投資損失</u>
華康半導體股份有限公司	<u>\$ 40, 000</u>	26. 67	<u>35, 179</u>	<u>4, 821</u>

本公司民國九十七年度及九十六年度按權益法認列之投資損失，係依據被投資公司當期經會計師查核之財務報表計算。

鑫豪科技分別於民國九十六年三月及十月以現金增資發行新股，本公司因

## 晶彩科技股份有限公司財務報表附註(續)

非按原持股比例承購新股，相對股權淨值分別增加 753 千元及 2,184 千元，帳列資本公積，同時本公司對該公司持股比率降為 19.23%，且對該公司已不具有重大影響力，故停止採權益法評價。

華康半導體於民國九十七年九月以現金增資發行新股，本公司因非按原持股比例承購新股，相對股權淨值增加 1,186 千元，帳列資本公積，同時對該公司持股比率由 26.67%降為 24.85%。

上列股票於民國九十七年及九十六年十二月三十一日均未提供作為保證或質押。本公司採權益法評價之被投資公司相關資訊請參閱附註十一(二)。

### (六)固定資產

本公司於民國九十六年度因購建廠房所發生之利息費用資本化金額為 954 千元，其資本化之利率為 2.95%。

本公司民國九十七年及九十六年十二月三十一日固定資產提供擔保情形請詳附註六。

### (七)無形資產

本公司民國九十七年度及九十六年度無形資產原始成本及累計攤銷金額變動如下：

	<u>電腦軟體</u>	<u>專利權</u>	<u>合計</u>
原始成本：			
民國九十六年一月一日期初餘額	\$ 17,541	780	18,321
單獨取得	8,276	37	8,313
自固定資產轉入	950	-	950
民國九十六年十二月三十一日期末餘額	<u>\$ 26,767</u>	<u>817</u>	<u>27,584</u>
民國九十七年一月一日期初餘額	\$ 26,767	817	27,584
單獨取得	82	82	164
重分類轉入	8,983	-	8,983
民國九十七年十二月三十一日期末餘額	<u>\$ 35,832</u>	<u>899</u>	<u>36,731</u>
攤銷金額：			
民國九十六年一月一日期初餘額	\$ 8,369	310	8,679
本期認列攤銷金額	5,964	496	6,460
民國九十六年十二月三十一日期末餘額	<u>\$ 14,333</u>	<u>806</u>	<u>15,139</u>
民國九十七年一月一日期初餘額	\$ 14,333	806	15,139
本期認列攤銷金額	6,592	32	6,624



晶彩科技股份有限公司財務報表附註(續)

民國九十七年十二月三十一日 期末餘額	\$	<u>20,925</u>	<u>838</u>	<u>21,763</u>
帳面價值：				
民國九十六年一月一日期初餘額	\$	<u>9,172</u>	<u>470</u>	<u>9,642</u>
民國九十六年十二月三十一日 期末餘額	\$	<u>12,434</u>	<u>11</u>	<u>12,445</u>
民國九十七年一月一日期初餘額	\$	<u>12,434</u>	<u>11</u>	<u>12,445</u>
民國九十七年十二月三十一日 期末餘額	\$	<u>14,907</u>	<u>61</u>	<u>14,968</u>

本公司民國九十七年度及九十六年度認列無形資產攤銷費用分別為 6,624 千元及 6,460 千元，帳列營業費用項下。

(八)短期借款

		<u>97. 12. 31</u>	<u>96. 12. 31</u>
信用借款	\$	102,700	100,000
購料借款		<u>453,000</u>	<u>123,555</u>
	\$	<u>555,700</u>	<u>223,555</u>
尚未動用之授信額度	\$	<u>473,180</u>	<u>456,445</u>
利率區間		<u>1.90%~3.15%</u>	<u>2.46%~3.30%</u>

本公司之短期借款均為信用借款，皆無設定抵質押情形。

(九)長期借款

<u>貸款銀行</u>	<u>借款種類</u>	<u>還款期間</u>	<u>97. 12. 31</u>	<u>96. 12. 31</u>
玉山商業銀行	抵押借款	94. 07. 20~104. 07. 20, 每3 月為1期, 計31期	\$ 70,031	80,406
玉山商業銀行	信用借款	94. 07. 21~101. 07. 21, 每3 月為1期, 計19期, 已 於 97年3月提前清償完畢	-	8,143
玉山商業銀行	信用借款	96. 03. 28~99. 03. 28, 每月 為 1期, 計25期, 已於97 年3月提前清償完畢	-	10,000
台灣土地銀行	抵押借款	95. 11. 02~100. 11. 02, 到期 日清償, 已於97年1月 提前清償完畢	-	60,706
台灣土地銀行	抵押借款	99. 04. 11~112. 01. 11, 每3 月為1期, 計52期	179,000	-
上海商業儲蓄銀行	抵押借款	98. 01. 15~101. 10. 15, 每3 月為1期, 計16期	30,000	-
			<u>279,031</u>	<u>159,255</u>
		減：一年內到期部份	<u>17,875</u>	<u>16,089</u>
			<u>\$ 261,156</u>	<u>143,166</u>

晶彩科技股份有限公司財務報表附註(續)

借款利息按銀行基本放款利率浮動計息，民國九十七年度及九十六年度長期借款之年利率區間分別為 2.075%~3.15%及 2.65%~3.04%。

未來年度之到期償還金額如下：

期 間	金 額
98.01.01~98.12.31	\$ 17,875
99.01.01~99.12.31	28,202
100.01.01~100.12.31	31,645
101.01.01~101.12.31	31,645
102.01.01 以後	169,664
	<u>\$ 279,031</u>

提供長期借款擔保之情形，請參閱附註六。

(十) 退休金

1. 本公司民國九十七年及九十六年十二月三十一日確定給付退休辦法之退休基金提撥狀況與帳載應計退休金負債調節如下：

	97.12.31	96.12.31
給付義務：		
既得給付義務	\$ -	-
非既得給付義務	(3,213)	(2,150)
累積給付義務	(3,213)	(2,150)
未來薪資增加之影響數	(1,374)	(1,182)
預計給付義務	(4,587)	(3,332)
退休基金資產公平價值	352	282
提撥狀況	(4,235)	(3,050)
未認列退休金損益	2,695	1,619
未認列過渡性淨給付義務	973	1,035
補列之應計退休金負債	(2,294)	(1,471)
應計退休金負債	<u>\$ (2,861)</u>	<u>(1,867)</u>

2. 確定給付退休金之重要精算假設如下：

	97.12.31	96.12.31
折現率	2.50%	3.50%
未來薪資水準增加率	2.00%	3.00%
退休基金資產預期長期投資報酬率	2.50%	2.50%

晶彩科技股份有限公司財務報表附註(續)

3. 退休金費用：

	97年度	96年度
採確定給付退休辦法之淨退休金成本：		
利息成本	\$ 117	93
退休基金資產預期報酬	(15)	(14)
攤銷數	128	104
	<u>\$ 230</u>	<u>183</u>
採確定提撥退休辦法之退休金費用	<u>\$ 5,489</u>	<u>4,399</u>

(十一) 員工認股權

本公司於民國九十五年八月十五日經董事會決議發行員工認股權憑證2,000千單位，每單位可認購本公司普通股1股。截至民國九十七年十二月三十一日止，本公司發行員工認股權證情形如下：

種類	發行日期	發行單位數 (千單位)	認股權 存續期間	限制認股 期間	每股認 購價格 (元)
九十五年員工 認股權憑證	95.8.15	2,000	95.8.15~ 102.8.15	屆滿2年可 全數認購	\$ 10

本公司民國九十五年八月十五日發行之酬勞性員工認股權計劃，係依內含價值法認列所給與之酬勞成本。因本公司之員工認股權於發行日時尚無公開市場價格，故以發行日時最近期經會計師查核之財務報表股票淨值估計酬勞成本。民國九十七年度依內含價值法所認列之酬勞成本為0元。

倘若上述酬勞性員工認股權計劃係採用公平價值法估計酬勞成本，民國九十七年度及九十六年度須認列酬勞成本分別為13,391千元及21,532千元。此項計算係採用Black-Scholes選擇權評價模式估計給與日員工認股權憑證之公平價值，各項假設之加權平均資訊列示如下：

股利率	0%
預期價格波動性	37.40%
無風險利率	2.47%
預期存續期間	7年
公平市價	31.9元

## 晶彩科技股份有限公司財務報表附註(續)

本公司依上述酬勞性員工認股選擇計劃民國九十七年度及九十六年度相關之數量及加權平均行使價格之資訊揭露如下：

<u>員工認股權</u>	<u>97年度</u>		<u>96年度</u>	
	<u>數量(千股)</u>	<u>加權平均行使價格(元)</u>	<u>數量(千股)</u>	<u>加權平均行使價格(元)</u>
期初流通在外	2,000	\$ 9.10	2,000	10
本期行使	<u>1,906</u>	10	-	-
期末流通在外	<u>94</u>		<u>2,000</u>	
期末仍可行使之員工認股權	<u>94</u>		<u>2,000</u>	
本期給與之員工認股權平均公平市價(元)	<u>\$ -</u>		<u>-</u>	

本公司民國九十七年度及九十六年度酬勞性員工認股選擇權計劃若採公平價值法認列，其相關假設性資訊如前段所述，財務報表之擬制淨利與每股盈餘資訊列示如下：

		<u>97年度</u>	<u>96年度</u>
淨利	報表認列之淨利	\$ 306,676	126,365
	擬制淨利	293,285	104,833
基本每股盈餘	報表認列之每股盈餘(元)	5.35	3.02
	擬制每股盈餘(元)	5.12	2.51
稀釋每股盈餘	報表認列之每股盈餘(元)	5.13	2.95
	擬制每股盈餘(元)	4.91	2.45

### (十二) 股東權益

#### 1. 股本及增資案：

本公司於民國九十六年六月八日經股東會決議以未分配盈餘34,200千元及員工紅利4,100千元轉增資發行新股3,830千股，每股面額10元。此項增資案已於民國九十六年七月四日申報主管機關生效，並以民國九十六年七月三十日為增資基準日，業經辦妥法定登記。

本公司於民國九十六年十月二十六日經董事會決議辦理現金增資發行新股 4,844千股，每股溢價27元，增資基準日為民國九十七年一月三十日，業經辦妥法定登記。

本公司於民國九十七年六月十三日經股東會決議辦理資本公積9,335千元及未分配盈餘94,213千元增資發行新股10,355千股(含員工紅利1,020千

## 晶彩科技股份有限公司財務報表附註(續)

股)，每股面額10元，此項增資案已於民國九十七年七月九日申報主管機關生效，增資基準日為民國九十七年八月四日，業經辦妥法定登記。

截至民國九十七年及九十六年十二月三十一日止，本公司額定股本分別為1,000,000千元及500,000千元(其中均包括保留2,000千股供發行員工認股權憑證使用)，實收股本分別為587,738千元及418,300千元，均為普通股，每股面額10元。

截至民國九十七年十二月三十一日止，員工認股選擇權已執行認購並轉換為普通股為1,745千股，已辦妥法定登記程序，帳列股本項下。

截至民國九十七年十二月三十一日止，本公司預收員工認股權行使股款1,610千元，目前相關程序正在辦理中，帳列預收股本項下。

### 2. 公積及盈餘分派之限制：

#### (1) 資本公積

	<u>97. 12. 31</u>	<u>96. 12. 31</u>
發行股票溢價	\$ 324,413	254,400
長期股權投資按權益法認列資本公積	<u>4,411</u>	<u>3,225</u>
	<u><u>\$ 328,824</u></u>	<u><u>257,625</u></u>

依公司法規定，資本公積僅供彌補虧損，不得用以分配現金股利，但公司無虧損者得以發行股票溢價所產生之資本公積撥充資本。另，依證券交易法施行細則規定，依公司法規定可撥充資本之資本公積，每年撥充之實際金額不得超過實收資本額百分之十。其中以發行股票溢價轉入之資本公積撥充資本者，應俟產生該次資本公積之增資案經主管機關核准登記後之次一年度，始得將該次轉入之資本公積撥充資本。

#### (2) 法定盈餘公積

依公司法規定，公司應就稅後純益提列百分之十為法定盈餘公積，直至與資本總額相等為止。法定盈餘公積依法僅供彌補虧損之用，不得用以分配現金股利。

#### (3) 盈餘分派及股利政策

依本公司章程規定，每年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補以前年度虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，必要時依法提列或迴轉特別盈餘公積，並加計以前年度累計未分配盈餘作為可供分配盈餘，按下列比

## 晶彩科技股份有限公司財務報表附註(續)

率擬訂分配之議案提請股東會決議分配：

- A. 股東紅利百分之八十八；
- B. 員工紅利百分之十；發放對象亦適用於從屬公司之員工；
- C. 董事監察人酬勞百分之二。

本公司股利政策係配合當年度之資本、財務結構、整體環境及產業成長特性，以達成公司永續經營、穩定經營績效之目標，故本公司之股利分派由董事會視營運需要酌予保留，將以不超過公司可分派盈餘百分之九十分派。而依未來資本支出預算及資金需求情形，本公司股利發放採股票股利(含盈餘轉增資、資本公積轉增資)及現金股利二種方式配合辦理，其中現金股利以不低於股利總額之百分之五為原則。

本公司以民國九十七年度之稅後淨利乘上本公司章程所定員工紅利及董事監察人酬勞分配成數分別約為 10%及 2%，估計員工紅利及董事監察人酬勞金額分別為 27,601 千元及 5,520 千元，配發股票紅利之股數計算基礎係依據股東會決議前一日之收盤價並考量除權除息之影響。惟若嗣後股東會決議實際配發金額與估列數有差異時，則視為會計估列變動，列為民國九十八年度之損益。

本公司民國九十六年度盈餘分配案，業於民國九十七年六月十三日經股東會決議通過，除依法提列法定盈餘公積外，相關盈餘分配資訊如下：

	<u>金 額</u>
股票股利	\$ 84,013
現金股利	6,068
董監酬勞	2,047
員工股票紅利	10,200
員工現金紅利	<u>36</u>
	<u><u>\$ 102,364</u></u>

上述盈餘分配情形與本公司董事會決議並無差異。相關資訊可至公開資訊觀測站等管道查詢之。

本年度民國九十七年度之員工紅利及董監酬勞分派數，尚待本公司董事會擬議及股東會決議通過，相關資訊可俟相關會議召開後至公開資訊觀測站查詢之。

### (十三)所得稅

1. 本公司歷年符合促進產業升級條例而享有之租稅優惠列示如下：

晶彩科技股份有限公司財務報表附註(續)

增資年度	免稅期間	租稅減免方式	財政部核准月份
92	97.1.1~101.12.3 1	五年免徵營利事業所得稅	95.1

2. 本公司營利事業所得稅率最高為百分之二十五，並適用「所得基本稅額條例」計算基本稅額。民國九十七年度及九十六年度之所得稅費用(利益)組成如下：

	97年度	96年度
當期	\$ 4,319	12,092
遞延	(43,552)	11,583
未分配盈餘加徵 10%	1,136	39
	<u>\$ (38,097)</u>	<u>23,714</u>

3. 本公司損益表中所列稅前淨利依規定稅率計算之所得稅額與帳列所得稅費用(利益)之差異列示如下：

	97年度	96年度
稅前淨利依法定稅率計算之所得稅費用	\$ 67,145	37,510
永久性差異之所得稅差異影響數	1,527	1,825
未分配盈餘加徵 10%	1,136	39
投資抵減	(23,226)	(15,649)
以前年度遞延所得稅資產低估數	(17,018)	(3)
以前年度所得稅(高)低估數	4,887	(8)
五年免稅所得影響數	(72,548)	-
	<u>\$ (38,097)</u>	<u>23,714</u>

4. 民國九十七年及九十六年十二月三十一日，本公司遞延所得稅資產主要由下列暫時性差異之個別所得稅影響組成：

	97.12.31		96.12.31	
	金額	所得稅影響數	金額	所得稅影響數
遞延所得稅資產—流動：				
備抵呆帳超限	\$ 33,024	8,256	20,404	5,101
未實現存貨跌價損失	480	120	480	120
售後服務保證	6,628	1,657	4,127	1,032
未實現兌換損失	214	54	-	-
投資抵減	3,591	3,591	-	-
		<u>13,678</u>		<u>6,253</u>
遞延所得稅資產—非流動：				
投資抵減	\$ 66,193	66,192	30,108	30,108

晶彩科技股份有限公司財務報表附註(續)

其他	1,637	<u>410</u>	1,467	<u>367</u>
		<u>66,602</u>		<u>30,475</u>
遞延所得稅資產總額		<u>\$ 80,280</u>		<u>36,728</u>

5. 本公司因投資研究發展支出及人才培訓，依促進產業升級條例規定得自當年度起五年內抵減各年度之應納營利事業所得稅，惟每一年度得抵減稅額，以不超過該年度應納營利事業所得稅額百分之五十為限，但已屆最後抵減年限者，不受前述限制。截至民國九十七年十二月三十一日止，本公司有關投資抵減之資訊如下：

<u>投資年度</u>	<u>可抵減總額</u>	<u>尚未抵減餘額</u>	<u>最後抵減年度</u>
94(核定數)	\$ 12,917	3,591	98
95(核定數)	15,366	15,366	99
96(申報數)	27,600	27,600	100
97(估計數)	<u>23,226</u>	<u>23,226</u>	101
	<u>\$ 79,109</u>	<u>69,783</u>	

6. 本公司營利事業所得稅結算申報業經稅捐稽徵機關核定至民國九十五年度。

7. 兩稅合一相關資訊：

	<u>97.12.31</u>	<u>96.12.31</u>
未分配盈餘所屬年度-八十七年度以後	\$ <u>318,433</u>	<u>126,758</u>
可扣抵稅額帳戶餘額	\$ <u>2,143</u>	<u>3,128</u>
	<u>97年度</u>	<u>96年度</u>
	<u>(預計)</u>	<u>(實際)</u>
盈餘分配之稅額扣抵比率	<u>0.67%</u>	<u>13.44%</u>



晶彩科技股份有限公司財務報表附註(續)

(十四)每股盈餘

本公司民國九十七年度及九十六年度每股盈餘之計算如下：

	97年度		96年度	
	稅前	稅後	稅前	稅後
基本每股盈餘：				
本期淨利	\$ 268,579	306,676	150,079	126,365
加權平均流通在外股數(千股)	57,295	57,295	41,830	41,830
基本每股盈餘(元)	\$ 4.69	5.35	3.59	3.02
稀釋每股盈餘：				
本期淨利	\$ 268,579	306,676	150,079	126,365
具稀釋作用之潛在普通股 —認股權憑證之影響	-	-	-	-
計算稀釋每股盈餘之本期淨利	\$ 268,579	306,676	150,079	126,365
加權平均流通在外股數(千股)	57,295	57,295	41,830	41,830
具稀釋作用潛在普通股之影響				
員工認股權憑證(千股)(註1)	1,032	1,032	1,051	1,051
員工分紅費用(千股)(註2)	1,426	1,426	-	-
計算稀釋每股盈餘之加權平均 流通在外股數(千股)	59,753	59,753	42,881	42,881
稀釋每股盈餘(元)	\$ 4.49	5.13	3.50	2.95
基本每股盈餘—追溯計算 96 年度盈 餘及員工紅利轉增資股數：				
本期淨利			\$ 150,079	126,365
加權平均流通在外股數(千股)			51,216	51,216
基本每股盈餘(元)			\$ 2.93	2.46
稀釋每股盈餘—追溯計算 96 年度盈 餘及員工紅利轉增資股數：				
本期淨利			\$ 150,079	126,365
加權平均流通在外股數(千股)			52,267	52,267
基本每股盈餘(元)			\$ 2.87	2.42

註 1：計算民國九十七年度稀釋每股盈餘時，其平均市價採用民國九十七年度之平均收盤價格。計算民國九十六年度稀釋每股盈餘時，其平均市價採用民國九十六年十二月三十一日之每股淨值。

## 晶彩科技股份有限公司財務報表附註(續)

註 2：本公司係股票上市掛牌公司，故以資產負債表日之收盤價，計算員工分紅之稀釋股數。

### (十五)金融商品相關資訊

#### 1. 衍生性金融商品

本公司民國九十七年度及九十六年度均無衍生性金融商品交易。

#### 2. 非衍生性金融商品

(1)民國九十七年及九十六年十二月三十一日，本公司金融資產及金融負債之公平價值資訊如下：

	97. 12. 31		96. 12. 31	
	帳面價值	公平價值	帳面價值	公平價值
金融資產：				
現金	\$ 373,277	373,277	86,326	86,326
應收票據及帳款	866,469	866,469	652,887	652,887
備供出售金融資產－流動	40,043	40,043	-	-
以成本衡量之金融資產－非流動	9,916	-	4,916	-
存出保證金	1,193	1,193	767	767
金融負債：				
短期借款	555,700	555,700	223,555	223,555
應付票據及帳款	166,461	166,461	158,355	158,355
長期借款(含一年內到期之長期借款)	279,031	279,031	159,255	159,255

(2)本公司估計金融商品公平價值所使用之方法及假設如下：

- A. 金融資產及負債如有活絡市場公開報價時，則以其市場價格為公平價值；若無市場價格可供參考時，則採用評價方法估計，所使用之估計與假設係與市場參與者於金融商品訂價時用以作為估計及假設之資訊一致。
- B. 短期金融商品以其在資產負債表上之帳面價值估計其公平價值；因此類商品到期日甚近，其帳面價值應屬估計公平價值之合理基礎。此方法應用於應收票據及帳款、存出保證金、短期借款、應付票據及帳款。
- C. 以成本衡量之金融資產係投資未上市櫃公司，因其未於公開市場交易，致實務上無法估計公平價值。
- D. 長期借款因採浮動利率計息，故以借款金額為其公平價值。

晶彩科技股份有限公司財務報表附註(續)

(3)本公司金融資產及金融負債之公平價值以活絡市場公開報價直接決定者及以評價方法估計者分別為：

金融資產及負債名稱	97. 12. 31		96. 12. 31	
	公開報價 決定之金額	評價方式 估計之金額	公開報價 決定之金額	評價方式 估計之金額
金融資產：				
現金	\$ 373,277	-	86,326	-
應收票據及帳款	-	866,469	-	652,887
備供出售金融資產— 流動	40,043	-	-	-
存出保證金	-	1,193	-	767
金融負債：				
短期借款	-	555,700	-	223,555
應付票據及帳款	-	166,461	-	158,355
長期借款(含一年內到 期之長期借款)	-	279,031	-	159,255

(4)財務風險資訊

A. 市場風險

本公司持有之受益憑證係分類為備供出售金融資產—流動，因此類金融資產係以公平價值衡量，因此本公司將暴露於市場價格變動風險。

B. 信用風險

本公司主要的潛在信用風險係源自於現金與應收票據及帳款之金融商品。本公司之現金存放於不同之金融機構。本公司控制暴露於每一金融機構之信用風險，而且認為本公司所持有之銀行存款不會有重大之信用風險顯著集中之虞。

本公司之銷售對象有顯著集中於少數客戶之情形，為減低信用風險，本公司持續評估客戶之財務狀況及實際收款情形且定期評估應收帳回收之可能性。本公司於民國九十七年及九十六年十二月三十一日，應收票據及帳款餘額中之99%係來自兩家客戶，使本公司有信用風險顯著集中之情形。

C. 流動性風險

本公司之資本及營運資金足以支應履行所有合約義務，預期不會產生因無法籌措資金以履行合約義務之流動性風險。

晶彩科技股份有限公司財務報表附註(續)

D. 利率變動之現金流量風險

本公司之短期及長期借款係屬浮動利率之債務，故市場利率變動將使短期及長期借款之有效利率隨之變動，而使未來現金流量產生波動。依民國九十七年及九十六年十二月三十一日之短期及長期借款餘額計算，市場利率增加1%，將使本公司每年現金流出分別增加8,347千元及3,828千元。

五、關係人交易

(一) 關係人之名稱及關係

關係人名稱	與本公司之關係
鑫豪科技股份有限公司(鑫豪科技)	本公司為該公司之法人董事
上海華彩科技有限公司(華彩科技)	該公司主要股東為本公司董事長之二親等內親屬
華康半導體股份有限公司(華康半導體)	按權益法評價之被投資公司
晶隼科技股份有限公司(晶隼科技)	該公司董事長與本公司董事長為同一人
全體董事、監察人、總經理及副總經理	本公司主要管理階層

(二) 與關係人之間之重大交易事項

1. 銷貨及應收帳款：

	97年度		96年度	
	金額	佔本公司銷貨淨額%	金額	佔本公司銷貨淨額%
華康半導體	\$ -	-	219	-

截至民國九十六年十二月三十一日止，因上述交易所產生之應收款項均已收取。

2. 進貨及應付帳款：

	97年度		96年度	
	金額	佔本公司進貨淨額%	金額	佔本公司進貨淨額%
鑫豪科技	\$ -	-	530	-

截至民國九十六年十二月三十一日止，因上述交易所產生之應付款項均已支付。

3. 財產交易：

## 晶彩科技股份有限公司財務報表附註(續)

本公司民國九十六年度出售固定資產予華康半導體，售價及出售利益分別為 743千元及149千元，本公司已將該未實現利益消除，並按期認列利益。截至民國九十七年及九十六年十二月三十一日止，因上述交易而遞延之累計未實現利益分別計62千元及100千元，帳列遞延貸項－聯屬公司間利益項下。

本公司於民國九十七年度及九十六年度向華彩科技購買軟體8,983千元及6,577千元，截至民國九十七年及九十六年十二月三十一日止，因上述交易所產生之應付關係人款項已支付。

#### 4. 租金收入：

民國九十七年度及九十六年度將部分辦公室出租予關係人，租金收入明細如下：

	97年度	96年度
鑫豪科技	\$ 19	57
晶隼科技	1,714	476
	<b>\$ 1,733</b>	<b>533</b>

截至民國九十七年及九十六年十二月三十一日止，因上述交易產生之應收款項餘額分別帳列如下：

	97. 12. 31	96. 12. 31
應收票據	\$ 150	150
其他流動資產	150	155
	<b>\$ 300</b>	<b>305</b>

#### 5. 其他：

本公司於民國九十七年度及九十六年度支付予關係人技術支援費用如下：

	97年度	96年度
華彩科技	<b>\$ 2,723</b>	<b>2,266</b>

另，截至民國九十七年及九十六年十二月三十一日止，因關係人提供檢測設備軟體開發服務所簽訂合約之預付款項，列於其他流動資產項下，列示如下：

	97. 12. 31	96. 12. 31
華彩科技	<b>\$ 361</b>	<b>475</b>

本公司與關係人之相關交易係依雙方議定之條件為之，並無其他適當交易對象可資比較。

## 晶彩科技股份有限公司財務報表附註(續)

### (三) 主要管理階層薪酬總額

本公司民國九十七年度及九十六年度給付董事、監察人、總經理及副總經理等主要管理階層薪酬總額之有關資訊如下：

	97年度	96年度
薪資	\$ 8,677	7,010
獎金及特支費	2,130	1,957
業務執行費用	315	40
員工紅利	710	690
	\$ 11,832	9,697

上述金額包含董監酬勞及員工紅利估列數，詳細估列方式請詳「股東權益」項下之說明。

### 六、抵質押之資產

截至民國九十七年及九十六年十二月三十一日止，本公司提供抵質押資產之帳面價值如下：

抵質押之資產	擔保標的	97. 12. 31	96. 12. 31
土地及廠房	長期借款擔保	\$ 282,993	285,687
機器設備	長期借款擔保	24,165	-
預付設備款	長期借款擔保	29,534	-
		\$ 336,692	285,687

### 七、重大承諾事項及或有事項

(一) 本公司民國九十六年度以「7.5 代廠薄膜電晶體(TFT)面板自動光學缺陷檢測設備」申請經濟部「主導性新產品開發輔導計畫」補助，業經經濟部審核通過，核定補助金額為 10,000 千元。依據合約規定本公司執行此計畫，所取得之知識、技術及各種智慧財產權，歸屬本公司所有，本公司有義務配合經濟部於此計畫執行期滿五年內提供計畫執行成效之相關資料。民國九十七年度及九十六年度本公司認列補助收入金額分別為 0 千元及 811 千元。

(二) 本公司與富泰營造股份有限公司簽訂廠房機電設施新建工程合約，合約金額共計 45,800 千元。截至民國九十七年及十二月三十一日止，主體結構工程已完工，部份機電設施工程則尚在驗收階段，尚未請款之工程款約 460 千元。

(三) 截至民國九十七年及九十六年十二月三十一日止，本公司已開立尚未使用之信用狀餘額分別為 0 元及美金 850 千元。

晶彩科技股份有限公司財務報表附註(續)

八、重大之災害損失：無。

九、重大之期後事項：無。

十、其 他

(一)本期發生之用人、折舊及攤銷費用依其功能別彙總如下：

性質別	功能別	97年度			96年度		
		屬於營業成本者	屬於營業費用者	合 計	屬於營業成本者	屬於營業費用者	合 計
用人費用							
薪資費用		67,148	103,664	170,812	41,795	66,788	108,583
勞健保費用		4,929	3,865	8,794	1,052	5,627	6,679
退休金費用		2,701	3,018	5,719	837	3,745	4,582
其他用人費用		2,527	5,320	7,847	1,653	4,015	5,668
折舊費用		1,963	7,918	9,881	683	5,730	6,413
攤銷費用		-	8,259	8,259	-	7,201	7,201

(二)重分類

民國九十六年度財務報表中若干金額為配合民國九十七年度財務報表之表達方式已作適當之重分類，該重分類對財務報表表達無重大影響。

十一、附註揭露事項

(一)重大交易事項相關資訊：

1. 資金貸與他人：無。
2. 為他人背書保證：無。
3. 期末持有有價證券情形：

持有之公司	有價證券種類及名稱	與有價證券發行人之關係	帳列科目	期 末				備註
				股 數	帳面金額	持股比率	市 價	
本公司	晶華科技股份有限公司普通股	該公司董事長與本公司董事長為同一人	以成本衡量之金融資產－非流動	500	5,000	10.00%	2,740	註1
本公司	鑫豪科技股份有限公司普通股	本公司為該公司之法人董事	以成本衡量之金融資產－非流動	1,300	4,916	19.23%	4,916	註1
本公司	華康半導體股份有限公司普通股	本公司按權益法評價之被投資公司	採權益法之長期股權投資	5,219	44,886	24.85%	44,886	註2
本公司	元大萬泰基金	無	備供出售金融資產－流動	2,775	40,043	-	40,043	

註1：股票並未在公開市場交易且無明確市價，依該公司自行編製未經會計師查核之自結報表列示淨值。

註2：股票並未在公開市場交易且無明確市價，依該公司經會計師查核之財務報表列計。

4. 累積買進或賣出同一有價證券之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之

晶彩科技股份有限公司財務報表附註(續)

二十以上：無。

5. 取得不動產之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上者：無。
6. 處分不動產之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上者：無。
7. 與關係人進、銷貨之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上者：無。
8. 應收關係人款項達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上者：無。
9. 從事衍生性商品交易：無。

(二)轉投資事業相關資訊：

1. 被投資公司名稱、所在地區...等相關資訊：

投資公司 名稱	被投資公司 名稱	所在地區	主要營 業項目	原始投資金額		期 末 持 有			被投資公司 本期(損)益	本期認列之 投資(損)益	備 註
				本期期末	上期期末	股 數	比 率	帳面金額			
本公司	華康半導體 股份有限公司	新竹縣	從事光學及精密 儀器之製造及零 售等	54,628	40,000	5,219	24.85%	44,886	(23,296)	(6,107)	

2. 資金貸與他人：不適用。
3. 為他人背書保證：不適用。
4. 期末持有有價證券情形：

持有之公司	有價證券 種類及名稱	與有價證券 發行人之關係	帳 列 科 目	期 末				備 註
				股 數	帳面金額	持股比率	市 價	
華康半導體	國泰債券基金	-	以公平價 值衡量列 入損益之 金融資產	336	4,000	-	4,000	
華康半導體	公用大亨連動 債券	-	以公平價 值衡量列 入損益之 金融資產	-	3,155	-	3,155	

5. 累積買進或賣出同一有價證券之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上：不適用。
6. 取得不動產之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上者：不適用。
7. 處分不動產之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上者：不適用。
8. 與關係人進、銷貨之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上者：不適用。
9. 應收關係人款項達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上者：不適用。
10. 從事衍生性商品交易：不適用。



晶彩科技股份有限公司財務報表附註(續)

(三)大陸投資資訊：無。

十二、部門別財務資訊：

(一)產業別、地區別及外銷銷貨資訊：

本公司僅經營一般儀器及精密儀器之製造及銷售，故為單一產業，亦無設置國外營運部門及外銷銷貨收入。

(二)重要客戶資訊

本公司民國九十七年度及九十六年度銷貨收入佔損益表之收入金額 10%以上之客戶明細如下：

	97年度		96年度	
	金額	佔當期 營業收入 之百分比	金額	佔當期 營業收入 之百分比
甲客戶	\$ 1,041,950	78	801,360	97
乙客戶	287,800	21	-	-
	<u>\$ 1,329,750</u>	<u>99</u>	<u>801,360</u>	<u>97</u>

晶彩科技股份有限公司

現金明細表

民國九十七年十二月三十一日

單位：新台幣千元

項 目	摘 要	金 額
現金	零用金	\$ 60
銀行存款	支票存款	10,497
	活期存款	277,004
	外幣存款(歐元 1,262.5×46.28 日幣 1,361,371×0.36249 美金 4,988.28×32.92)	716
	定期存款	85,000
		<u>\$ 373,277</u>

備供出售金融資產-流動明細表

金融商品名稱	摘要	單位數 (千)	單位成本 (元)	成本	市 價		提供質押 或擔保情形
					單 價 (元)	總 額	
元大萬泰基金	債券型基金	2,775	\$ 14.4	<u>40,000</u>	14.43	<u>40,043</u>	無

晶彩科技股份有限公司  
 應收票據及帳款明細表  
 民國九十七年十二月三十一日

單位：新台幣千元

客 戶 名 稱	摘 要	金 額
應收票據－關係人：		
晶隼科技股份有限公司	非營業	\$ 150
應收票據－非關係人：		
陳萬海	非營業	104
應收帳款：		
甲客戶	營 業	678,247
乙客戶	營 業	226,140
其他(註)		3,938
		908,325
減：備抵呆帳		42,110
		866,215
		\$ 866,469

註：個別金額未超過本科目餘額百分之五以上者，不予單獨列示。

晶彩科技股份有限公司

存貨明細表

民國九十七年十二月三十一日

單位：新台幣千元

項 目	金 額		市 價 基 礎
	成 本	市 價	
製 成 品	\$ 25,405	40,309	淨變現價值
在 製 品	238,238	336,067	淨變現價值
原 料	195,321	199,041	重置成本
	458,964	<u>575,417</u>	
減：備抵跌價損失	480		
	<u>\$ 458,484</u>		

其他流動資產明細表

項 目	金 額
留抵稅額	\$ 11,407
預付費用	2,124
應收退稅款	1,296
其他(註)	1,029
	<u>\$ 15,856</u>

註：個別金額未超過本科目餘額百分之五以上者，不予單獨列示。

晶彩科技股份有限公司

採權益法之長期股權投資變動明細表

民國九十七年一月一日至十二月三十一日 單位：新台幣千元

股數：千股

被投資事業名稱	期初餘額		本期增(減)		依權益法 認列之投 資(損)益	其他(註)		期末餘額		提供擔 保或質 押情形
	股數	金額	股數	金額		金額	股數	比例%	金額	
華康半導體股份 有限公司	4,000	\$ 35,179	1,219	14,628	(6,107)	1,186	5,219	24.85	44,886	無

註：其他係因被投資公司現金增資，本公司未依持股比例認列產生之調整。

以成本衡量之金融資產—非流動變動明細表

名稱	期初餘額		本期增加		本期減少		期末餘額		提供擔保	備註
	股數	帳面價 值	股數	金額	股數	金額	股數	帳面價值	或質押情 形	
鑫豪科技(股)公司	1,300	\$ 4,916	-	-	-	-	1,300	4,916	無	-
晶隼科技(股)公司	-	-	500	5,000	-	-	500	5,000	無	-
		\$ 4,916		5,000		-		9,916		

晶彩科技股份有限公司

固定資產變動明細表

民國九十七年一月一日至十二月三十一日 單位：新台幣千元

項 目	期初餘額	本期增加	本期減少	重分類	期末餘額	提供擔保或質押情形
成本：						
土地	\$ 184,746	-	-	-	184,746	註 1
房屋及建築	103,513	2,135	-	67,838	173,486	註 1
機器設備	11,548	2,436	1,572	27,074	39,486	註 1
運輸設備	3,337	-	-	-	3,337	無
辦公設備	7,040	1,863	3,037	-	5,866	無
其他設備	6,095	1,578	4,745	-	2,928	註 1
未完工程及預付設備款						無
	<u>35,843</u>	<u>122,290</u>	<u>-</u>	<u>(103,895)</u>	<u>54,238</u>	
	<u>352,122</u>	<u>130,302</u>	<u>9,354</u>	<u>(8,983)</u>	<u>464,087</u>	
累計折舊：						
房屋及建築	1,972	2,637	-	-	4,609	
機器設備	2,513	3,087	1,572	-	4,028	
運輸設備	1,151	556	-	-	1,707	
辦公設備	3,617	1,777	3,007	-	2,387	
其他設備	<u>3,674</u>	<u>1,824</u>	<u>4,745</u>	<u>-</u>	<u>753</u>	
	<u>12,927</u>	<u>9,881</u>	<u>9,324</u>	<u>-</u>	<u>13,484</u>	
固定資產淨額	<u>\$ 339,195</u>	<u>120,421</u>	<u>30</u>	<u>(8,983)</u>	<u>450,603</u>	

註 1：以土地、房屋及建築帳面價值 282,993 千元、機器設備帳面價值 24,165 千元及預付設備款 29,534 千元以供長期借款之設定抵押，請參閱附註六之說明。

晶彩科技股份有限公司

無形資產變動明細表

民國九十七年一月一日至十二月三十一日 單位：新台幣千元

項 目	期初餘額	本期增加	本期攤銷	重分類	期末餘額
電腦軟體	\$ 12,434	82	6,592	8,983	14,907
專利權	11	82	32	-	61
合 計	<u>\$ 12,445</u>	<u>164</u>	<u>6,624</u>	<u>8,983</u>	<u>14,968</u>

遞延費用變動明細表

項 目	期初餘額	本期增加	本期攤銷	重分類	期末餘額
電話系統及電力工程等	\$ 4,345	4,503	1,635	-	7,213

晶彩科技股份有限公司

短期借款明細表

民國九十七年十二月三十一日

單位：新台幣千元

債權人	貸款性質	契約期限	利率區間	期末餘額	融資額度
土地銀行	購料借款	97.01.31~98.01.31	2.885%~3.150%	\$ 264,000	600,000
玉山商銀	購料借款	97.07.24~98.07.24	2.550%~3.060%	189,000	189,000
彰化銀行	購料借款	97.07.18~98.09.30	-	-	89,880
玉山商銀	信用借款	97.07.08~98.07.08	2.550%	50,000	50,000
第一銀行	信用借款	96.11.16~98.02.04	2.833%	2,700	50,000
彰化銀行	信用借款	97.09.30~98.09.30	1.900%	50,000	50,000
				<u>\$ 555,700</u>	

應付票據及帳款明細表

廠 商 名 稱	金 額
應付票據：	
喬匯實業有限公司	\$ 11,783
竹磊科技股份有限公司	9,388
泰洛科技股份有限公司	7,509
凱龍機械有限公司	7,215
其他(註)	<u>105,830</u>
小 計	<u>141,725</u>
應付帳款：	
新亞洲儀器股份有限公司	8,617
福春科技有限公司	1,333
其他(註)	<u>14,786</u>
小 計	<u>24,736</u>
	<u>\$ 166,461</u>

註：個別金額未超過本科目餘額百分之五以上者，不予單獨列示。



晶彩科技股份有限公司  
應付費用及其他流動負債明細表

民國九十七年十二月三十一日

單位：新台幣千元

項 目	摘 要	金 額
應付費用	應付薪資及年終獎金	\$ 36,869
	應付員工紅利	27,601
	應付董監酬勞	5,520
	其他(註)	<u>11,926</u>
	小計	<u>81,916</u>
其他流動負債	售後保固服務準備	6,628
	其他(註)	<u>18,683</u>
	小計	<u>25,311</u>
	合計	<u><u>\$ 107,227</u></u>

註：個別金額未超過本科目餘額百分之五以上者，不予單獨列示。

晶彩科技股份有限公司

長期借款明細表

民國九十七年十二月三十一日

單位：新台幣千元

債權人	摘要	借款金額	契約期間	利率區間	抵押或擔保
玉山商業銀行	廠房抵押借款	\$ 70,031	94.07.20~104.07.20	2.63%~3.14%	廠房、土地
上海商業銀行	設備抵押借款	30,000	97.12.05~102.10.15	2.075%	研發設備、 預付設備款
台灣土地銀行	廠房抵押借款	<u>179,000</u>	97.01.11~112.01.11	2.885%~3.15%	廠房、土地
		279,031			
減：一年內到期 之長期借款		<u>17,875</u>			
		<u><b>\$ 261,156</b></u>			

營業收入明細表

民國九十七年一月一日至十二月三十一日

項 目	數量(台)	金 額
TFT-LCD 面板自動光學檢測機	94	\$ 1,329,750
其他		<u>4,380</u>
		<u><b>\$ 1,334,130</b></u>

晶彩科技股份有限公司

銷貨成本明細表

民國九十七年一月一日至十二月三十一日 單位：新台幣千元

項 目	金 額
期初原料	\$ 110,864
加：本期進料	951,013
減：期末原料	195,321
原料出售	310
其他	<u>51,482</u>
本期耗用原料	814,764
直接人工	15,046
製造費用	<u>139,851</u>
製造成本	969,661
加：期初在製品	78,393
本期進料及加工成本等	1,469
減：期末在製品	238,238
其他	<u>13,822</u>
製成品成本	797,463
加：期初製成品	28,104
減：期末製成品	25,405
出售原料	310
其他	<u>36,437</u>
銷貨成本	<u><u>\$ 836,909</u></u>

晶彩科技股份有限公司

推銷費用明細表

民國九十七年一月一日至十二月三十一日 單位：新台幣千元

<u>項 目</u>	<u>金 額</u>
薪 資 支 出	\$ 9,543
交 際 費	616
其 他 費 用(個別金額未超過 5%者)	<u>2,352</u>
	<u>\$ 12,511</u>

管理及總務費用明細表

<u>項 目</u>	<u>金 額</u>
薪 資 支 出	\$ 26,460
呆 帳 損 失	14,905
折 舊	5,339
各 項 攤 提	8,259
勞 務 費	7,670
其 他 費 用(個別金額未超過 5%者)	<u>15,080</u>
	<u>\$ 77,713</u>

晶彩科技股份有限公司財務報表附註(續)

晶彩科技股份有限公司

研究發展費用明細表

民國九十七年一月一日至十二月三十一日 單位：新台幣千元

<u>項 目</u>	<u>金 額</u>
薪 資 支 出	\$ 67,661
研 發 費	31,620
其 他 費 用(個別金額未超過 5%者)	<u>22,607</u>
	<u><u>\$ 121,888</u></u>

營業外收入及支出明細表

<u>項 目</u>	<u>摘 要</u>	<u>金 額</u>
營業外收入及利益：		
利息收入		\$ 655
什項收入淨額	係出售下腳廢料收入等	<u>3,769</u>
		<u><u>\$ 4,424</u></u>
營業外費用及損失：		
利息費用		\$ 14,366
採權益法認列之投資損失		6,107
出售及報廢固定資產損失淨額		30
什項支出	係兌換損失等	<u>451</u>
		<u><u>\$ 20,954</u></u>

五、最近年度經會計師查核簽證之母子公司合併財務報表：無。

六、公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止，如有發生財務週轉困難情事，應列明其對本公司財務狀況之影響：無。

## 柒、財務狀況及經營結果之檢討分析與風險事項

### 一、財務狀況

#### (一)最近二年度財務狀況分析

單位：新台幣仟元

項 目 \ 年 度	97 年度	96 年度	差異	
			增減金額	變動比例(%)
流動資產	1,767,807	988,131	779,676	78.90
固定資產	450,603	339,195	111,408	32.84
其他資產	145,751	89,162	56,589	63.47
資產總額	2,364,161	1,416,488	947,673	66.90
流動負債	847,360	464,351	383,009	82.48
其他負債	3,073	2,117	956	45.16
長期負債	261,156	143,166	117,990	82.41
負債總額	1,111,589	609,634	501,955	82.34
股本	589,348	418,300	171,048	40.89
資本公積	328,824	257,625	71,199	27.64
保留盈餘	335,678	131,366	204,312	155.56
未認列退休金成本淨損失	(1,321)	(437)	(884)	(202.29)
股東權益總額	1,252,572	806,854	445,718	55.24

說明：

- (1) 流動資產增加：主要係本年度辦營收大幅成長，現金及期末應收帳款增加及配合銷售需求，存貨水準高所致。
- (2) 固定資產增加：主要係本年度購置RFID設備所致。
- (3) 流動負債增加：主係因營業收入成長，因進貨及各項費用產生之應付票據及帳款及應付費用、其他流動負債增加所致，另因淨利成長應付所得稅亦隨之增加。
- (4) 股本及資本公積增加：主要係本期辦理現金增資及盈餘轉增增所致。
- (5) 保留盈餘增加：主要係本期淨利大幅成長所致。

(二)最近二年度財務狀況變動，影響重大者請說明未來因應計劃：無。

## 二、經營結果

### (一)最近二年度經營結果變動分析

單位：新台幣仟元

項 目	年 度		差 異	
	97 年度	96 年度	增減金額	變動比例(%)
營業收入淨額	1,334,130	825,513	508,617	61.61
營業成本	836,909	504,810	332,099	65.79
營業毛利	497,221	320,703	176,518	55.04
營業費用	212,112	155,099	57,013	36.76
營業利益(損失)	285,109	165,604	119,505	72.16
營業外收入及利益	4,424	3,506	918	26.18
營業外費用及損失	20,954	19,031	1,923	10.10
稅前淨利(損)	268,579	150,079	118,500	78.96
所得稅(費用)利益	38,097	(23,714)	61,811	260.65
本期淨利(損)	306,676	126,365	180,311	142.69
比例變動分析說明：				
(1) 營業收入、營業成本及營業毛利增加，係因本年度接獲面板廠大量訂單及增加銷售新產品，致使營業收入增加，及營業成本及營業毛利隨之增加。				
(2) 營業費用增加主要係營業收入大幅成長，相關之人事成本及其他營業費用隨之增加所致。				
(3) 所得稅利益增加，主要係本期開始適用促進產業升級條例五年免徵營利事業所得稅所致。				

## 三、現金流量

### (一)最近二年度流動性變動分析

項 目	年 度		變動金額	變動%
	97 年度	96 年度		
營業活動之淨現金流(出)入	(108,499)	(101,037)	(7,462)	(7.39)
投資活動之淨現金流(出)入	(195,168)	(175,153)	(20,015)	(11.43)
融資活動之淨現金流(出)入	590,618	155,006	435,612	281.03
增減變動分析說明：				
1. 營業活動淨現金流出主係營業收入成長，應收帳款及存貨增加所致。				
2. 投資活動淨現金流出主係增購 RFID 相關設備所致。				
3. 融資活動淨現金流入主係現金增資及增加銀行借款所致。				



## (二)未來一年現金流動性分析

期初現金 餘額(1)	預計全年來 自營業活動 淨現金流量 (2)	預計全年現 金流出量 (3)	預計現金剩餘 (不足)數額 (1)+(2)-(3)	預計現金不足額之補 救措施	
				投資計畫	融資計畫
373,277	(28,085)	(222,619)	122,573	-	-
1.本年度現金流量變動情形分析： (1) 營業活動之淨現金流出預計28,085仟元，主要係支付貨款款項所致。 (2) 投資活動淨現金流出：主要係購買機器設備所致。 (3) 融資活動淨現金流出：主要係償還銀行借款所致。 2.預計現金不足額之補救措施及流動性分析：不適用。					

## 四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響

(一)重大資本支出之運用情形及資金來源及未來五年擬投資之資本支出性質：無。

(二)預計未來產生之重大效益：不適用

## 五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計劃及未來一年投資計劃

1.轉投資政策：本公司決策當局基於營運需求或公司未來成長之考量等因素進行轉投資，由相關單位提供專業資訊，並由財務單位彙整資料後向權責主管提出建議，投資建議案產生後，應針對被投資公司過去及未來展望、市場狀況及經營體質進行評估，以做為決策當局進行投資決策之依據。

2.轉投資獲利或虧損情形：

單位：新台幣仟元

項目	說明	金額	投資政策	獲利或虧損主要原因	改善計畫	未來其他投資計畫
鑫豪科技股份有限公司		13,000	接近市場	尚在創設階段，預期 98 年度將可轉虧為盈	加強營運管理	-
華康半導體股份有限公司		19,628	接近市場	尚在創設階段，預期 98 年度將可轉虧為盈	加強營運管理	
晶隼科技股份有限公司		5,000	接近市場	尚在創設階段，預期 98 年度將可轉虧為盈	加強營運管理	-

## 六、最近年度及截至年報刊印日止風險事項之分析評估

### (一)利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施

#### 1.利率變動：

單位：新台幣仟元；%

項目/年度	97 年度	96 年度
利息收入(支出)淨額(A)	(13,711)	(8,231)
營業收入(B)	1,334,130	825,513
營業利益(C)	285,109	165,604
佔營業收入比例(A/B)	(1.03)%	(1.00)%
佔營業利益比例(A/C)	(4.81)%	(4.97)%

本公司最近 96 年度及 97 年度利息收入(支出)淨額佔營業收入及營業利益比例分別為(1.00)%、(1.03)%及(4.97)%、(4.81)%。為規避利率變動對本公司之影響，將試營運狀況與資金之需求，適時辦理現金增資，以降低對銀行融資的依賴。

#### 2.匯率變動：

單位：新台幣仟元；%

項目/年度	97 年度	96 年度
兌換利益(損失)淨額(A)	(445)	(387)
營業收入(B)	1,334,130	825,513
營業利益(C)	285,109	165,604
佔營業收入比例(A/B)	(0.03)%	(0.05)%
佔營業利益比例(A/C)	(0.16)%	(0.23)%

本公司進銷貨主要以新台幣為主，直接進口以外幣報價之比例不高，故匯率變動對公司營收及獲利尚無重大影響，惟本公司人員亦對匯率變動之相關因素隨時保持密切注意，務求降低匯率變動對本公司之影響。

#### 3.通貨膨脹：

A.對公司損益之影響：97 年度及 96 年截至年報刊印日止並無顯著之通貨膨脹情形，且本公司隨時注意市場價格之波動，並與供應商及客戶保持良好之互動關係，故尚未有因通貨膨脹而產生重大影響損益之情形。

B.未來因應之措施：本公司密切注意相關經濟環境變化及市場情勢變動，以避免遭受通貨膨脹對本公司損益之不利影響。

### (二)從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施

本公司政策為不執行高風險交易或商品之作業，而以穩健保守為原則；且已制定資產取得與處分處理程序、資金貸與他人作業程序、背書保證管理辦法及從事衍生性商品交易處理程序規範其例行政程序與風險控管。

### (三)未來研發計劃及預計投入之研發費用

產品名稱	主要用途
TFT面板雷射修補機	以雷射技術將缺陷區之TFT線路打掉或將金屬層熔接
次世代機台設備開發	配合客戶擴廠需求，開發7.5代以上相關設備。
自動缺陷修補機	結合缺陷複檢機、自動缺陷判定軟體以及缺陷修補機技術，以判定缺陷是否需要修補，同時將該缺陷自動修補。
RFID Inlay&Tag	以即時影像檢測及光學對位技術運用於RFID封裝測試

一般開發機台時程約需6~12個月，主要技術為機構設計、光學系統開發、影像辨識軟體、電子系統等，本公司已累積數年基礎，目前主要在此基礎作業系統進行整合商品化；且其商品化過程中，皆受各大面板廠在需求規格上的協助，各研發計畫均可按進度完成。另本公司將運用光學及影像辨識的技術投入RFID Inlay及RFID Tag，預計於98年第4季開始試產。

本公司97年度投入之研發費用達121,888仟元，並將視營運狀況逐年調整。

### (四)國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施

本公司隨時注意國內外重要政策及法律變動之情形，並評估其對公司之影響；而於最近年度及截至年報刊印日止，國內外政策及法律變動對本公司財務業務並無重大不利影響。

### (五)科技改變及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施

本公司為國內平面顯示器產業少數垂直整合檢測量測及修補設備之供應商，所生產之產品除已取得多項專利保障外，並獲得國內面板大廠之高度評價與認同，足見本公司之研發與因應技術與產業變化之能力，未來本公司仍將持續增加研發投入外，並密切掌握市場之趨勢與脈動，以順應相關產業之演變與變化，故科技改變與產業變化對本公司財務業務尚不致產生重大影響。

### (六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施

本公司自成立起即致力維持企業形象，並遵守法令規定，截至目前為止，未發生足以影響企業形象之情事。

### (七)進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：無。

### (八)擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：無。

### (九)進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施

#### (1)進貨集中風險

本公司在重要關鍵零組件的採購上，均維持兩家以上之供應商為原則。雖本

公司與各供應商間已建立長期且良好之合作關係，惟仍會定時針對各供應商之供貨品質狀況、交期及準確性做評核，以確保其供貨品質。最近二年度本公司對單一廠商之採購比重均未逾 16%，且前十大進貨廠商之進貨金額合計佔進貨淨額比重平均約為 53%，故進貨來源尚稱穩定，應不致發生供貨短缺或中斷之情事。

(2)銷貨集中風險

由於主要銷售對象國內 TFT-LCD 面板製造業者數少，但建廠資本支出龐大，故面板廠商若將部分資本支出交由合作密切或有能力生產之設備商承做，則很容易導致設備製造商銷售集中情形；本公司最近二年度主要客戶如奇美、友達於 96 年度分別佔本公司全年度銷售淨額比率為 97.10%、0.01%，97 年度分別佔本公司全年度銷售淨額比率為 78.10%、21.9%；此一產業特性所造成之系統風險，實為 TFT-LCD 設備商於發展過程難以避免之問題，而本公司將盡力維持現有良好客戶關係並積極開發新產品及拓展新客戶，分散產品結構，以擴展不同產品別客戶及訂單避免產品集中之市場風險。

(十)董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響、風險及因應措施：無。

(十一)經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：無。

(十二)訴訟或非訟事件，應列明公司及公司董事、監察人、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司已判決確定或尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應揭露其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要訴訟當事人及截至年報刊印日止之處理情形：無。

(十三)其他重要風險及因應措施：無。

七、其他重要事項：無。

## 捌、特別記載事項

- 一、關係企業相關資料：無。
- 二、最近年度及截至年報刊印日止私募有價證券辦理情形：無。
- 三、最近年度及截至年報刊印日止子公司持有或處分本公司股票情形：無。
- 四、其他必要補充說明事項：無。
- 五、依證券交易法第三十六條第二項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項：無。

# 晶彩科技股份有限公司

董事長：陳永華